



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

股票代號：6488

環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

113 年度年報

年報查詢網址：

公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

本公司網址 <http://www.sas-globalwafers.com>

環球晶圓股份有限公司 編製
中華民國 114 年 3 月 31 日刊印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：彭欣瑜
職稱：董事長特別助理
電話：(03)577-2255
電子郵件信箱：GWCIR@sas-globalwafers.com
代理發言人姓名：何禧樂
職稱：行銷處協理
電話：(03)578-3131
電子郵件信箱：GWCIR@sas-globalwafers.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司及工廠：新竹科學園區新竹市工業東二路8號；電話：(03) 577-2255
竹南工廠：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路21號；電話：(03) 577-2255
竹南二廠：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號1、3樓；電話：(03) 577-2255
中德分公司
竹科工廠：新竹科學園區新竹市研新一路2號；電話：(03) 578-3131
兆遠子公司
竹南新廠：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號1、4樓；電話：(037) 585-058

日本子公司

新潟工廠：新潟県北蒲原郡聖籠町東港6-861-5；電話：(+81) (25) 256 3200
徳山工廠：山口県周南市江口2-1-32；電話：(+81) (834) 41 3001
関川工廠：新潟県岩船郡関川村大字辰田新278；電話：(+81) (254) 64 0254
小國長晶中心：山形県西置賜郡小国町大字小国町378；電話：(+81) (238) 62 5926
宇都宮工廠：栃木県清原工業団地11-2；電話：(+81) (28) 667 6333

韓國子公司

天安工廠：854, Manghyang-Ro, Seonggeo-eup, Sebuk-gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-do, 331-831 Korea
電話：(+82) 41 550 4114

大陸子公司

昆山工廠：江蘇省昆山市城北高科技工業園區漢浦路 303 號；電話：(+86) 512 5778 1262
上海工廠：上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區；電話：(+86) 21 5990 1388
忻州工廠：山西省忻州市開發區正丰街南半導體產業園區；電話：(+86) 350 3305 557

馬來西亞子公司

吉隆坡工廠：Jalan SS 8/2, Sungai Way Free Industrial Zone, 47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
電話：(+603) 7877 3277

新加坡子公司

Block D #01-41A, 11 Lorong 3 Toa Payoh, Singapore 319579
電話：(+65) 6361 9720

美國子公司

德州工廠：200 F.M. 1417 West Sherman, Texas, USA 75092；電話：(+1) 903 957 1999
密蘇里工廠：501 Pearl Drive, St. Peters, Missouri, USA 63376；電話：(+1) 636 474 5000

義大利子公司

美拉諾工廠：Via Nazionale, 59, 39012 Merano (Bolzano), Italy；電話：(+39) 0473 333 333
諾瓦拉工廠：Viale Gherzi, 31, 28100 Novara, Italy；電話：(+39) 0321 33 4444

丹麥子公司

哥本哈根工廠：Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund, Copenhagen, Denmark
電話：(+45) 47 36 56 00

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
電話：(02) 2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：黃泳華會計師、吳俊源會計師
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地址：台北市信義路五段7號68樓
網址：<http://www.kpmg.com.tw>
電話：(02) 8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

海外存託憑證：盧森堡交易所；<https://www.luxse.com/security/US37891E1038/250465> (Reg S GDS)
<https://www.luxse.com/security/US37891E2028/399669> (Rule 144A GDS)

六、公司網址：<http://www.sas-globalwafers.com>

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	6
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	17
三、公司治理運作情形.....	24
四、簽證會計師公費資訊.....	80
五、更換會計師資訊.....	80
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	80
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	80
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊.....	81
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	82
參、募資情形.....	83
一、資本及股份.....	83
二、公司債辦理情形.....	87
三、特別股辦理情形.....	87
四、海外存託憑證辦理情形.....	88
五、員工認股權憑證辦理情形.....	89
六、限制員工權利新股辦理情形.....	89
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	89
八、資金運用計畫執行情形.....	89
肆、營運概況.....	90
一、業務內容.....	90
二、市場及產銷概況.....	102
三、從業員工資訊.....	110
四、環保支出資訊.....	110
五、勞資關係.....	110
六、資通安全管理.....	113
七、重要契約.....	116

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	117
一、財務狀況.....	117
二、財務績效.....	118
三、現金流量.....	119
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	119
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	119
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	121
七、其他重要事項.....	126
陸、特別記載事項.....	127
一、關係企業相關資料.....	127
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	127
三、其他必要補充說明事項.....	127
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	128

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

感謝大家撥冗參加環球晶圓股份有限公司 114 年度股東大會，也謝謝大家對本公司的支持與愛護。

113 年全球半導體終端需求復甦不均，呈現先進製程需求旺，成熟製程未明顯回春狀態。客戶持續調整庫存水位，惟消耗步伐較預期緩慢，仍略高於平均水位，致使矽晶圓出貨量放緩。儘管面對地緣政治風險、終端應用未明朗等不確定因素，環球晶圓 113 年營收表現仍季季成長、穩步上升。環球晶圓 113 年全年的合併營收為新台幣 62,626,004 仟元，年減 11.36%，營業毛利新台幣 19,803,501 仟元，營業淨利新台幣 14,118,185 仟元，稅前淨利新台幣 12,428,566 仟元，稅後淨利為新台幣 9,838,780 仟元，稅後每股盈餘為 21.06 元。

以下謹就 113 年度營業成果、114 年度營業計畫概要、未來公司發展、受到外部競爭、法規環境及總體經濟環境之影響等，概要報告如述：

一、113 年度營業成果

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	112 年度	增減百分比(%)
	(IFRSs)	(IFRSs)	
營業收入	62,626,004	70,651,593	-11.36%
營業成本	42,822,503	44,211,027	-3.14%
營業毛利	19,803,501	26,440,566	-25.10%
營業費用	5,685,316	6,382,005	-10.92%
營業淨利	14,118,185	20,058,561	-29.62%
稅前淨利	12,428,566	26,496,457	-53.09%
本期淨利	9,838,780	19,769,641	-50.23%

(二) 預算執行情形：本公司 113 年度無公告財務預測。

(三) 獲利能力分析

項 目		113 年度	112 年度	
財務 結構	負債佔資產比率	59.47%	64.84%	
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	133.96%	158.77%	
獲利 能力 分析	資產報酬率	5.09%	11.30%	
	權益報酬率	12.50%	32.74%	
	占實收資本比率	營業利益	295.29%	459.94%
		稅前純益	259.95%	607.56%
	純益率	15.71%	27.98%	
稅後每股盈餘(元)	21.06	45.41		

(四) 財務收支情形

本公司 113 年度營業收入新台幣 62,626,004 仟元，營業成本新台幣 42,822,503 仟元，營業費用新台幣 5,685,316 仟元，營業外收支淨額為淨支出新台幣 1,689,619 仟元，稅前淨利新台幣 12,428,566 仟元，稅後淨利新台幣 9,838,780 仟元，財務收支正常。

(五) 研究發展狀況

1. 113 年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

項目/年度	113 年度	112 年度
研發費用	2,317,220	2,364,071
營業收入淨額	62,626,004	70,651,593
研發費用占營收淨額之比例	3.70%	3.35%

2. 113 年度研究發展成果：

技術或產品名稱

- (1) 第3代 PVT碳化矽長晶爐
- (2) 低損耗碳化矽晶圓切割技術開發
- (3) 矽長晶斷線自動辨識系統開發
- (4) 矽長晶自動摻雜裝置開發
- (5) 高效節能冰水冷卻系統開發
- (6) 低材料損耗研磨製程開發

- (7) 第3代低能耗長晶熱場開發
- (8) 運用於2奈米製程用矽晶圓超高潔淨清洗技術開發

3. 未來研究發展計劃：

- (1) 次世代高功率車用電子元件用碳化矽晶圓
- (2) GaN_HEMT用磊晶晶圓
- (3) 矽光子SOI晶圓
- (4) LNO, LTO /矽晶圓接合晶圓
- (5) 高電阻ECAS晶圓襯底接合晶圓
- (6) 12吋鑽石線切割製程開發
- (7) 次世代3D記憶體用矽晶圓
- (8) 8吋碳化矽磊晶開發
- (9) 新世代碳化矽晶體生長爐
- (10) 12吋碳化矽晶片

二、114年度營業計畫概要

(一) 經營方針

- (1) 積極掌握市場趨勢及國際情勢，在政治及關稅政策影響下靈活調度產品生產，期以最低成本滿足客戶需求。
- (2) 積極提升良率、解決瓶頸站點以最大化現有產能，謹慎控制資本支出，確保擴產計畫如期完成。
- (3) 持續研發新產品並與策略夥伴合作，發揮材料互補綜效。
- (4) 廣泛產官學合作，佈局利基型應用先進製程，快速提升新技術之開發能量。
- (5) 強化各事業體之營運績效，跨地整合研發、生產、行銷等，發揮最大效益。
- (6) 遵循「負責任的成長」原則，恪盡環境、職場健康安全與公司治理的企業社會責任，追求永續成長。

(二) 預估銷售數量及其依據

根據世界半導體貿易統計協會(WSTS, World Semiconductor Trade Statistics)報告，2024年半導體市場將比去年同期大幅成長 19.0%。2024 年全球市場價值將達到 6,270 億美元，反映出 2024 年第 2 季和第 3 季業績的改善，尤其是在運算領域。

該機構分析，2024 年的成長將主要由兩個半導體領域推動：記憶體預計成長 81.0%，邏輯預計成長 16.9%。兩領域皆較先前預測（邏輯成長 10.7%，記憶體成長 76.8%）上修。相反，分立元件、光電子元件、感測器和類比半導體等維持衰退預測。

展望 2025 年，WSTS 預測半導體市場將廣泛成長，增幅為 11.2%，全球市場估值預

計將達到 6,970 億美元。這一增長將主要由邏輯和記憶體產業推動，預計這兩個產業的價值將超過 4,000 億美元。其中邏輯領域較去年同期成長超過 17%，記憶體領域較去年同期成長超過 13%。其他半導體類別預計將以較溫和的個位數成長率成長，這表明該產業整體穩定擴張。2025 年，所有地區都將繼續成長。美洲和亞太地區預計將保持兩位數的年增長。

由於總體經濟、世界情勢與各國匯率仍快速變遷，尚不確定對全球半導體之影響，以上為僅能依據目前狀況所做的最佳預測。

(三) 重要產銷政策

- (1) 加速大尺寸半導體晶圓及特殊產品(化合物半導體、SOI、FZ)擴產的量產時程，以先進技術及產品擴大領先優勢，迅速切入新興應用及先進製程。
- (2) 謹慎控制通貨膨脹造成的成本上漲、穩定關鍵原料與零件供應來源，確保生產順暢。
- (3) 運用遍布全球的廣泛據點，彈性調度產能以就近供應客戶。
- (4) 持續研發專利並進行戰略佈局，以強化競爭優勢的核心基礎。

(四) 未來公司發展策略

- (1) 運用集團尖端之領先技術開發符合次世代產品運用之 GaN/Si/SiC 晶片，朝向大尺寸重摻長晶及功率半導體磊晶技術發展。
- (2) 落實綠色製造、實踐企業社會責任、完備公司治理，建構永續經營基礎。
- (3) 藉由採用再生能源、提升能源使用效率、碳清除與購買碳補償商品，實現全球營運據點達到 100%使用可再生能源的承諾。
- (4) 積極導入各項節能措施及採用再生能源，配合遍布全球的生產營運據點，建構具有韌性及彈性的在地供應鏈，敏捷因應疫情及地緣政治緊張情勢，並降低環境衝擊，提供客戶碳哩程較短的綠色晶圓。
- (5) 透過擴產以增加營運規模，同時緊密掌握產業動向、積極爭取政府補助，提升在半導體晶圓產業的競爭力。
- (6) 與重要合作夥伴積極簽訂長期合作計畫以鞏固合作基礎。

(五) 受到外部競爭、法規環境及總體經濟環境之影響

- (1) 隨著半導體產業的發展與應用，其相關產品已深入人們的日常生活，舉凡食、衣、住、行、育、樂均可見到半導體產品的運用，因此半導體產業景氣跟總體經濟有相當程度的連結。由於公司的客戶群廣泛，終端產品遍及各產業及應用領域，如車用產品、電源類產品、記憶體等等…，可降低單一產業景氣循環的風險，因此當總體經濟不佳時，公司尚能藉此分散風險，使營運維持穩定。
- (2) 半導體晶圓產業累積數十年的發展，在技術、專利等各方面均建立起相當程度的進入門檻，但面對有雄厚資金的新競爭者，我們將時時密切觀察產業發展。為免新進廠商積極加入而引導產品售價下跌影響銷售及獲利，以既有基礎持續結合本公司全球各地的技術優勢，以核心技術能力開發利基產品，提升產品附加價值，並將成本

極小化，以增加獲利空間。

- (3) 近期國際情勢變化劇烈、關稅及地域性貿易衝突亦對總體經濟帶來不小震盪，然環球晶圓在全球各地皆設有生產據點，將彈性調度生產以因應相關法規、降低貿易關稅對營運成本之影響；遍佈全球各區域的客戶也能有效分散其對營收帶來的衝擊並降低單一地區的經濟風險，環球晶圓亦與客戶及供應商維持緊密關係，建立具有韌性的在地供應鏈及 BCP (繼續營運計畫)，彈性因應各項挑戰。
- (4) 碳中和已經是國際關注的重要議題，政府法規、投資機構，客戶及貿易夥伴的國家政策對於節能減碳的規範也越趨嚴格，減碳不僅是環保層次、更是經濟層次，電力成本及出口地的碳關稅嚴格考驗企業生存能力。環球晶圓致力於優化現有設備，同時也導入各項節能措施，以對環境更友善的方式生產。另外，母公司中美矽晶作為綠色能源全方位供應商(Green Energy Total Solution Provider)，可利用其豐富經驗與垂直整合供應鏈優勢、協助集團興建太陽能電廠以增加綠色能源發電量，並以旗下續興能源協助媒合綠電需求。環球晶圓的新蓋廠區也在興建時期便導入各項節能設備及方案以降低能耗、並綜合運用各項綠色方案、擴大綠電使用比例，亦同時監控極端氣候所帶來的各項衝擊，將營運風險降到最低。

展望 114 年，環球晶圓將持續透過全球擴產計畫專注於擴大先進製程產品，以滿足高效能運算 (HPC) 和人工智慧 (AI) 應用對高品質晶圓的需求，藉以轉化為公司主要增長動力，並以位於美洲、亞洲和歐洲等關鍵市場的佈局提供全球客戶更佳服務，以應對地緣政治風險。環球晶圓另以永續發展建構獨特優勢，提高再生能源使用比例及當地供應的短距運輸，減少碳足跡以提供客戶更加環保的綠色晶圓。持續以技術創新、先進產能、全球佈局綠色供應，抓住市場機會，推動持續成長。

董事長 徐秀蘭



總經理 Mark Lynn England



主辦會計 羅玉婷



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

114年03月27日 單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他管、董事或監察人姓名	職稱	備註	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例						
董事長	中華民國	徐秀蘭	女 61~70歲	113.06.18	三年	100.10.01	847,879	0.18%	847,879	0.18%	—	—	—	—	伊諾大學碩士/電腦科學碩 士/中美矽晶 製品(股)公司 總經理	註一	研發製 造副 總	徐文慶	兄弟	註九
董事	中華民國	中美矽晶 製品(股) 公司代表 人： 盧明光	男 71~80歲	113.06.18 113.06.18	三年 三年	100.10.01 100.10.01	223,007,864 1,000,000	46.64% 0.21%	223,007,864 1,000,000	46.64% 0.21%	—	—	—	—	榮 大 學 博 士 / 譽 工 同 大 學 博 士 / 譽 工 業 技 術 研 究 院 院 士 / 中 美 矽 晶 製 品 (股) 公 司 董 事 長 / 朋 程 科 技 (股) 公 司 董 事 長 / 敦 南 科 技 (股) 公 司 總 經 理 / 旭 興 科 技 (股) 公 司 總 經 理 / 旭 麗 (股) 公 司 副 總 經 理	註二	無 無	無 無	—	
董事	中華民國	中美矽晶 製品(股)	男 61~70歲	113.06.18 113.06.18	三年 三年	100.10.01 100.10.01	223,007,864 202,253	46.64% 0.04%	223,007,864 202,253	46.64% 0.04%	—	674	—	—	淡江大學管 研所碩士/中	註三	無 無	無 無	無 無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷(學) 美砂晶製品(股)公司總經理/旭興科技(股)公司製造處協理	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配關係或二親等以內管、董、監、察人			備註
							股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	陳國洲	男 61~70歲	113.06.18	三年	103.05.26	665,773	0.14%	665,773	0.14%	—	—	—	—	無	註四	無	無	無	—
獨立董事	中華民國	于明仁	男 51~60歲	113.06.18	三年	110.08.24	—	—	—	—	—	—	—	—	無	註五	無	無	無	—
獨立董事	中華民國	羅達賢	男 71~80歲	113.06.18	三年	112.06.20	—	—	—	—	—	—	—	—	無	註六	無	無	無	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷(學)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以上其他監事或監察人關係			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	吳琮璿	女 61~70歲	113.06.18	三年	113.06.18	—	—	—	—	—	—	—	—	電通副總經理/美商儀德公司 台灣儀器公司 管	無	無	無	—	
獨立董事	中華民國	蔡子萱	女 41~50歲	113.06.18	三年	113.06.18	—	—	—	—	—	—	—	—	洛會理大教督會中 立金駐作董券益櫃 心 化博技工所 工 學系科 工 學北資 大研所 程學 長北資 大	註七	無	無	無	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷(學)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主要股東、董事或監察人			備註	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		

註一：目前兼任環球晶圓(股)公司執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、朋程科技(股)公司法人董事代表人、宏捷科技(股)公司法人董事代表人、台灣特品化學(股)公司董事長、SAS Sunrise Inc.法人董事代表人、旭仁能源(股)公司董事長、中美鑫投資(股)公司董事長、續興(股)公司董事長、旭愛能源(股)公司董事長、GlobalSemiconductor Inc.董事、GlobiTech Incorporated 董事長及執行長、GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事長、MEMC Japan Limited 董事長、昆山中辰矽晶有限公司副董事長、Topsil GlobalWafers A/S 董事長、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事、GlobalWafers B.V.董事、MEMC Korea Company 董事、GlobalWafers America, LLC 董事長、兆遠科技(股)公司董事長、Crystalwise Technology (HK) Limited 董事、環球晶資本(股)公司董事長、台達電子工業(股)公司獨立董事。

註二：目前兼任中美矽晶製品(股)公司董事及榮譽董事長、朋程科技(股)公司董事長、瑞柯科技(股)公司董事長、大青節能科技(股)公司董事長、傳承光電(股)公司法人董事代表人、光寶科技(股)公司獨立董事、中美鑫投資(股)公司董事長、瑞柯科技(股)公司法人董事代表人。

註三：目前兼任中美矽晶製品(股)公司副董事長、朋程科技(股)公司董事長及執行長、宏捷科技(股)公司法人董事代表人、瑞柯科技(股)公司法人董事代表人、鼎崑科技(股)公司法人董事代表人、台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人、旭仁能源(股)公司法人董事代表人、中美鑫投資(股)公司法人董事代表人、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事、GlobalWafers America, LLC 董事、元鴻(山東)光電材料有限公司董事。

註四：目前兼任南海光電科技(股)公司董事。

註五：目前兼任臺灣水泥(股)公司財務長、飛宏科技(股)公司法人董事代表人、和平電力(股)公司法人監察人代表人、中聯資源(股)公司法人董事代表人。

註六：目前兼任中華民國企業經理協進會理事長、工業技術研究院特聘專家、財團法人潘文淵文教基金會執行長、工業技術研究院友會秘書長、清華大學科技管理研究所兼任教授。

註七：目前兼任中華精測科技(股)公司獨立董事、金寶電子工業(股)公司獨立董事。

註八：目前兼任臺北科技大學資源工程研究所副教授、臺北科技大學材料及資源工程系副教授。

註九：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼任執行長，係考量公司之營運規模及為提升整體經營效率，本公司另設有總經理職位，執行長與總經理二者職權劃分不同，執行長重於規劃面(主要職掌為擬訂本公司經營方針、年度預算計畫、重要客戶關係維繫、策略聯盟規劃、轉投資佈局規劃及年度計畫實績達成情形追繳等)，總經理負責執行面(負責本公司業務之執行、協調並指揮監督所屬以達成營運目標，同時貫徹本公司之政策與執行長所規劃之經營策略及相關營運事項)，二者相輔相成；本公司由董事長兼任執行長，能有效將董事會學劃之公司發展藍圖落實到規劃執行面，亦能提高董事會對公司營運狀況之掌握度。本公司董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人，且董事會設有四席獨立董事席次，各功能性委員會成員並多數由獨立董事擔任，就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議，可強化董事會之監督職能及落實公司治理。

1. 法人股東之主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東
中美矽晶製品股份有限公司	弘望投資股份有限公司(3.91%)、華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶(3.57%)、台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶(3.44%)、合作金庫商業銀行股份有限公司(2.41%)、南山人壽保險股份有限公司(2.34%)、張清照(2.17%)、臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息 30 ETF 證券投資信託基金專戶(2.16%)、威連科技股份有限公司(2.05%)、凱基人壽保險股份有限公司(1.76%)、盧明光(1.73%)

2. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

法人名稱	法人之主要股東
弘望投資股份有限公司	威連科技股份有限公司(39.02%)、環球晶圓股份有限公司(30.98%)、朋程科技股份有限公司(30.00%)
威連科技股份有限公司	弘茂投資股份有限公司(30.46%)、全德投資股份有限公司(10.75%)

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立董事獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 徐秀蘭	<p>徐秀蘭女士於美國伊利諾大學取得電腦科學碩士學位，歷任中美矽晶業務協理、副總經理及總經理，自環球晶圓從中美矽晶分割獨立後，徐秀蘭女士便擔任環球晶圓董事長，目前亦身兼中美矽晶董事長。徐秀蘭女士在半導體產業浸淫超過30年，身為高階經理人，對於公司經營所需的商務、法務、財務及會計等專業領域皆有涉獵，經驗豐富並充分具備公司營運所需之專業及能力。</p> <p>徐秀蘭女士未有公司法第30條所列之情事。</p>	不適用	1
董事 中美矽晶製品(股)公司 代表人： 盧明光	<p>盧明光先生為交通大學榮譽工學博士、大同大學名譽工學博士及工業技術研究院院士。盧明光先生歷任敦南科技及旭興科技總經理、中美矽晶董事長、及朋程科技董事長，目前為中美矽晶榮譽董事長及朋程科技榮譽董事長。</p> <p>盧明光先生在半導體產業服務超過40年，在企業經營上屢創佳績，擁有卓越管理能力、前瞻獨特眼界、商務談判技巧及深厚財會知識，充分具備公司營運所需的智慧及專業。</p> <p>盧明光先生未有公司法第30條所列之情事。</p>	不適用	1
董事 中美矽晶製品(股)公司 代表人： 姚宕梁	<p>姚宕梁先生於淡江大學管理研究所取得碩士學位，歷任中美矽晶總經理、旭興科技協理及兆遠科技董事長，目前為中美矽晶副董事長及朋程科技董事長。姚宕梁先生在產業深耕40年，具備豐沛的製造生產及管理知識，多年的高階管理人經驗使姚宕梁先生對於公司營運管理相當熟稔，具備豐富的跨領域企業經驗，能依不同總體經濟及產業情境提出獨特的觀點及建議。</p> <p>姚宕梁先生未有公司法第30條所列之情事。</p>	不適用	-
董事 陳國洲	<p>陳國洲先生畢業於南英商工，曾任南海光電科技(股)公司董事長及三信商業銀行董事。</p> <p>陳國洲先生對於資本市場及金融體系相當熟稔，亦對產業環境反應敏銳，對於公司營運方向及策略可以提供即時的觀點及見解，提供調整方向及建議。</p> <p>陳國洲先生未有公司法第30條所列之情事。</p>	不適用	-

<p>獨立董事 于明仁</p>	<p>于明仁先生於美國紐約大學取得企管碩士，歷任摩根大通銀行副總經理、中強光電財務長及背光模組事業群總經理、元大證券執行副總及富智康集團資深副總及執行董事、及台光電子財務長。</p> <p>于明仁先生深耕銀行及產業雙領域，同時具備廣博財務金融知識與豐富業界實務操作。于明仁先生的專業、學識及財務專長對於營運規模迅速成長的環球晶圓而言有相當助益。</p> <p>于明仁先生未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。</p>	<p>于明仁先生符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額未超過法定限額...等。</p>	-
<p>獨立董事 羅達賢</p>	<p>羅達賢先生為交通大學科技管理研究所博士，歷任工業技術研究院產業學院執行長、冠臣電子股份有限公司副總經理，亦曾作為兼任教授服務於清華大學、交通大學與逢甲大學，並擔任過中華民國科技管理學會理事長/秘書長及教育部大學責任計畫主審委員。</p> <p>羅達賢先生在學術界及教育界享有盛名，環球晶圓的成長節奏快速，羅達賢先生在科技產業及管理方面的豐富學識能為公司團隊帶來建設性的支持與建言，對於環球晶圓大有助益。</p> <p>羅達賢先生未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。</p>	<p>羅達賢先生符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額未超過法定限額...等。</p>	-
<p>獨立董事 吳琮璠</p>	<p>吳琮璠女士為美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)會計資訊管理博士，曾於臺灣大學會計系任教超過 25 年，歷任金融監督管理委員會專任委員、合作金庫銀行常駐監察人、合作金庫金控董事、台灣證券交易所公益董事、證券櫃檯買賣中心公益董事等職務，並曾擔任多家公司之獨立董事，包括中華電信、臺灣永光化學工業、中華精測科技、金寶電子、台灣糖業等。</p> <p>吳琮璠女士於產官學界歷練豐富，尤其於金融與證券法規、資訊科技與會計分析等領域具備淵博知識與豐沛實務經驗，其專業知識及跨界經驗有助於環球晶圓建構更穩健完善的營運及財務運作。</p> <p>吳琮璠女士未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。</p>	<p>吳琮璠女士符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額未超過法定限額...等。</p>	2
<p>獨立董事 蔡子萱</p>	<p>蔡子萱女士為臺灣大學化學工程系博士，目前為臺北科技大學資源工程研究所副教授及臺北科技大學材料及資源工程系副教授。</p> <p>蔡子萱女士的研究領域包括電化學工程、半導體製程、腐蝕工程、光電元件製程、以及能源科技等，其專業學識對於公司的研發方向及技術發展有相當大的裨益。</p> <p>蔡子萱女士未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。</p>	<p>蔡子萱女士符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額未超過法定限額...等。</p>	-

4. 董事會多元化及獨立性：

一、董事會多元化：

本公司「公司治理實務守則」已有規範董事會成員之組成及整體應具備之能力，並訂有董事會成員多元化政策。本公司董事會成員組成已考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，如以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力
- 二、會計及財務分析能力
- 三、經營管理能力
- 四、危機處理能力
- 五、產業知識
- 六、國際市場觀
- 七、領導能力
- 八、決策能力

本公司董事會成員落實多元化情形如下

董事姓名	多元化核心項目	性別	年齡				兼任 本公司 員工	獨立董事 任期年資		營運 判斷 能力	會計 及 財務 分析 能力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	產業 技術	國際 市場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力	大專 院校 教授 資歷
			41 歲 至 50 歲	51 歲 至 60 歲	61 歲 至 70 歲	71 歲 至 80 歲		3 年 以 內	3 至 6 年										
			徐秀蘭	女				✓											
中美矽晶製品股份有限公司 代表人：盧明光	男				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
中美矽晶製品股份有限公司 代表人：姚宕梁	男			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
陳國洲	男			✓					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
于明仁（獨立董事）	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
羅達賢（獨立董事）	男				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳琮璠（獨立董事）	女			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
蔡子萱（獨立董事）	女	✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

本公司第六屆董事會由 8 位董事組成，包含 4 位獨立董事，除有 3 名女性董事外，董事並分別具有營運管理、專業技術、商務及財務之相關豐富產學經驗，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司現任 8 位董事中，具員工身分之董事占比 12.5%，獨立董事占比 50%，女性董事占比 37.5%，4 位獨立董事中 3 位任期年資在 3 年以下、1 位介於 3 至 6 年。本公司注重董事會成員組成之產業經驗分佈，目標為半數以上董事具有半導體產業相關經驗，現任董事中具有半導體產業相關經驗者占比 62.5%；此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別分佈，女性董事目標為至少一席以上，目前本公司女性董事為三席，占比 37.5%，達到公司董事任一性別均達董事會席次三分之一以上。

二、董事會獨立性：

本公司第六屆董事會由 8 位董事組成，包含 4 位獨立董事，獨立董事占比 50%，獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，另董事組成無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事（董事間、監察人間或董事與監察人間未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形），本公司董事會組成符合獨立性之要求。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114年3月27日 單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	徐秀蘭	女	100.10.01	847,879	0.18%	—	—	—	—	伊利諾大學電腦科學碩士/中美矽晶製品(股)公司總經理	註一	研發暨製造副總	徐文慶	姐弟	註七
總經理	美國	Mark Lynn England	男	103.10.01	—	—	—	—	—	—	University of Texas, Austin, Texas, BBA, Engineering Management/ GlobalWafers Co.Ltd. V.P., Sales & Marketing / Texas Instruments Manager, Product Engineering	註二	無	無	無	—
研發副總 製造副總	中華民國	徐文慶	男	103.09.02	17,778	0.00%	—	—	—	—	清華大學奈米工程與微系統研究所博士/工研院化工所研究員/中美矽晶製品(股)公司研發中心副總	無	執行長	徐秀蘭	姐弟	—
行銷副總	中華民國	洪聖雄	男	104.03.19	—	—	—	—	—	—	美國波士頓大學製造工程碩士/昆山中辰矽晶有限公司行銷及研發副總	註三	無	無	無	—
企業發展副總	中華民國	李崇偉	男	106.03.21	—	—	—	—	—	—	日本明治大學經營學士&企業碩士/Covalent Materials Taiwan 總經理兼執行副總/台灣三井物產協理	註四	無	無	無	—
行銷協理	中華民國	尤天文	男	107.03.20	8,510	0.00%	—	—	—	—	台北商業專科學校企業管理科/中美矽晶製品(股)公司行銷副處長	註五	無	無	無	—
行銷協理	中華民國	何禧樂	女	113.05.07	—	—	—	—	—	—	陽明交通大學 EMBA 碩士/ Covalent Materials Taiwan 行銷業務副理	無	無	無	無	—
財務副總	中華民國	簡明輝	男	103.09.02	19,730	0.00%	—	—	—	—	台北大學企業管理研究所碩士/日盛國際商業銀行業務管理部經理、旭泓全球光電(股)公司財務經理	註六	無	無	無	—
會計經理	中華民國	羅玉婷	女	107.03.23	—	—	—	—	—	—	國立成功大學會計系/安侯建業聯合會計師事務所審計部經理、光寶科技(股)公司會計副理、凌陽科技(股)公司會計副理	無	無	無	無	—
中德分公司 總經理	中華民國	薛銀陞	男	109.01.02	—	—	—	—	—	—	俄亥俄州立大學材料工程所博士/中德電子材料(股)公司總經理	無	無	無	無	—
中德分公司 研發副總	中華民國	陳亮欽	男	109.02.01	—	—	—	—	—	—	明尼蘇達大學化工材料所博士/德商世創電子台灣技術總監/中德電子材料(股)公司工程技術暨研發副總	無	無	無	無	—
中德分公司 產品/產品 整合副總	中華民國	黃耀毅	男	109.02.01	—	—	—	—	—	—	清華大學高階經營管理碩士/中德電子材料(股)公司品質與產品整合副總、MEMC 全球客戶品質總監、聯華電子中央品質保資深經理	無	無	無	無	—
中德分公司 生產副總	中華民國	黃俊榮	男	109.02.01	—	—	—	—	—	—	成功大學機械工程所碩士/中德電子材料(股)公司生產副總	無	無	無	無	—

中德分公司 專案副總	中華民國	黃俊偉	男	109.02.01	—	—	—	—	—	清華大學動力機械系中德電子材料(股)公司專案協理	無	無	無	無	—
---------------	------	-----	---	-----------	---	---	---	---	---	--------------------------	---	---	---	---	---

註一：目前兼任中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、朋程科技(股)公司法人董事代表人、宏捷科技(股)公司法人董事代表人、台灣特品化學(股)公司董事長、SAS Sunrise Inc.法人董事代表人、旭仁能源(股)公司董事長、中美鑫投資(股)公司董事長、續興(股)公司董事長、GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事長、MEMC Japan Ltd.董事長、昆山中辰矽晶有限公司副董事長、Topsil GlobalWafers A/S 董事長、GlobiTech Incorporated 董事長及執行長、GlobalWafers A/S 董事長、策略聯盟規畫、策劃、轉投資佈局規畫及年度計畫實際達成情形追蹤等)、總經理負責執行面(負責本公司業務之執行、協調並指揮監督所屬以達成營運目標,同時貫徹本公司之政策與執行長所規畫之經營策略及相關營運事項),二者相輔相成;本公司由董事長兼任執行長,能有效將董事會擊劃之公司發展藍圖落實到規畫執行面,亦能提高董事會對公司營運狀況之掌握度。本公司董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人,且董事會設有四席獨立董事席次,各功能性委員會成員並多數由獨立董事擔任,就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議,可強化董事會之監督職能及落實公司治理。

註二：目前兼任 GlobiTech Incorporated 董事長及總經理、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. 董事、MEMC Korea Company 董事、MEMC LLC 董事及總經理、GlobalWafers America, LLC 董事及總經理。

註三：目前兼任昆山中辰矽晶有限公司董事長、昆山辰巨電子科技有限公司董事長、晶化科技(股)公司法人董事代表人。

註四：目前兼任中美矽晶製品(股)公司企業發展副總經理及發言人。

註五：目前兼任昆山辰巨電子科技有限公司董事。

註六：目前兼任中美矽晶製品(股)公司採購副總、旭仁能源(股)公司法人監察人代表人、續興(股)公司法人董事代表人、續律能源(股)公司法人董事代表人、艾涅爾電力(股)公司法人董事代表人、旭愛能源(股)公司法人董事代表人、旭信電力(股)公司董事長、弘望投資(股)公司法人董事代表人、GlobiTech Incorporated 董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事、昆山中辰矽晶有限公司監察人、Topsil GlobalWafers A/S 董事、MEMC Electronic Materials S.p.A. 董事、MEMC Electronic Materials Sdn. Bhd. 董事、GlobalWafers GmbH 董事、兆遠科技(股)公司法人董事代表人、上海召業申凱電子材料有限公司董事。

註七：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時,應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊:

本公司董事長兼任執行長,係考量公司之營運規模及為提升整體經營效率,本公司另設有總經理職位,執行長與總經理二者職權劃分不同,執行長重於規畫面(主要職掌為擬訂本公司經營方針、年度預算計畫、重要客戶關係維繫、策略聯盟規畫、轉投資佈局規畫及年度計畫實際達成情形追蹤等),總經理負責執行面(負責本公司業務之執行、協調並指揮監督所屬以達成營運目標,同時貫徹本公司之政策與執行長所規畫之經營策略及相關營運事項),二者相輔相成;本公司由董事長兼任執行長,能有效將董事會擊劃之公司發展藍圖落實到規畫執行面,亦能提高董事會對公司營運狀況之掌握度。本公司董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人,且董事會設有四席獨立董事席次,各功能性委員會成員並多數由獨立董事擔任,就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議,可強化董事會之監督職能及落實公司治理。

二、最近年度(113年)給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金：

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金								
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例			本公司	財務報表內所有公司						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報表內所有公司									
董事	徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司 代表人：盧明光 中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚宥梁 陳國洲	10	財務報告內所有公司	0	財務報告內所有公司	32,690	35,490	180	180	32,880	35,680	3,680	0	36,000	0	72,560	75,360	0.7369%	0.7654%	33,231
獨立董事	鄭正元(註1)	2,850	財務報告內所有公司	0	財務報告內所有公司	4,000	4,000	180	180	7,030	7,030	0	0	0	0	7,030	7,030	0.0714%	0.0714%	0
	王鍾淪(註1)																			
	于明仁																			
	羅達賢																			
	吳琮瑤																			
	蔡子萱																			

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司除每月支付獨立董事酬勞外，公司得視獨立董事對公司營運參與之程度與貢獻，及參酌其董事事績評估結果，另由依年度獲利狀況所提撥之董事酬勞中分別決定獨立董事之董事酬勞分配數額。前述獨立董事獲配之酬勞數額，經薪資報酬委員會審議通過後，提請董事會決議。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：因應本公司 113 年度股東會全面改選董事，已於 113 年 6 月 18 日股東會改選後卸任。

註 2：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過 113 年度決議配發之董事酬勞金額，表列金額係為估算數。

註 3：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過 113 年度分派之員工酬勞金額，表列金額係為估算數。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	獨立董事： 鄭正元(註)、 王鍾渝(註)、 吳琮璠、 蔡子萱	獨立董事： 鄭正元(註)、 王鍾渝(註)、 吳琮璠、 蔡子萱	獨立董事： 鄭正元(註)、 王鍾渝(註)、 吳琮璠、 蔡子萱	獨立董事： 鄭正元(註)、 王鍾渝(註)、 吳琮璠、 蔡子萱
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	獨立董事： 于明仁、 羅達賢	獨立董事： 于明仁、 羅達賢	獨立董事： 于明仁、 羅達賢	獨立董事： 于明仁、 羅達賢
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	一般董事： 徐秀蘭、中美 矽晶製品(股) 公司(代表 人：盧明光、 姚宕梁)、陳 國洲	一般董事： 中美矽晶製品 (股)公司(代表 人：盧明光、姚 宕梁)、陳國洲	一般董事： 中美矽晶製 品(股)公司 (代表人：盧 明光、姚宕 梁)、陳國洲	一般董事： 中美矽晶製 品(股)公司 (代表人：盧 明光、姚宕 梁)、陳國洲
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	一般董事： 徐秀蘭	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	一般董事： 徐秀蘭	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	一般董事： 徐秀蘭
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	共 10 人	共 10 人	共 10 人	共 10 人

註：因應本公司 113 年度股東會全面改選董事，已於 113 年 6 月 18 日股東會改選後卸任。

(二) 總經理及副總經理之酬金：

113年12月31日 單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額(D)(註2)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司
執行長	徐秀蘭														
總經理	Mark Lynn England														
副總經理	徐文慶														
副總經理	陳偉文(註1)														
副總經理	洪聖雄														
副總經理	李崇偉														
副總經理	簡明輝														
中德分公司總經理	薛銀陞	36,945	43,688	792	792	32,329	32,899	73,700	0	83,000	0	143,766	160,379	1.46%	9,300
中德分公司副總經理	陳亮欽														
中德分公司副總經理	黃耀毅														
中德分公司副總經理	黃俊榮														
中德分公司副總經理	黃俊偉														

註1：原行政暨資材暨採購副總陳偉文先生於113年5月1日辭任。

註2：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過113年度分派總經理及副總經理之員工酬勞金額，表列金額係為估算數。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	李崇偉、陳偉文	李崇偉、陳偉文
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	Mark Lynn England、黃俊偉	黃俊偉
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	徐文慶、洪聖雄、簡明輝、 陳亮欽、黃耀毅、黃俊榮	徐文慶、洪聖雄、簡明輝、 陳亮欽、黃耀毅、黃俊榮
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	薛銀陞	Mark Lynn England、薛銀陞
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	徐秀蘭	徐秀蘭
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	共 12 人	共 12 人

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113年12月31日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	徐秀蘭	—	80,700	80,700	0.82%
	總經理	Mark Lynn England				
	副總經理	徐文慶				
	副總經理	陳偉文(註 1)				
	副總經理	洪聖雄				
	副總經理	李崇偉				
	行銷協理	尤天文				
	行銷協理	何禧樂				
	財務副總	簡明輝				
	會計經理	羅玉婷				
	中德分公司總經理	薛銀陞				
	中德分公司副總經理	陳亮欽				
	中德分公司副總經理	黃耀毅				
	中德分公司副總經理	黃俊榮				
中德分公司副總經理	黃俊偉					

註 1：原行政暨資材暨採購副總陳偉文先生於 113 年 5 月 1 日辭任。

註 2：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過 113 年度分派經理人之員工酬勞金額，表列金額係為估算數。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例之分析

單位：%

職 稱	113 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)		112 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董 事	0.41%	0.43%	0.39%	0.41%
總經理及副總經理	1.46%	1.63%	1.06%	1.22%

註：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過 113 年度分派之董事酬勞金額以及分派經理人之員工酬勞金額，表列比例係為估算數。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 本公司董事酬金包含董事報酬、董事酬勞、及業務執行費用三大項，係依公司章程及相關規定辦理；總經理及副總經理酬金包含薪資、獎金及員工酬勞三類，係依公司章程及核決權限訂定之。

(2) 訂定酬金之程序

本公司章程規定：「本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。」董事酬勞之訂定，係以董事對公司營運參與之程度與貢獻，及參酌其董事績效評估結果，依公司章程及「董事及功能性委員會酬金給付辦法」規定辦理。總經理及副總經理所領取之酬金係依據公司章程以及每年董事會所通過年度預算之營運績效額度，併同考量其所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，另參酌同業水準議定之，並依「經理人薪資報酬管理辦法」及「員工酬勞分派辦法」程序辦理。

本公司於 103 年 9 月 2 日成立薪資報酬委員會，該委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；以及定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額，並呈送董事會決議。

(3) 經營績效及未來風險之關連性

本公司董事及經理人之績效評估及酬金支付除參考其所任職位、對公司營運參與程度（包含董事之出席率、溝通頻率、提供之建議...等）、個人績效貢獻（包含財務性指標如營收及獲利達成率，以及非財務性指標如法令及內控遵循、ESG 績效指標，或特殊功績...等）及參酌同業通常水準外，並綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來面臨之風險等事項，與其所負公司經營責任及整體績效呈高度關連性。

於非財務性指標方面，為落實本公司對永續發展之承諾，亦將 ESG（環境、社會、治理）等非財務績效面向納入本公司高階經理人績效評估範圍（高階經理人包括總經理、副總經理、各廠廠長等），ESG 績效指標項目及權重占比依據高階經理人其職務範圍及內容個別訂定，ESG 績效指標項目包括國內外相關 ESG 評鑑評等、減緩氣候變遷與調適相關作為（如溫室氣體減量、節能減碳目標達成率、再生能源使用比率等）、環境管理績效（水資源、廢棄物管理目標達成率）、職業安全衛生推動...等，權重占比則於 20% 以內分別訂定，高階經理人於其績效考核時依據上述個別之 ESG 績效指標項目之達成情形以及權重占比將其 ESG 績效納入考核計算以評定薪酬。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

本屆董事會董事任期為 113 年 6 月 18 日至 116 年 6 月 17 日，113 年度董事會開會 9 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
董事長	徐秀蘭	9	0	100%	第六屆 (113年6月18日選任)
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：盧明光	9	0	100%	
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚宕梁	9	0	100%	
董事	陳國洲	9	0	100%	
獨立董事	于明仁	9	0	100%	
獨立董事	羅達賢	9	0	100%	
獨立董事	吳琮璠	4	0	100%	
獨立董事	蔡子萱	4	0	100%	
獨立董事	鄭正元	5	0	100%	113年6月18日 卸任
獨立董事	王鍾渝	5	0	100%	
其他應記載事項：					
<p>一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：</p> <p>(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。</p> <p>(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。</p> <p>二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：</p> <p>1. 113 年 5 月 7 日第五屆第二十一一次董事會：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 議案內容：本公司 112 年度董事酬勞分配案 ■ 利益迴避董事：全體董事個別利益迴避 ■ 應利益迴避原因以及參與表決情形：本案依個別董事酬勞逐項表決，個別董事於討論及決議其個人酬勞時，因利益迴避，不參與討論及表決。 <p>2. 113 年 5 月 7 日第五屆第二十一一次董事會：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 議案內容：本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案 ■ 利益迴避董事：徐秀蘭 ■ 應利益迴避原因以及參與表決情形：董事長徐秀蘭女士因兼任執行長具有經理人身份，因利益迴避，不參與討論及表決。 <p>3. 113 年 6 月 18 日第六屆第一次董事會：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 議案內容：委任第五屆薪資報酬委員會委員案 ■ 利益迴避董事：于明仁、羅達賢、吳琮璠、蔡子萱 ■ 應利益迴避原因以及參與表決情形：獨立董事于明仁先生、羅達賢先生、吳琮璠女士、蔡子萱女士為薪資報酬委員會委員人選，因利益迴避，不參與討論及表決。 					

4. 113年6月18日第六屆第一次董事會：

- 議案內容：委任第三屆提名委員會委員案
- 利益迴避董事：徐秀蘭、于明仁、羅達賢、吳琮璿、蔡子萱
- 應利益迴避原因以及參與表決情形：董事長徐秀蘭女士以及獨立董事于明仁先生、羅達賢先生、吳琮璿女士、蔡子萱女士為提名委員會委員人選，因利益迴避，不參與討論及表決。

三、董事會及功能性委員會評鑑執行情形：

評估週期：每年執行一次

評估期間：對113年1月1日至113年12月31日之績效進行評估

提報董事會日期：114年2月25日

評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
董事會	董事自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 6. 對永續經營(ESG)之關注	各面向平均得分率皆達到標準以上，顯示整體董事會運作狀態良好，符合公司治理需求。
個別董事成員	董事自評	1. 公司目標與任務之掌握及對永續經營(ESG)之關注 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	各面向平均得分率皆達到標準以上，顯示各董事對於其參與董事會情形與董事會運作具有正面且高度的評價。
審計委員會	董事自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制	各面向平均得分率皆達到標準以上，顯示整體審計委員會運作狀態良好，符合公司治理需求。
薪資報酬委員會	董事自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任	各面向平均得分率皆達到標準以上，顯示整體薪資報酬委員會運作狀態良好，符合公司治理需求。
提名委員會	董事自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提名委員會職責認知 3. 提升提名委員會決策品質 4. 提名委員會組成及成員選任	各面向平均得分率皆達到標準以上，顯示整體提名委員會運作狀態良好，符合公司治理需求。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

1. 設置獨立董事及審計委員會，加強專業董事獨立客觀功能，監督董事會運作：本公司於104年1月19日股東臨時會改選董事，並選任三席獨立董事，同時成立審計委員會取代監察人制度。
2. 設立薪酬委員會協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，並定期檢討董

事及經理人等之報酬是否合宜。

3. 設置提名委員會協助公司覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人，並建構及發展董事會及各委員會之組織架構。
4. 持續提昇資訊透明度：本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新等，並設置投資人專區提供財業務資訊，以及利害關係人專區提供利害關係人暢通及有效的多向溝通管道。
5. 提昇董事會職能及專業知識：本公司已制定「董事會議事規範」加強落實董事會之職能，另本公司鼓勵董事會成員參與各項專業課程，並於董事會進行相關法令宣導，以提昇董事會決策能力及符合相關法令規範。
6. 設置公司治理主管協助董事執行職務並提升董事會效能：本公司於 108 年 5 月 7 日董事會通過設置公司治理主管，並訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，以即時有效協助董事執行職務之原則處理董事要求事項，以增加本公司對董事之支援及加強公司治理相關法令規章之遵循。

(二) 審計委員會運作情形：

本公司於 104 年 1 月 19 日設置審計委員會取代監察人制度。

本屆審計委員會委員任期為 113 年 6 月 18 日至 116 年 6 月 17 日，113 年度審計委員會共召開 8 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事 (召集人)	于明仁	8	0	100%	第四屆 (113 年 6 月 18 日選任)
獨立董事	羅達賢	8	0	100%	
獨立董事	吳琮璿	3	0	100%	
獨立董事	蔡子萱	3	0	100%	
獨立董事	鄭正元	5	0	100%	113 年 6 月 18 日卸任
獨立董事	王鍾渝	5	0	100%	

審計委員會成員之專業資格與經驗請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容

審計委員會之組成與運作：
本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，委員會之運作以下列事項之監督為主要目的：
(一) 公司財務報表之允當表達。
(二) 簽證會計師之選(解)任及其能力資格、獨立性與績效。
(三) 公司內部控制之有效實施。
(四) 公司遵循相關法令及規則。
(五) 公司存在或潛在風險之管控。

其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：
113 年度各議案均經審計委員會全體出席委員同意通過後經董事會全體出席董事同意通過，議案內容請詳下表(五、審計委員會年度運作情形)。
(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：
(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通
1.本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。
2.本公司簽證會計師每季於審計委員會議中，針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及其他法令要求之溝通事項向獨立董事進行報告。
(二)113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
113.02.27 審計委員會	112 年度內部稽核業務報告 112 年度內部控制制度聲明書	無異議

113.05.07 審計委員會	113 年度第一季內部稽核業務報告	無異議
113.08.06 審計委員會	113 年度第二季內部稽核業務報告	無異議
113.11.05 審計委員會	113 年度第三季內部稽核業務報告 114 年度內部稽核計劃	無異議

(三) 113 年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
113.02.27 審計委員會	112 年度合併及個體財務報告查核結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議
113.05.07 審計委員會	113 年第一季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議
113.08.06 審計委員會	113 年第二季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議
113.11.05 審計委員會	113 年第三季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議

四、審計委員會年度工作重點彙整：

113 年度審計委員會共召開 8 次，審議的事項主要包括一

1. 審核財務報表及會計政策與程序：
審核 112 年度財報及 113 年度第一季至第三季財報。
2. 內部控制制度及其有效性之考核：
審核內部稽核報告及 112 年度內部控制制度之有效性。
3. 修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之處理程序；審核重大之資產、衍生性商品、資金貸與及背書或保證交易。
4. 簽證會計師之委(解)任、報酬、適任性、獨立性及其績效：
審核 112 年度簽證會計師之適任性、獨立性及其績效，以及 113 年度簽證會計師之委任。
5. 財務、會計或內部稽核主管之任免。

五、審計委員會年度運作情形：

審計委員會 期別/日期	議案內容	證交 法第 14-5 所列 事項	審計委員 會決議結 果及公司 對審計委 員會意見 之處理
第三屆 第十八次 113.01.16	1.為本公司之德國子公司 GlobalWafers GmbH 擬發行海外附認股權公司債，本公司並擬就所發行之海外附認股權公司債提供保證。	V	經審計委員會全體出席委員同意通過後經董事會全體出席董事同意通過
第三屆 第十九次 113.02.27	1.內部稽核業務報告案	V	
	2.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估報告案	V	
	3.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	V	
	4.配合會計師事務所內部業務調整，變更本公司簽證會計師案	V	
	5.本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案	V	
	6.修訂本公司內部控制制度案	V	
	7.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案	V	
8.本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證	V		

	9.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案	V
	10.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案	V
	11.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案	V
	12.修訂本公司「審計委員會組織規程」案	V
	13.修訂本公司「預先核准非確信服務之政策之一般原則方法」	V
	14.關係企業間交易公司代表人選任	V
第三屆 第二十次 113.04.10	1.本公司擬設立台灣子公司環球晶資本股份有限公司案	V
	2.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函（LOS）案	V
第三屆 第二十一次 113.05.07	1.內部稽核業務報告案	V
	2.本公司風險管理之年度執行情形報告	V
	3.本公司 113 年度第一季合併財務報告案	V
	4.本公司 112 年度盈餘分配表暨 112 年下半年度盈餘分派案	V
	5.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案	V
	6.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案	V
	7.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案	V
	8.本公司為子公司兆遠科技股份有限公司出具背書保證案，因兆遠科技股份有限公司 112 年第 4 季財報淨值已低於實收資本額二分之一，依本公司背書保證辦法擬具後續相關管控措施	V
	9.本公司為子公司 GlobalWafers GmbH 出具背書保證案，因 GlobalWafers GmbH 自 110 年第 1 季起財報淨值已低於實收資本額二分之一，依本公司背書保證辦法擬具後續相關管控措施	V
第三屆 第二十二次 113.06.13	1.本公司資金貸與子公司案	V
	2.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案	V
第四屆 第一次 113.08.06	1.衍生性金融商品承作報告案	V
	2.內部稽核業務報告案	
	3.本公司 113 年度第二季合併財務報告案	V
	4.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函(LOS)案	V
	5.為子公司旭愛能源股份有限公司與高雄市立鳳翔國民中學簽訂租賃契約，由本公司擔任連帶保證人案	V
第四屆 第二次 113.11.05	1.衍生性金融商品承作報告案	
	2.內部稽核業務報告案	V
	3.本公司 113 年度第三季合併財務報告案	V
	4.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案	V
	5.本公司 114 年度內部稽核計畫	V
	6.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函(LOS)案	V
	7.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案	V
	8.本公司資金貸與子公司案	V
	9.為子公司申請美國《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）直接補助（Direct Funding），由本公司擔任保證人案	V
	10.修訂本公司「預先核准非確信服務之政策之一般原則方法」	V
第四屆 第三次 113.12.10	1.本公司 113 年上半年度盈餘分派案	V
	2.公司向金融機構申請商業本票承銷額度案	V
	3.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函（LOS）案	V
	4.取消為子公司向供應商購置機器設備，由本公司提供保證案	V

	5.為子公司申請美國《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）直接補助（Direct Funding），調整本公司擔任保證人之保證條件案	V	

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」制訂本公司「公司治理實務守則」並揭露於公司網站。
二、公司股權結構及股東權益	V		(一) 本公司委託元大證券股份有限公司服務代理部處理股東相關問題，並且依規定建立發言人制度處理相關事宜，亦於網站上設置投資人專區及利害關係人專區頁面，收納各項提問或建議。
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(二) 本公司掌握董事、經理人及持股5%以上之大股東持股情形。本公司均按月申報相關資訊至公開資訊觀測站。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(三) 本公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，訂有「環球晶圓對子公司之監理辦法」，落實對子公司風險控制機制；並訂定「關係人間財務業務監督及管理作業規範」及「集團企業暨特定公司及關係人交易作業程序」，對關係企業之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項加以規範。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(四) 本公司訂有「防範內線交易管理程序」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		
三、董事會之組成及職責	V		(一) 本公司「公司治理實務守則」已有規範董事會成員之組成及整體應具備之能力，並訂有董事會成員多元化政策。本公司各董事之學經歷、專業資格、獨立性及多元化情形等相關資訊請參閱本報「貳、公司治理報告/(一)董事資料」，以上資訊並同步揭露於公司網站。
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(二) 公司章程載明得於董事會下設置功能性委員會，相關委員會之設置及職權依主管機關所訂辦法進行。本公司目前已設置功能性委員會如下：民國103年設置薪資報酬委員會，目前
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運	V		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	<p>由4位獨立董事組成；民國104年設置審計委員會，目前由4位獨立董事組成；民國106年設置企業永續發展委員會，由經營團隊組成並由董事長擔任主任委員定期向董事會報告；民國109年設置提名委員會，目前由董事長及4位獨立董事組成。</p> <p>(三)本公司訂有經董事會通過之「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，於每年年度結束時，由總經理室統籌，透過內部自評問卷方式進行包括董事會、個別董事成員及功能性委員會（包含審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會）之績效評估，評估結果將呈報董事會並作為個別董事薪資報酬及遴選或提名董事時之參考暨改善董事會及功能性委員會運作效能之建議。評估項目主要包含對公司營運之參與程度、會議決策品質、董事會暨功能性委員會之組成與結構、董事及委員的選任及持續進修以及內部控制等。本公司於114年1月已執行113年度之董事會暨功能性委員會績效評估，各面向評核結果皆達成指標，顯示整體董事會及功能性委員會運作狀態良好，績效評估結果已呈報114年2月25日董事會並揭露於公司網站（請參閱本報「貳、公司治理報告／三、公司治理運作情形／(一)董事會運作情形／三、董事會及功能性委員會評鑑執行情形」相關內容）。此外，本公司並於113年11月5日董事會決議通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，規範本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並將評估結果提報董事會。</p> <p>(四)本公司訂有經董事會通過之「會計師獨立性及績效評估辦法」，每年評估簽證會計師之獨立性、適任性及績效，並將審計品質指標（AQIs）列入評估參考，評估結果將提報審計</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?		<p>摘要說明</p> <p>委員會及董事會通過。本公司於本年度已執行113年度會計師獨立性及適任性評估，評估結果已由114年2月25日審計委員會及董事會審議通過。</p> <p>獨立性指標評估項目包含簽證會計師無擔任審計客戶之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利害關係、簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係及僱傭關係、簽證會計師無宣傳或中介本公司所發行之股票或其他證券等15項；適任性及績效指標評估項目包含服務品質、專業程度及時效配合等項目；審計品質指標 (AQIs) 評估項目則包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面及13項指標—如查核經驗與受訓時數、案件品質管制複核 EQCR、非審計服務占比、外部檢查缺失及處分、及創新規畫或倡議等。</p>	無重大差異
	V	<p>(一)本公司於108年5月7日董事會決議通過設立公司治理主管一職，並於112年12月12日董事會通過由本公司總經理室陳昱如經理擔任現任公司治理主管。陳昱如經理已具備公開發行公司從事財務、服務主管職務經驗達三年以上，且未兼任本公司或其他公司之任何其他職務。</p> <p>本公司公司治理主管負責帶領及督導總經理室進行公司治理相關事務之辦理及提供董事支援，職權範圍包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																
	是	否																	
		<p>摘要說明</p> <p>7. 辦理董事異動相關事宜。 8. 其他依公司章程所訂定之事項等。</p> <p>(二)本年度公司治理主管業務執行情形如下： 1. 擬定及規劃公司治理相關規章辦法之檢視及增修訂以落實法令遵循。 2. 提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。 3. 協助新任董事就任及提供相關支援。 4. 安排個別董事之進修課程（每位董事每年度至少受訓6小時，新任董事當年度至少受訓12小時）。 5. 各次董事會議之規劃及至少於會議7日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後20日內寄發董事會議事錄。 6. 依法辦理股東會事前登記，製作開會通知，議事手冊，年報與議事錄，並辦理公司變更登記。 7. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</p> <p>(三)公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時。最近年度及截至年報刊印日止，公司治理主管進修情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="1077 443 1410 1243"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.03.25</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>公司治理與證券法規</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.06.24</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.07.01</td> <td>社團法人中華</td> <td>董事會應考量之</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	113.03.25	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3.0	113.06.24	社團法人中華公司治理協會	從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3.0	113.07.01	社團法人中華	董事會應考量之	3.0	
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																
113.03.25	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3.0																
113.06.24	社團法人中華公司治理協會	從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3.0																
113.07.01	社團法人中華	董事會應考量之	3.0																

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因										
	是	否											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">摘要說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.07.03</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>公司治理協會 臺灣證券交易所</td> <td>ESG相關法律議題 2024國泰永續金融 暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>113.09.25</td> <td>證券櫃檯買賣 中心</td> <td>3.0</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	摘要說明		113.07.03	<table border="1"> <tr> <td>公司治理協會 臺灣證券交易所</td> <td>ESG相關法律議題 2024國泰永續金融 暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>113.09.25</td> <td>證券櫃檯買賣 中心</td> <td>3.0</td> </tr> </table>	公司治理協會 臺灣證券交易所	ESG相關法律議題 2024國泰永續金融 暨氣候變遷高峰論壇	6.0	113.09.25	證券櫃檯買賣 中心	3.0	
摘要說明													
113.07.03	<table border="1"> <tr> <td>公司治理協會 臺灣證券交易所</td> <td>ESG相關法律議題 2024國泰永續金融 暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>113.09.25</td> <td>證券櫃檯買賣 中心</td> <td>3.0</td> </tr> </table>	公司治理協會 臺灣證券交易所	ESG相關法律議題 2024國泰永續金融 暨氣候變遷高峰論壇	6.0	113.09.25	證券櫃檯買賣 中心	3.0						
公司治理協會 臺灣證券交易所	ESG相關法律議題 2024國泰永續金融 暨氣候變遷高峰論壇	6.0											
113.09.25	證券櫃檯買賣 中心	3.0											
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	<p>本公司設有發言人及代理發言人，並於公司網站設置利害關係人專區，針對各類別利害關係人建立對應窗口，並由專人負責回應相關問題（請參閱本公司網站「企業永續>利害關係人專區」(https://www.sas-globalwafers.com/stakeholder/)。</p> <p>本公司另於永續報告書「第一章、永續管理/重大議題與利害關係人溝通」中揭露本公司依據營運活動、商業關係及參考同業而鑑別出7大類利害關係人（包括客戶、員工、股東/投資人、供應商/承攬商、政府機構、媒體、社區/非政府組織/非營利組織等）以及本公司與各類別利害關係人之溝通管道、回應方式、溝通頻率及其關注議題等。本公司經由與各類別利害關係人的互動及溝通並透過問卷調查方式，113年度共鑑別出13項永續重大議題，包括氣候策略與行動、職場健康與安全、經營策略與財務績效、人才吸引與留任、水資源管理、廢棄物管理及循環再生、產品品質與安全、永續供應鏈管理、公司治理、能源管理、資安與個資保護、道德誠信、人才發展，並據以擬定各重大議題之管理方針。上述與各利害關係人溝通情形之相關資訊除揭露於本公司網站「企業永續>利害關係人專區」以及永續報告書外，並每年度向董事會呈報，最近一次呈報董事會日期為113年5月7日。</p> <p>本公司委任元大證券為本公司專業之服務代理機構辦理各項股東會事務。</p>	無重大差異										
六、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東	V		無重大差異										
七、資訊公開			無重大差異										

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>評估項目</p> <p>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？</p> <p>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報第一、二、三季財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	V		<p>(一) 本公司已架設網站，提供財務業務相關資訊及公司治理資訊。</p> <p>(二) 本公司設有英文網站，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。本公司自公開發行以來，依循主管機關及相關法令規定辦理各項資訊之公告及申報；股東均可於公開資訊觀測站或本公司網站查詢及知悉公司各項訊息及重大事項（包含法人說明會等相關資訊）。本公司並確實落實發言人及其代理人制度。</p> <p>(三) 為提升公司資訊揭露透明度及時效性，本公司自112年度財務報告起，已於會計年度終了後兩個月內公告並申報第一、二、三季財務報告，並於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。</p>
	V		無重大差異
	<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</p>	V	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>健全的原則進行相關之風險管理，訂有相關內部規章及內部控制制度以防範各項風險，並由內部稽核單位定期及不定期的查核內部控制制度的落實程度。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係並秉持客戶至上之政策，以創造公司利潤。</p> <p>(八)為董事購買責任保險：本公司已為董事購買責任保險，以強化股東權益之保障，並揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p>112年度（第十屆）公司治理評鑑結果，本公司名列上櫃公司排名前5%，已改善及擬改善事項說明如下：</p> <p>(一)已改善事項</p> <p>1. 新增女性董事席次2席，目前本公司女性董事為3席，占比37.5%，達到公司董事任一性別均達董事會席次三分之一以上。</p> <p>2. 在會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告。</p> <p>3. 導入ISO27001資訊安全管理系統標準，並取得第三方驗證。</p> <p>(二)擬改善事項</p> <p>1. 規劃於五月底前召開股東常會。</p>			

(四) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114年3月31日

身分別		姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)		于明仁		請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	-
獨立董事		羅達賢	-			
獨立董事		吳琮璿	2			
獨立董事		蔡子萱	-			

2. 薪資報酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1) 定期檢討薪資報酬委員會組織規程及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額。

3. 薪資報酬委員會年度工作重點彙整

113年度薪資報酬委員會共召開3次，審議的事項主要包括一

1. 檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：
審核本公司「經理人薪資報酬管理辦法」之修訂。
2. 評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額：
審核112年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
3. 審核本公司經理人之晉升案。

4. 薪資報酬委員會年度運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計4人，全體由獨立董事組成。

(2) 本屆委員任期：113年6月18日至116年6月17日，最近年度(113年)薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	于明仁	3	0	100%	第五屆 (113年6月18日委任)
委員	羅達賢	1	0	100%	
委員	吳琮璿	1	0	100%	
委員	蔡子萱	1	0	100%	
委員	鄭正元	2	0	100%	113年6月18日卸任
委員	王鍾渝	2	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪

資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、薪資報酬委員會年度運作情形：

薪資報酬委員會期別/日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆第七次 113.02.27	1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆第八次 113.05.07	1.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案	全體出席委員同意通過	
	2.人事晉升案		
	3.本公司 112 年度董事酬勞分配案		
	4.本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案		
第五屆第一次 113.11.05	1.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案	全體出席委員同意通過	
	2.人事晉升案		
	3.本公司經理人調薪案		

(五) 提名委員會成員資料及運作情形：

1. 敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責

本公司提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有半數(含)以上為獨立董事，並由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 依據本公司董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之需求，覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- (2) 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (3) 訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任規畫。
- (4) 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

2. 提名委員會成員專業資格與經驗及年度運作情形

- (1) 本公司之現任提名委員會委員共計五人，其中四人為獨立董事。

徐秀蘭董事長為第二屆提名委員會之召集人，其具備經營管理、併購及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。

為健全公司治理，本公司於114年2月25日第三屆第一次提名委員會經由委員互相推舉決議由獨立董事于明仁委員接續擔任本公司第三屆提名委員會之召集人及會議主席。獨立董事于明仁委員具備財務管理、經營管理以及公司治理專長，符合提名委員會所需之專業能力。

- (2) 本屆委員任期：113年6月18日至116年6月17日，最近年度(113年)提名委員會開會1次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人 (獨立董事)	于明仁	請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	1	0	100%	第三屆 (113年6月18日委任)
委員 (一般董事)	徐秀蘭		1	0	100%	
委員 (獨立董事)	羅達賢		-	-	-	
委員 (獨立董事)	吳琮璿		-	-	-	
委員 (獨立董事)	蔡子萱		-	-	-	
委員 (獨立董事)	鄭正元		1	0	100%	113年6月18日卸任

註：113年度之提名委員會為第二屆委員於113年2月27日召開，第三屆委員於114年2月25日召開第三屆第一次提名委員會。

其他應記載事項：
敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

提名 委員會 期別/日期	議案內容	決議結果	公司對提名 委員會意見 之處理
第二屆 第三次 113.02.27	1.本公司董事會暨功能性委員會績效評估案	全體出席委 員同意通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過
	2.提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案		

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、 公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理層處理，及董事會督導情形？</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>本公司於民國106年6月成立企業永續發展委員會，為公司內最高層級的永續發展決策中心，負責統籌綜理全公司有關ESG(環境、社會及治理)各面向之永續發展方向與目標擬定，以追求企業永續發展及善盡社會責任。</p> <p>本公司企業永續發展委員會由董事長擔任主任委員，督導本公司企業永續發展方向與目標擬定，由財務長擔任總幹事，統籌委員會相關事務；另設永續長，由董事會委任，帶領相關企業永續工作之執行與運作。企業永續發展委員會轄下依據業務功能設置五個子委員會，包括「永續營運子委員會」、「綠色製造子委員會」、「永續供應鏈子委員會」、「社會與企業關懷子委員會」以及「公司治理與風險管理子委員會」，由各單位主管所組成，負責策略及管理方針之擬訂，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。企業永續發展委員會另設「永續發展推動小組」，擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，並且定期舉辦工作會議，或依各項ESG專案而設之任務小組就相關議題進行跨部門整合及執行推動，以追蹤執行成效及持續改善。企業永續發展委員會每年召開全會員會議，針對本公司重大永續議題檢視當年度目標達成情形，並檢視短、中、長期目標之設定。</p> <p>企業永續發展委員會受董事會之督導，除每年度(至少一年一次)由主任委員向董事會報告永續發展推行情形與目標訂定及達成績效外，每季並向董事會報告環境議題之績效指標及相關數據(最近一次呈報董事會日期為114年2月25日)。</p> <p>本公司主要參考全球永續性報告協會(Global Reporting</p>	<p>與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</p> <p>無重大差異</p>

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因
	是	否	
二、 公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V	<p>本公司訂有經董事會通過之「風險管理政策與程序」，以董事會為風險管理之最高治理單位，依整體營運策略及經營環境，以遵循法令，推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解公司營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任；以上風險管理相關事項，並由審計委員會協助督導。高階管理階層負責規劃及指揮調度董事會風險管理決策之執行，及協調跨部門之風險管理互動與溝通，以降低策略性風險。各功能單位負責分析、管理及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控制程序能有效執行。另由內部稽核做為獨立單位，協助董事會監督風險管理机制之落實程度，查核各功能單位風險變異與控制之執行，提供風險監控改善建議。風險管理範疇包括危害風險、營運風險、財務風險、策略風險、合規風險/合約風險、環境風險及其他風險等，透過風險管理流程（包括風險辨識、風險衡量、風險監控、風險報告、風險之回應）之有效執行以落實公司之風險管理机制。</p> <p>本公司企業永續發展委員會依重大性原則，進行與公司營運</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，將重大議題分析納入公司整體風險管理中，以辨識出相關風險項目並據以訂定風險減緩因應措施，風險評估邊界涵蓋本公司所有營運及生產據點。本公司113年度重大議題包括「公司治理、經營策略與財務績效、道德誠信、資安與個資保護、產品品質與安全、永續供應管理、氣候策略與行動、能源管理、廢棄物管理、水資源管理、人才吸引與留存、人才發展、職業健康與安全」，另辨識出3項長期新興風險包括「地緣政治風險、能源轉型風險、資安風險」，各項議題、辨識出的風險項目，以及相對應之風險減緩因應措施等詳細資訊，請參閱本公司永續報告書「第二章、治理與營運/2.3風險管理」。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V	本公司企業永續發展委員會每年定期（至少一年一次）向審計委員會及董事會報告與公司營運相關之環境、社會、公司治理之重大議題及風險項目相關策略、管理運作與執行情形，並由審計委員會及董事會給予意見與指導，最近一次呈報日期為113年5月7日。另考量氣候變遷議題之重要性與特殊性，企業永續發展委員會每季另向董事會報告環境指標績效與目標、氣候變遷議題之因應與管控等相關事務。 本公司透過在集團各生產據點推動「ISO14001環境管理系統」及「ISO50001能源管理系統」，導入產品生命週期之概念，從製程及產品設計階段改善做起，真正做到源頭原物料之減量。本公司配合環境及能源管理系統每年訂定節能、節約物料使用之目標，亦持續實施水回收、減廢之措施，以珍惜資源降低資源使用量，同時達到降低溫室氣體排放之成效。集團各生產據點「ISO14001環境管理系統」取得認證效期皆涵蓋2024年度。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？			集團各生產據點取得「ISO14001環境管理系統」及「ISO50001能源管理系統」認證相關資訊請參閱本公司網站「企業永續>環安衛管理>相關認證」 (https://www.sas-globalwafers.com/ehs-management-system/)。 本公司於各生產據點導入「ISO50001能源管理系統」，積極推動各項節能措施，選用提升能源效率之設備，監測重大能源使用設備，並定期追蹤改善措施之績效，以達到持續改善、節能減碳的目標。本公司用電量與目標達成情形請參閱永續報告書「第四章、永續環境／永續目標；4.2能源管理」。
	V		無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		本公司另推動「ISO14001環境管理系統」，導入產品生命週期之觀念，減少原物料耗用及廢棄物產出，以達成永續經營、環境保護的目標。本公司各廠區依製程特性不同，儘可能地使用再生物料，各廠區使用的再生物料包含矽原料、切削液（載劑）、產品包裝紙箱及晶舟盒等項目；本公司生產使用之主要原料為矽料，在長晶階段盡可能使用廠內回收的頭尾料不但可節省購料之成本，亦可減少廢棄物之產出。本公司再生物料使用情形請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.4.1原物料再利用」。 本公司依循國際金融穩定委員會制定之氣候變遷相關財務架構揭露指引（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Recommendation, TCFD）建議之框架，依治理、策略、風險管理、指標與目標四大核心要素揭露氣候變遷相關資訊，評估氣候變遷對於公司的風險與機會、潛在財務衝擊，以及相應的應對策略與措施。
			無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		<p>本公司113年度識別出與環球晶圓相關之10項實體風險項目、16項轉型風險項目，以及10項機會項目，依據發生可能性與衝擊程度評分計算風險/機會值，並參考同業鑑別結果，篩選並聚焦於風險/機會值較高的3項氣候風險與3項氣候機會，評估各項風險與機會對公司的潛在財務衝擊，並分別擬定應對策略及措施。以上相關分析資訊請參閱本報「貳、公司治理報告／三、公司治理運作情形／(七)上市上櫃公司氣候相關資訊」以及本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.1氣候策略與行動」。</p> <p>集團各生產據點每年盤查追蹤溫室氣體排放量、用水量、廢棄物量、再生物料使用情形、及用電量等，相關盤查數據及資料涵蓋範圍請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.1.1溫室氣體盤查；4.2能源管理；4.3水資源管理；4.4廢棄物管理；4.4.1原料再利用」。</p> <p>本公司依營運活動之影響，推動各項措施以降低公司營運對自然環境之衝擊。本公司在節能減碳項目建置能源管理系統(ISO 50001:2018)、溫室氣體減量項目建置溫室氣體盤查(ISO 14064:2018)、減少用水項目進行產品水足跡查證(ISO 14046:2014)、以及清潔生產評估，以上均委外進行第三方驗證/查證通過。驗證之相關資訊請參閱本公司網站「企業永續>環安衛管理>相關認證」(https://www.sas-globalwafers.com/chs-management-system/)。</p> <p>本公司以實際行動支持台灣淨零轉型，於2022年加入RE100倡議組織，透過提升能源使用效率，低碳技術轉型(優化設施及製程之節能行動計畫)並搭配簽訂購電協議(Power</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>Purchase Agreement, PPA)、購買再生能源憑證 (Renewable Energy Certificates, RECs)、與上游價值鏈議合減碳等策略，逐步達成氣候藍圖規劃之階段性目標，最終實踐2050年前全集團100%使用再生能源之長期目標。</p> <p>本公司針對用電量、溫室氣體排放量、用水量、及廢棄物量等分別設定有年度目標及短期、中期、長期目標，相關目標資訊及達成情形請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／永續目標」。</p> <p>本公司並藉由下述推動措施以達成上述設立之目標：</p> <p>(1) 能源消耗與溫室氣體排放減量：本公司溫室氣體之主要排放來源是電力，因此電力使用之減量及能源效率之提升為公司首要之務。本公司藉由導入「ISO50001能源管理系統」，監督量測重大能源使用設備，並提出行動改善計畫，定期追蹤相關改善措施之成效，另於內部宣導節約能源，以達到持續改善、節能減碳的目標。集團各生產據點最近三年度之溫室氣體排放量及用電量，請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.1.1溫室氣體盤查；4.2能源管理」，其中溫室氣體排放量最近二年度皆經第三方驗證通過。</p> <p>(2) 減少用水：本公司節水措施管理流程，主要分為廠務系統及製程設備進行分項管理，持續提升製程廢水回收系統效能，並定期於內部召開節水討論改善會議及宣導節約用水。集團各生產據點最近三年度之用水量，請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.3水資源管理」。環球晶圓中德分公司自2023年開始，因應耗水費用徵收業務每年聘請第三方查證單位就取水量、重複利用</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>水量及用水回收率計算進行查證，2024年及2025年（查證2023年及2024年的用水狀況）皆符合查驗相關限制。</p> <p>(3) 廢棄物管理：本公司重視廢棄物管理，從製程改善及源頭減量，以減少廢棄物（包含空氣污染源排放物質）之產出，並於廠內進行回收再利用，減少新購原物料量，同時也減少廢棄物之產生。集團各生產據點皆已通過「ISO14001環境管理系統」驗證（認證效期涵蓋2024年度），並每年持續驗證。最近三年度之廢棄物產出量，請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.4廢棄物管理」。</p> <p>(4) 污染防治：本公司推動綠色產品與綠色生產，從製程設計與技術提升，減少原物料之耗用，不僅從源頭減少污染排放，亦能降低營運成本、減少資源消耗及降低對環境之衝擊。</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V	<p>本公司認同並支持《聯合國世界人權宣言(Universal Declaration of Human Rights)》、《聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)》、《國際勞工公約(International Labour Conventions)》、《聯合國工商企業與人權指導原則(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)》與《責任商業聯盟行為準則(Responsible Business Alliance Code of Conduct)》等國際人權公約所揭示之人權保護精神與基本原則，並依循相關勞動法規及上述國際人權公約，制定有「人權政策」，致力於建構平等、安全且有尊嚴的工作環境。</p> <p>本公司「人權政策」之五大政策方針及其相關執行情形如下： (1) 持續創造多元包容性與平等機會，禁止任何形式的歧視</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實際守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>(含性別(含性傾向)、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、國籍、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙等)：</p> <p>本公司在所有招募、任用、營運過程中，持續宣導禁止所有不當歧視的行為。除此之外，為善盡照顧移工的責任，與人力仲介合作，致力於提升其海外生活的起居條件。</p> <p>本公司致力於落實友善、平等的職場環境，依據新修訂之《性騷擾防治準則》及《工作場所性騷擾防治措施準則》訂有完善的「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」並公告於廠區佈告欄。針對女性員工，本公司亦提供多元的資源以鼓勵其職涯持續發展，如完善的母性保護措施、依據性別工作平等法制定規範、制定內部講師、在職進修、教育訓練等政策，以提供多元的發展機會。</p> <p>本公司致力於促進職場多元共融，訂有「多元、平等、共融(DEI)職場宣言」及政策，嚴格遵守各國當地法令，無論性別、種族、國籍、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、文化、黨派、性傾向、階級或身心能力等因素，每個人都能在這裡感受到尊重和包容。具體成果如：本公司113年度女性職員佔全體員工比例為22.58%，女性主管則佔全體主管人數的21.09%；全球員工總數為7,198人，國內員工佔全體員工比例為23.92%，海外員工則佔全體員工比例為76.08%；全球身心障礙僱聘人數共計73人，佔全體員工比例為1.01%；30歲以下員工佔17.5%、30~50歲員工佔49.94%、50歲以上員工佔32.55%。</p> <p>(2) 禁止強迫勞動與僱用童工；</p> <p>本公司遵循所有勞動相關法令，制定相關規定於「人事</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>任用辦法」及「商業與員工道德行為準則」當中，認同並支持《聯合國工商企業與人權指導原則(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)》、《聯合國世界人權宣言(Universal Declaration of Human Rights)》、《國際勞工組織的工作基本原則與權利宣言(ILO Declaration of Fundamental Principles and Right of Work)》、《責任商業聯盟行為準則(Responsible Business Alliance Code of Conduct)》、《RBA驗證審計計畫執行手冊：收取費用之定義(RBA Validated Audit Program (VAP) Operations Manual: Definition of Fees)》，尊重所有員工的意願，並鼓勵兼顧工作與家庭；確保無任何形式的強迫勞動，包括但不限於債役或契約勞工、非自願或剝削性監獄勞工、奴役或販賣的人口；保障勞工出入工作場所自由，也確保勞工在工作場所內的行動自由，適用包括勞工宿舍或生活住所；不要求勞工繳付僱主的中介人或二級中介人的招聘費用或其他與其聘用相關的費用。此外，確保所有營運活動中沒有不法童工，若發現童工涉入營運過程中，相關補救計畫將持續六個月或直到童工滿十六歲止，以保障兒童權益。</p> <p>(3) 建立安全與健康的工作環境： 本公司持續提供免費健康檢查、安排職業醫學專科醫師臨廠服務、舉行健康管理活動、追蹤特殊族群...等，來提升員工自我健康意識。於113年度，本公司國內廠區共規劃97場次的健康促進措施，如講座、緊急救護課程、防癌篩檢等，共計9,050人次參與。此外，海外廠區也經常舉辦多元的健康促進活動來保障員工健康，共計232次相關活動場次及設施使用次數，計16,295人次參與</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>或使用健康促進設施。本公司另訂定各項工作安全與衛生管理程序、作業標準，特殊危害作業管制、化學品管理、作業環境監測讓同仁遵循，預防職業傷病，消除危害及降低環境安全風險，提供員工安全的作業環境。</p> <p>(4) 提供公平合理的薪資與工作條件： 本公司定期審視同業薪資水平，並參考總體經濟指標、物價指數等客觀數據，對員工薪酬作適當調整；同時為了公平性，同仁敘薪標準皆依職位、年資與專業能力等工作相關項目進行判斷，確保同工同酬並避免性別、年齡或其他條件上之歧視與差異。此外，公司也嚴格控管工時不逾法令上限，透過定期的工時分析報告、出勤異常管理系統來累積極防範過勞。</p> <p>(5) 提供自由表達意見的管道及環境，尊重員工自由結社之權利： 本公司每季舉辦至少1次勞資會議、每半年舉辦1次移工溝通會議，就勞資關係協調、勞動條件、勞工福利等事項進行討論，以促進勞資關係和諧。公司內亦於適當明顯處設置員工意見箱，以提供員工檢舉不法、申訴不平，使員工的不滿與疑惑得以抒發、解決。113年度台灣廠區共舉辦18場勞資會議與2場移工溝通會議。</p> <p>本公司每年依循《責任商業聯盟行為準則 (Responsible Business Alliance Code of Conduct)》之標準進行人權、勞工權益等風險評估，公司持續利用RBA設計的標準化風險評估範本 (Self-Assessment Questionnaire, SAQ)，自行鑑別業務中「勞工、健康與安全、環境、道德規範」相關實質作為、風險以及管理體系，113年度Corporate SAQ 分數達到87分的「低</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>風險」範圍內。本公司並將標準制定於「人事任用辦法」、「性騷擾防制措施申訴及懲戒辦法」當中，員工可透過匿名申訴管道，如：信箱與電話來申訴不法侵害，相關的委員會將以全程保密的方式處理，會議結果將用以積極追蹤、監督並給予當事人必要的支持，以保障人權及避免再發生。本公司台灣區及海外區營運據點於113年度各發生1起人權事件申訴（強迫勞動、童工、歧視、騷擾及違反結社自由），相關部門已立即組成委員會並啟動調查、保護及再教育，後續也立即優化全體員工的人權教育訓練以防範未然。</p> <p>訓練部分，新進人員於到職即辦理人權相關教育訓練，在職人員則為不定期安排職場暴力侵害、性騷擾防治宣導等課程，此外，更依據公司鑑別出的主要利害關係人，將主管職員工列為必修人員，極力預防職場不法侵害的發生。於113年度舉辦相關課程共計7,938人次參與、總訓練時數11,740小時。</p>	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V	<p>本公司依據公司章程所載，年度如有獲利應提撥3%~15%為員工酬勞，並依本公司「員工酬勞分派辦法」之程序按員工績效公平核給發放之，期將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。</p> <p>本公司依照勞動基準法制定出勤辦法，載明員工休假權利，本公司員工除享有勞保、健保、團保、退休金給付等一般福利外，由公司提供之福利包括發給年節獎金、生日及節慶禮金、舉辦年終晚會、婚喪喜慶、國內外旅遊、急難救助、獎學金補助、在職進修補助、生育補助、提供團膳、及提供完整之教育訓練講習等，並成立ECP (Employee Caring Program) team，透過跨部門小組，整合規劃提升員工整體福利，讓</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>工在遇到個人問題時，能選擇適當的資源獲得協助。</p> <p>本公司自110年起亦增加員工福利儲蓄信託，員工可自行評估加入與否，參與者則依照個人提撥金額給予100%的獎勵金。</p> <p>本公司依照ISO45001國際標準，建立職業安全衛生管理系統，系統涵蓋公司主要的營運場域，將安全與健康深植於日常營運之中。本公司已取得職業安全衛生管理系統(ISO45001:2018)之認證，認證之詳細資訊請參閱本公司網站「企業永續>環安衛管理>相關認證」(https://www.sas-globalwafers.com/ehs-management-system/)。</p>	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V	<p>勞工作業環境監測：為保障勞工免於作業場所中有害物質的危害，提供勞工健康舒適的工作環境，公司每年均執行2次作業環境監測，以瞭解工作人員的暴露實態。</p> <p>職業安全衛生查核：除了規定期與不定期的安全作業查核外，為了強化員工對安全的重視，我們將每年9月訂為「工安月」，並透過各項查核與活動強化安全管理。113年度工安月的主題為「防火自主安全管理評估與風險預防措施機制」，本公司各廠區配合工安月主題，規劃並推動相關專案查核與改善措施，確保安全標準落實，進一步提升職場安全管理與風險預防效能。</p> <p>設備安全管理：對於危險性機械及設備均予以列管，並依照「危險性機械及設備安全檢查規則」辦理定期檢查，確保設備能安全操作。</p> <p>為提升工作者的職業安全衛生意識與應變能力，本公司每年</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否									
		<p>摘要說明</p> <p>依據內部管理需求、同仁反饋及外部議題，規劃環安衛教育訓練計畫，強化工作者在職場中的安全素養與風險發展的關鍵，並以「母性保護」、「預防異常工作負荷」、「中高齡及高齡員工健康保護」、「預防職場不法侵害」及「因人因性危害預防」五大主軸，規劃企業內部的員工關懷方案（ECP, Employee Caring Program），提供員工全方位的健康照護。</p> <p>近三年工安教育訓練與宣導：本公司將安全衛生教育訓練列為員工入職與在職期間的必修課程，內容涵蓋危害物質辨識、緊急逃生演練、個人防護具穿戴、消防訓練操作、機械防護、人因肌肉骨骼傷害預防、AED&CPR急救訓練等，透過訓練、宣導確保員工自入職起即具備環安衛意識，降低或消除職業危害風險。</p> <table border="1" data-bbox="849 544 1005 1115"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>安全衛生教育訓練人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>11,519</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>22,535</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>28,374</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司職業災害統計分析資料，係依據勞動部及GRI準則所公布之失能傷害統計指標，以每百萬工時為基準，以失能傷害頻率(FR)、失能傷害嚴重率(SR)、職業病率(ODR)及缺勤率(AR)做為主要統計依據（失能傷害統計數字不包含廠外交通意外事故）。113年度台灣區共發生7件工傷失能事件，海外區共發生35件工傷失能事件，全球廠區失能傷害頻率(FR)為2.95，失能傷害嚴重率(SR)為67，所有職災事件皆已進行事故調查分析並執行相應改善措施。為有效防止職業災害發生，本公司定期實施員工、承攬商職安衛教育訓練、工作環境巡</p>	年度	安全衛生教育訓練人次	111	11,519	112	22,535	113	28,374	
年度	安全衛生教育訓練人次										
111	11,519										
112	22,535										
113	28,374										

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>檢及內/外部稽核，檢視公司之環境、安全、衛生作業，以確保工作者環境安全，並以邁向零災害事故為目標。有關職業災害統計及管理等詳細資訊，請參閱本公司永續報告書第六章、職業健康與安全/6.1.4 職業傷害與事件統計」。</p> <p>本公司於113年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率均為0。本公司為提升安全管理（包含消防安全管理）、有效應變災害發生及矯正/預防事件再發，訂有「事件通報、處理及調查管理程序」、「緊急應變處理程序」、「不符合事項、矯正及預防措施管理程序」等相關程序文件，並針對可能發生的緊急狀況辦理應變演練。</p>	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	<p>本公司每年依據營運策略及短中長期目標，規劃年度教育訓練計畫，並視人才培育和技術傳承為執行重點，強化人才資料庫，以掌握集團人才動態及發展方向，並舉辦不同類型的訓練課程及產學合作、專案研究，俾利員工即時掌握全球政經趨勢動態、技術新知，並輔以職務代理、職務輪動與在職訓練等機制，強化員工不同的職能。本公司亦推動六大大學院體系，包含新入學學院、後勤通識學院、管理經營學院、專業核心學院、環安衛生學院、健康促進學院等六大大學院，訓練單位將針對各學院專業領域設計相關課程，提供同仁上課。採行學院制擁有避免重複性開課、可進行學程規劃、訓練學習堆疊透明化等諸多好處。</p> <p>113年度共計辦理新人職能訓練422堂、1,252人次、開課時數共計23,226小時；專業職能訓練1,691堂、18,633人次、開課時數共計47,336小時；通識職能訓練1,742堂、41,007人次、開課時數共計73,831小時。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>評估項目</p> <p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及國際標準等議題，公司是否遵循相關法規及國際政策及申訴程序？</p>	<p>是</p> <p>V</p>	<p>否</p>	<p>摘要說明</p> <p>本公司對產品與服務，皆遵循本公司產業別所適用之相關法規及準則，透過供應商管理，確保供應鏈採納「責任商業聯盟行為準則」(RBA)、「無衝突礦產」、「無強迫勞動成分之矽原料」、「環保產品」(RoHS、REACH、WEEE)……等業界標準及政策，實踐社會及環境責任；本公司同時致力遵循客戶所要求之產品標準及廠區作業規範，全力達成允諾事項，維持優質合作關係。本公司並設有法令遵循單位確保商務條件、產品、流程和服務能符合競爭法與管轄權之出口管制相關法規要求。本公司與客戶合作之前，均應簽署經法務單位核准之保密協議(NDA)，且人員不得洩露所知悉之營業秘密予他人、亦不得探詢或蒐集非職務相關之營業秘密，俾充分保障雙方之敏感及機密資訊。</p> <p>本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」第十四條訂有防範產品或服務損害利害關係人之權益、健康、安全，以及確保產品合規之相關規範。此外，行銷單位制定「客戶訴願管理流程」，與客戶間保持良好之溝通管道，並對產品與服務提供透明且有效之客訴處理程序。</p> <p>關於客戶個人資料保護，本公司已制定「隱私權政策」，詳細規範本公司在蒐集、處理、利用、存取和揭露可識別特定自然人之資料(個人資料)的過程中，所應遵循的規範及程序，主要包含「隱私保護」、「個人資料之蒐集、處理、利用」、「安全措施」三個面向，其具體內容已發布於本公司網站「企業永續>永續報告書與相關政策>ESG相關政策」(https://www.sas-globalwafers.com/csr-download-tw/)供利害關係人查詢。除上述「隱私權政策」外，本公司亦訂有「個人</p>

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實守則差異情形及原因
	是	否	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其其實施情形？	是	<p>資料保護管理辦法」以資管理，規範同仁對於業務所經手個人資料之蒐集、處理、利用行為，以及由本公司法令遵循個人資料定期執行查核及舉辦「個人資料保護教育訓練」，責成資料權責單位對於業務所涉及之個人資料實施盤點，確保資料權責單位對於個人資料之蒐集、處理、利用行為，均以符合個人資料保護法規定方式辦理。</p> <p>本公司訂有「供應商評鑑管理流程」，並於本公司官網揭露企業永續之供應鏈管理政策，其中要求供應商遵守行為準則，除了誠信原則之外，致力遵行「責任商業聯盟行為準則(RBA)」旨在確保勞動安全、商業營運標準與道德操守，建立勞工、健康與安全、環境及商業道德標準與規範，包含RoHS、REACH及WEEE等綠色法規指令且不使用衝突礦產、配合投入綠色採購行列及環境保護暨職業安全衛生、智慧財產權、及勞動人權等。</p> <p>鑒於《現代奴役法案》，本公司於各國營運活動皆符合勞動人權，遵守當地法律，包括人口販賣和反奴隸制度各項法案，故本公司亦要求供應商共同遵守並堅持其所有的商業交易、商業關係和供應鏈活動皆符合道德規範，以誠信為上。</p> <p>本公司「供應商評鑑管理流程」，包括書面評審與實地評鑑，每年由品保、採購、環安衛、研發及相關單位組成供應商評鑑小組，執行供應商廠區稽核、文件審查（包含品質、上游供應商管理、環境與安全、營運計畫等），並與其主管與員工面談，發現問題並進行改善。</p> <p>本公司鼓勵供應商取得ISO14001與ISO45001認證，善盡企業</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>社會責任，每年追蹤並於季度評核時加分，並增加採購比例予以鼓勵。</p> <p>本公司並依據RBA (Responsible Business Alliance) 標準及公司永續目標，導入供應商永續管理自評與覆評機制。此機制不僅有助於提升供應商於環境、社會責任及公司治理 (ESG) 方面的表現，亦能推動其持續改善。透過每年自評問卷與相應管理，公司能夠掌握供應商在可持續發展領域的表現及進展，並對其進行必要的輔導與協助，確保供應鏈發展方向與本公司一致，並確保其實踐效果。</p> <p>本公司對供應商之永續管理評鑑，不僅深化與供應商的的合作關係，亦提升供應鏈的韌性與透明度，為企業的永續發展奠定堅實的基礎。截至114年1月，本公司已完成前120家主要供應商的永續評鑑，供應商自評達成率90%，其中有83家(69%)已獲取ISO14001認證，13家(11%)已獲取ISO14064-1溫室氣體盤查認證，7家(6%)已獲取ISO14067產品碳足跡認證。本公司持續推動供應商取得溫室氣體盤查與碳足跡認證，並啟動降低溫室氣體排放計畫。</p> <p>為了推動供應鏈落實ESG，本公司呼籲供應商夥伴：</p> <p>(1)優化流程：精簡程序，以減少浪費並提升交易效率。</p> <p>(2)提升良率：改進生產方法、設備，以最大化效率並降低單位成本。</p> <p>(3)創新材料：探索環保替代品，降低環境影響，同時兼顧成本效益。</p> <p>為實現綠色半導體生態，本公司要求所有主要供應商達成對</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	<p>應等級的永續目標，例如：設定近期目標 (SBTi committed)、完成主要產品的碳足跡評估、提出減碳計畫等。</p> <p>此外，本公司在供應商ESG管理部分，著重於以下面向的表現，並進一步評核供應商等級，推動供應商與環球晶圓共同達成永續發展的目標。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 碳足跡準備度：確認符合ISO14067標準。 • 碳足跡定期審核：每兩年進行一次，重點關注減排比率。 • 碳減排目標：制定2030年前應實現最低之減碳比率。 	<p>本公司主要參考全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, 簡稱 GRI) 所發行的「永續性報告準則」要求及永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, 簡稱 SASB) 所發行的「永續會計準則」依循半導體行業類別指標及「上櫃公司編製及申報永續報告書作業辦法」及TCFD氣候相關財務揭露的建議與實施指引進行永續報告書之編製。本公司113年度永續報告書經優麗國際管理系統股份有限公司(DQS Taiwan Inc.)查證符合 GRI Standards參考要求及AA1000 AS v3標準的Type 1 中度保證等級的要求，113年度永續報告書揭露於公開資訊觀測站及公司網站「企業永續>永續報告書與相關政策」 (https://www.sas-globalwafers.com/csr-download-tw/)。</p>	無重大差異
六、公司如依據「上市櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「永續發展實務守則」，公司業已致力於推動永續發展，與所訂守則無重大差異。	<p>訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「永續發展實務守則」，公司業已致力於推動永續發展，與所訂守則無重大差異。</p>		
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 環保方面：推動環保低碳活動人人有責，本公司除加強製程之節能管控外，積極落實垃圾分類，資源回收工作，並推展節能減碳，投入節能減碳設備支出。 2. 社會公益：本公司持續評估營運所在地的風險與機會，台灣區營運所在地包括新竹、苗栗與宜蘭，海外營運所在地包括美國、義大利、日本、			

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	

韓國、中國大陸及馬來西亞...等。本公司致力於關懷營運所在地偏鄉弱勢，如經濟弱勢家庭、兒少、身心障礙等，期能透過公益捐贈活動支援並改善其生活及教育條件，另經由志工服務落實營運所在地環境保護的具體行動方案。為鼓勵員工參與社會公益，本公司將募款所得1:1相對捐（員工捐多少，公司捐相同金額）結合積少成多，聚沙成塔的力量，將這股愛與溫暖推動至更多需要幫助的地方。

113年度投入社會公益活動資源如下：

活動項目	受贈單位	金額 / 數量
青少年發展服務計畫	台灣世界展望會桃竹苗辦公室	NT\$169,300
身心障礙者藝術陶冶計畫	宜蘭阿寶基金會	NT\$130,800
0403花蓮地震募款	花蓮縣政府	NT\$1,764,100
修繕清寒植物人安養院	創世基金會苗栗分院	NT\$328,300
紅鼻子醫生醫院演出計畫	社團法人紅鼻子關懷小丑協會	NT\$179,000
113年中秋節月餅捐贈慈善公益活動	世光教養院 / 華光智能發展中心 / 香園紀念教養院 / 私立聖家啟智中心	NT\$80,000
2024冬暖慈幼園遊會捐款	新竹家扶中心	NT\$15,000
年終尾牙公益表演	苗栗縣巴達思文化藝術舞蹈協會	NT\$10,000
江賢二藝術推廣計畫 暨江賢二藝術園區營運籌備	江賢二文化基金會	NT\$5,000,000
PIDA 2024思源STEM創意大賽	光電科技工業協進會	NT\$50,000
派歐尼秧苗計畫：		
中美矽晶X環球晶圓東光科普教育營	愛惜社區推展協會	NT\$520,000
每日7000步 集點送獎金 齊步送公益	心路基金會新竹市兒童發展早期療育中心	NT\$10,000
員工捐血活動	新竹捐血中心	參與員工共199人次， 合計共捐血 82,000c.c.
淨灘活動	苗栗縣龍鳳漁港淨灘	共號召119人參與，共清除100餘公斤垃圾

本公司海外廠區亦積極投入社會關懷活動，展現企業的社會責任：日本廠每年兩次參與當地鎮政府的清潔計畫，捲起袖子清理場地，總計收集了15袋垃圾，為社區環境貢獻一份心力；韓國廠則捐贈洗衣精、嬰兒濕巾等物資，支持當地弱勢家庭；義大利廠積極舉辦多項慈善活動，

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
	摘要說明		
	<p>包括非競爭性跑步比賽和足球錦標賽，報名費均捐贈給支持無家可歸者的慈善機構，並向當地協會捐贈蛋糕和遊戲用品給兒童，此外義大利廠亦捐款支持女性反暴力協會，為員工準備嘉年華蛋糕，部分費用捐贈慈善，並捐贈60棵樹，舉辦鴨鴨比賽進行慈善募款，義大利廠同時支持癌症治療機構、提供超音波設備提升當地醫院診斷能力，並參與當地公共安全部門的志工活動，捐款支持長者行動力提升以及自閉症協會，並推動體育協會性別平等意識計畫；在美國廠，員工捐贈食物、尿布，並參與當地「社區衣櫥」；馬來西亞廠則在水患災區，對受災同仁提供捐助，體現了企業的全球社會責任。</p> <p>3.消費者權益：公司內部訂有「客戶訴願管理流程」，提供客戶訴願管道，並與客戶簽訂有供貨合約，品質合約等，對客戶權益有完善保障。</p> <p>4.人權方面：本公司長期致力推動職場平權，不論其種族、性別、年齡皆享有同等的工作權利，提供個人自由表達和發展的機會，以達到尊重個人尊嚴。</p> <p>5.安全衛生：本公司以零災害為目標，致力於安全衛生政策之推動並持續改善製程及作業環境，經由全體員工的共同努力，不斷提升職業安全衛生績效。</p> <p>6.員工健康關懷：本公司定期為員工實施健康檢查，讓員工了解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的健康。在工作場所中，為掌握員工工作環境實態並評估危害因子暴露狀況，除了在適當地點設置偵測警報設備外，也定期實施作業環境檢測，以作為職場環境改善的依據。此外，為預防員工肥胖與代謝症候群，並改善久坐辦公模式等健康挑戰，2024年度推動為期13週的「每日7000步」活動，內容包含每日7000步挑戰、有氧運動課程、體適能檢測等，吸引集團401名同仁參與，幫助員工養成規律運動的健康習慣。</p> <p>7.人力資本發展：本公司透過完善的績效獎勵連結制度、培育在學專業人才、補用在職員工進修、關鍵人才留任等制度，提升人才久任意願。</p> <p>(1)產學合作：本公司與學術單位進行產學合作、策略聯盟，透過合作研究項目進行專業知識和技術的交流，彼此互補優勢，共同解決產品開發過程的技術問題，於持續提升公司研發人員的專業技能之外，亦同時培養學術界高素質人才，推動科技創新和產業發展。113年持續進行的合作計畫有10件，合作院校有清華大學、陽明交通大學、中央大學、台灣科技大學等。</p> <p>(2)人才培育：本公司與雲林科技大學國際管理學程合作，分享國際人力資源管理經驗及面試技巧，幫助學生了解職場趨勢，提升實務能力，促進學術與業界交流，為未來職場培養更多優秀人才。</p> <p>(3)大專院校實習生：本公司自106年起與大專院校合作，迄今已成功培育62名以上在學生於畢業前至企業累積經驗，提供其專業技能培訓及實際應對實務場域能力，這些學生分別來自清華大學、中央大學、交通大學、臺灣科技大學、雲林科技大學、Nagaoka University of Technology等多所大專院校，並專精於電子、工業工程、機械、心理諮商...等相關領域，分別安排至研發、製程、製造、其他支援部門實習，為實習生提供寶貴的學習和成長機會，有助於順利踏入職業生涯的起點。</p> <p>(4)碩博士獎學金：訂有「碩博士獎學金申請辦法」，持續資助相關領域的專業人才獎學金，並於畢業後直接進入公司就業。</p> <p>(5)在職進修補助：訂有「在職進修辦法」，全額補助績效優良且具進修意願員工在職進修，以鼓勵員工發展個人職涯。</p>		

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
	摘要說明		
	<p>(6)重要幹部簽約：針對具備策略規劃能力的管理人員或於自身專業有不可替代性者簽署重要幹部合約，以達到人才留任的目的，確保本公司人力資本永續發展。</p> <p>(7)研究員計畫：本公司在集團內推動研究員計畫 (Fellow Program)，旨在發掘並培養專業領域中的優秀人才，所有提名者必須經過委員會的嚴格選拔，確保選出最具潛力與專業能力的員工，至今已共有90名優秀員工通過此計畫，獲得認可並在公司內部發揮重要影響力。此計畫不僅促進了員工的專業成長，也進一步強化了公司在技術創新與人才發展方面的競爭力。</p> <p>8. 員工健康與安全關懷：隨著後疫情時代的來臨，全球工作與生活方式發生了重大變化，雖然許多防疫措施已經逐步放寬，部分改變將成為永久性的，例如提高洗手頻率 and 保持個人衛生習慣等，以降低疾病傳播風險。本公司將持續推動多元健康關懷措施，保障員工的安全，並積極發揮企業的正向影響力，營造健康、安全的工作環境。</p> <p>(1)健康資訊分享：為確保員工能夠即時獲得正確的健康管理資訊，本公司健康管理中心定期彙整國內外健康資訊，並依據最新資訊動態更新相關措施，使員工能快速掌握有效的健康保護資訊。</p> <p>(2)身心健康關懷：本公司定期關懷員工的身體狀況，特別是有健康異常症狀的員工，並提供適當的支持與追蹤，幫助員工維持身體健康。</p> <p>(3)工作環境衛生管理：本公司制定清潔與消毒標準，定期清潔公共區域並調整消毒頻率，此外，於公共區域備有消毒液，並在洗手間張貼正確洗手指導，以確保員工在安全、清潔的環境中工作。</p> <p>(4)身心平衡支持：為了關注員工的身心狀況，並促進員工的心理健康，本公司於110年導入員工協助方案 (EAPC)，每年提供每位員工兩次免費的心理諮詢服務，並定期發送心理健康相關資訊，幫助員工管理壓力與情緒，維持良好的身心平衡。</p> <p>9. 支持國內文化發展：本公司積極支持國內文化事業與藝術發展，於112年及113年分別投入新台幣500萬元，連續兩年贊助經費總計新台幣1,000萬元，攜手公益平台文化基金會及江賢二藝術文化基金會，支持江賢二藝術推廣計畫及「江賢二藝術園區」的籌建工作，投入資源推動偏鄉藝術扎根計畫，促進花東地區藝術文化的發展。位於台東金樽的「江賢二藝術園區」已於114年3月開幕，園區結合藝術、建築與自然景觀，將成為推廣美學教育與當代藝術的重要場域。此外，113年本公司更深化企業內部的藝術氛圍，在新竹總部及中德分公司展出江賢二台東時期的經典複製畫作品，包括《比西里岸之夢》、《台灣山脈》、《牧神的午後》等系列，藝術展區的設置讓員工在日常工作中感受藝術的啟發，也提供來訪貴賓欣賞藝術的機會，為工作空間注入豐富的美感。</p>		

(七) 上市上櫃公司氣候相關資訊：

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>本公司已訂定「風險管理政策與程序」，董事會為本公司風險管理最高決策單位，並由審計委員會協助督導風險管理相關事項。關於氣候變遷議題，董事會負責督導本公司氣候相關風險與機會的發展策略、短中長期目標與整體管理作為，並提供建言與反饋。另考量氣候變遷議題之重要性與特殊性，董事會並每季督導公司關於氣候變遷議題因應策略以及關鍵環境指標績效與目標達成狀況等相關事務。「企業永續發展委員會」為本公司最高層級氣候風險與機會管理組織，由各單位主管組成，並由董事長擔任主任委員，財務長擔任總幹事，負責統籌委員會相關事務，並定期向董事會報告；另設永續長，由董事會委任，帶領相關企業永續工作之執行與運作。企業永續發展委員會下轄「永續營運子委員會」，由董事長監督其運作，審議公司氣候變遷目標、策略與具體行動計畫，督導氣候變遷風險與機會之管控，並定期檢視各營運據點氣候管理執行狀況與環境指標績效，每季向董事會報告，做為公司永續方針擬訂之重要參考依據。</p>																
<p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>本公司進行氣候風險與機會之辨識，定義氣候風險與機會影響時間短期為1-3年、中期為3-10年、長期為10年以上，聚焦風險機會值較高的3項氣候風險與3項氣候機會，評估各項風險與機會對公司的潛在財務衝擊，分別擬定應對策略及措施，相關資訊摘要如下，詳細評估分析資訊請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.1 氣候策略與行動」。</p> <p>氣候風險與機會辨識如下：</p> <table border="1" data-bbox="975 197 1372 1496"> <thead> <tr> <th data-bbox="975 1317 1018 1496">類別</th> <th data-bbox="975 748 1018 1317">短期 (1-3年)</th> <th data-bbox="975 474 1018 748">中期 (3-10年)</th> <th data-bbox="975 197 1018 474">長期 (10年以上)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1018 1317 1094 1496">實體風險</td> <td data-bbox="1018 748 1094 1317">淹水(暴雨)、土石流、坡地災害、低溫、閃電、颱風、強風、乾旱(少雨)</td> <td data-bbox="1018 474 1094 748">無</td> <td data-bbox="1018 197 1094 474">高溫、海平面上升</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1094 1317 1283 1496">轉型風險</td> <td data-bbox="1094 748 1283 1317">碳稅/碳費、燃料稅/能源稅、總量管制交易與排放交易、強制申報、產品標示法規與標準、再生能源法規、一般環境法規、國際公約/協議、自願性倡議、低碳產品/服務需求、利害關係人的關注與負面回饋日益增加</td> <td data-bbox="1094 474 1283 748">新技術投資、低碳技術轉型、市場訊息不確定性</td> <td data-bbox="1094 197 1283 474">法律訴訟、顧客偏好改變</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1283 1317 1372 1496">機會</td> <td data-bbox="1283 748 1372 1317">採用更高效率的運輸方式、使用更高效率的生產和配銷流程、回收再利用、減少用水量</td> <td data-bbox="1283 474 1372 748">業務活動多元化</td> <td data-bbox="1283 197 1372 474">轉用更高效率的建築物</td> </tr> </tbody> </table>	類別	短期 (1-3年)	中期 (3-10年)	長期 (10年以上)	實體風險	淹水(暴雨)、土石流、坡地災害、低溫、閃電、颱風、強風、乾旱(少雨)	無	高溫、海平面上升	轉型風險	碳稅/碳費、燃料稅/能源稅、總量管制交易與排放交易、強制申報、產品標示法規與標準、再生能源法規、一般環境法規、國際公約/協議、自願性倡議、低碳產品/服務需求、利害關係人的關注與負面回饋日益增加	新技術投資、低碳技術轉型、市場訊息不確定性	法律訴訟、顧客偏好改變	機會	採用更高效率的運輸方式、使用更高效率的生產和配銷流程、回收再利用、減少用水量	業務活動多元化	轉用更高效率的建築物
類別	短期 (1-3年)	中期 (3-10年)	長期 (10年以上)														
實體風險	淹水(暴雨)、土石流、坡地災害、低溫、閃電、颱風、強風、乾旱(少雨)	無	高溫、海平面上升														
轉型風險	碳稅/碳費、燃料稅/能源稅、總量管制交易與排放交易、強制申報、產品標示法規與標準、再生能源法規、一般環境法規、國際公約/協議、自願性倡議、低碳產品/服務需求、利害關係人的關注與負面回饋日益增加	新技術投資、低碳技術轉型、市場訊息不確定性	法律訴訟、顧客偏好改變														
機會	採用更高效率的運輸方式、使用更高效率的生產和配銷流程、回收再利用、減少用水量	業務活動多元化	轉用更高效率的建築物														

項目	執行情形			
		使用低碳能源、採用獎勵性政策、參與碳交易市場、客戶偏好轉變		
聚焦氣候風險與機會摘要如下：				
氣候風險				
風險項目	影響時間	潛在財務衝擊	應對策略及措施	
再生能源法規	短期	為符合公司各營運據點所在地實施之再生能源法規制度或相關草案規範，需投入建置再生能源設備，因而導致營運成本增加。例如因應台灣再生能源法規，部分廠區須於 2025 年底前設置再生能源設備至少達契約容量 10%。	透過自建太陽能電廠、簽訂綠電購電協議與購買再生能源憑證，輔以再生能源藍圖規劃，分階段達成再生能源使用目標。	
低碳產品/服務需求	短期	因應氣候變遷，如提供高耗能/高碳排放產品，可能不符合市場需求，導致傳統產品需求下降，需進行低碳產品/服務技術轉型，轉型過程可能增加新技術研發支出或資本投資，以及製造低碳產品改採用或建置新設備的成本。	持續投入研發資源，開發終端應用為電動車 (EV)、電力、風力發電、太陽能發電、提升電網效率所需之產品，與終端應用所需的低耗能先進製程晶圓，以因應低碳產品的需求。另擬定溫室氣體減量策略，透過製程改善，降低生產過程碳排放量與產品碳足跡(例如加速晶熱場低溫技術的開發)，以符合市場對低溫製成產品的需求。	
乾旱	短期	氣候異常造成的旱災衝擊，包含因生產受影響導致財務損失、營收下降，以及用水成本的提高。	適時調配用水系統，推動各廠區節水措施，以及增加冷卻水回收與雨水回收設施，並評估製造廠區旱災風險，研擬與執行風險減緩措施(如租用水車載水)。	

項目	執行情形			
	氣候機會			
	機會項目	影響時間	潛在財務影響	應對策略及措施
	使用更高效率的生產和配銷流程	短期	透過提升效率提高產能、固定資產利用率，有效降低生產成本。	持續推動各項節水/節電措施，如長晶熱場設計開發、回收水系統，提升生產效率、降低用水與用電等成本，並評估採用高效率原料，減少生產成本。
	減少用水量	短期	增加水資源利用率，降低取水量及減少相關支出，提升生產過程用水效率	提升廠內製程廢水回收率，持續推動各項節水措施，增加冷卻水回收與雨水回收系統，降低用水相關支出。
	使用低碳能源	短期	採用太陽能、風能等低碳能源，降低營運成本，並減少溫室氣體排放，降低碳費/碳稅風險與化石燃料價格上升的暴險，並符合市場低碳採購的趨勢。	簽訂綠電購電協議與購買再生能源憑證，搭配溫室氣體減量策略，降低生產過程碳排放量與產品單位排放量，減少碳費與傳統能源相關費用支出，同時增加客戶採購意願。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>針對極端氣候事件及轉型行動對財務之影響，說明如下：</p> <p>1.極端氣候事件：長期性實體風險如高溫，可能造成電量上升，進一步造成營運成本增加；立即性實體風險如颱風、淹水（暴雨），可能造成電力供給問題，亦有停班及影響生產等風險導致相關損失，並造成衍生費用支出增加、營收下降等財務影響。</p> <p>2.轉型行動：依不同氣候轉型情境，可能衍生的政策、法規、市場轉變、商譽等轉型風險，包含徵收碳稅/碳費、節能政策或法規趨嚴、枯水期徵收耗水費、低碳創新產品與技術生產之開發成本增加等，對財務的影響主要為費用支出增加。</p>			
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	<p>本公司持續注重氣候變遷因應與管控制，透過定期的風險辨識、衡量、監控、報告到回應等風險管理程序，將氣候變遷議題納入公司整體風險管理中。為落實風險管理機制，本公司企業永續發展委員會每年定期（至少一年一次）向董事會及審計委員會（由4位獨立董事組成）報告與公司營運相關之環境、社會、公司治理之重大議題及風險項目相關因應策略、管理運作與執行情形。另考量氣候變遷議題之重要性與特殊性，企業永續發展委員會每季另向董事會報告環境指標績效與目標、氣候變遷議題因應</p>			

項目	執行情形
	<p>與管控等相關事務。</p> <p>本公司依據TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) 架構及參考國際能源總署 (International Energy Agency, IEA) 及聯合國政府間氣候變化專門委員會 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 發布的最新科學評估報告建立氣候情境分析。</p> <p>實體風險考量IPCC於AR6的SSP5-8.5 (極高排放情境)，此情境假設全球經濟的快速增長主要依賴於化石燃料的開發和高能源密集型產業，且幾乎沒有任何氣候政策加以管控。本公司為能因應未來的氣候變化，採用SSP5-8.5 (極高排放情境) 來推估未來降雨及高溫等氣候災害之情形，以進行實體風險之財務衝擊分析。</p> <p>轉型風險則參考IEA的2050淨零排放情境 (NZE)，考量全球氣候政策與承諾現況及未來趨勢，致力控制升溫於1.5°C內已蔚為國際共識，故採用2050年淨零排放情境 (NZE) 進行轉型風險之財務衝擊分析。</p> <p>本公司綜合考量上述情境所鑑別出之實體及轉型風險結果及其對財務影響，詳如上揭項目2之說明。上述詳細資訊請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境/4.1氣候策略與行動」。</p>
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>為因應管理氣候相關風險，本公司透過採用再生能源，以及導入ISO50001能源管理系統提升能源效率等策略，以減少生產過程的二氧化碳排放，促進淨零轉型。</p> <p>關於採用再生能源，本公司於2022年加入RE100倡議組織，透過提升能源使用效率，低碳技術轉型 (優化設施與製程之節能計畫) 並搭配簽訂購電協議 (Power Purchase Agreement, PPA)、購買再生能源憑證 (Renewable Energy Certificates, RECs)、與上游價值鏈議合減碳等策略，逐步達成氣候藍圖規劃之階段性目標，最終實踐2050年前全集團100%使用再生能源之長期目標，減少發電過程所產生的碳排放量，以實際行動支持淨零轉型。</p> <p>本公司於溫室氣體減量目標方面，溫室氣體單位排放量 (範疇二) 以2019年為基準年，短期階段 (1-3年) 目標較基準年度減量1-3%，中期階段 (3-10年) 較基準年度減量4-10%，至2030年應較基準年度減量10%，長期階段 (10年以上) 較基準年度減量大於10%。</p>
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>為及早應對各國將要制定或者已經實施的相關碳管理政策與法規 (如：徵收碳費/碳稅、總量管制交易、碳關稅) 對於本公司營運據點造成的實質性風險與財務衝擊，同時得以更有效地追蹤監管各廠區碳排放量狀況和分析排放熱點，協助達到本公司所承諾的RE100時程規劃與減碳目標，本公司已於2024年起正式導入內部碳定價機制，使用集團總部統一核定費率的影子價格模型，以各廠的範疇一和範疇二排放量做為收取內部碳費的基礎，並且同步參考歐盟CBAM的憑證價格加以逐年調整徵收費率。</p>

項 目	執行情形
<p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵消或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>本公司已訂定「電力單位耗能」及「溫室氣體單位排放量(範疇二)」之短中長期減量目標，目標涵蓋範圍為本公司所有營運據點，以2019年為基準年，短期階段(1-3年)目標較基準年度減量1-3%，中期階段(3-10年)較基準年度減量4-10%，至2030年應較基準年度減量10%，長期階段(10年以上)較基準年度減量大於10%。</p> <p>本公司減碳行動包括範疇一、範疇二和範疇三的排放量，目標涵蓋所有營運據點的營運活動，透過提高使用再生能源(配合當地政府法規和本公司再生能源規劃路徑)、落實能源使用效率提升及低碳技術轉型(設施、製程優化之節能行動計畫)等作為，以達成範疇一和範疇二的相關減量目標；範疇三減碳策略則鎖定來自上游價值鏈的排放，依照原物料造成的排放量將供應商分成三種等級，以落實供應商的產品碳足跡第三方盤查，並且持續追蹤供應商提出的減碳路徑計畫，邀請大宗碳排放量供應商共同響應科學基礎減量目標倡議(SBTi)，以達成範疇三的減量。另截至2024年12月31日，本公司再生能源憑證數量共計118張，主要來源為環球晶圓竹南廠屋頂太陽能自發自用申請的憑證；2024年國外據點再生能源使用度數83,486,759度，再生能源的來源包括簽訂再生能源供應合約、屋頂太陽能板自發自用、外購水力發電與購買非化石證書(Non-Fossil Certificates, NFCs)。本公司歷年再生能源憑證數量以及氣候目標(電力單位耗能及溫室氣體單位排放量(範疇二))歷年達成進度等詳細資訊請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境/4.1氣候策略與行動」。</p>
<p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。</p>	<p>溫室氣體盤查及確信情形如下表1-1。 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫如下表1-2。</p>

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。			
範疇一 (涵蓋範圍)	年度	總排放量(公噸 CO2e)	密集度(公噸 CO2e/百萬元)
環球晶圓股份有限公司(母公司)	2023 年(查證)	2,043.7293	0.0661
	2024 年(查證)	2,447.1313	0.0884
範疇二 (涵蓋範圍)	年度	總排放量(公噸 CO2e)	密集度(公噸 CO2e/百萬元)
環球晶圓股份有限公司(母公司)	2023 年(查證)	147,918.5493	4.7822
	2024 年(查證)	156,074.0930	5.6380

註 1：環球晶圓股份有限公司(母公司)2023 年資料涵蓋範圍包括總公司新竹廠及竹南廠以及中德分公司；2024 年資料涵蓋範圍包括總公司新竹廠、竹南廠、竹南二廠以及中德分公司。

註 2：2023 年度及 2024 年度環球晶圓母公司營業收入分別為新台幣 30,931,369 千元及新台幣 27,682,470 千元。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

年度	確信範圍	確信標準			確信意見
		確信範圍	確信機構	確信準則	
2023	環球晶圓股份有限公司(母公司) - 總公司新竹廠及竹南廠	立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)	立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)	ISO 14064-3: 2019	範疇一及範疇二： 合理保證等級
	環球晶圓股份有限公司(母公司) - 中德分公司	英商勞盛股份有限公司台灣分公司(LRQA)	英商勞盛股份有限公司台灣分公司(LRQA)	ISO 14064-3: 2019	範疇一及範疇二： 合理保證等級
2024	環球晶圓股份有限公司(母公司) - 總公司新竹廠及竹南廠	立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)	立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)	ISO 14064-3: 2019	範疇一及範疇二： 合理保證等級
	環球晶圓股份有限公司(母公司) - 總公司竹南二廠	艾法諾國際股份有限公司(AFNOR)	艾法諾國際股份有限公司(AFNOR)	ISO 14064-3: 2019	範疇一及範疇二： 合理保證等級
	環球晶圓股份有限公司(母公司) - 中德分公司	英商勞盛股份有限公司台灣分公司(LRQA)	英商勞盛股份有限公司台灣分公司(LRQA)	ISO 14064-3: 2019	範疇一及範疇二： 合理保證等級

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

1. 減量基準年及其數據：環球晶圓以 2019 年作為溫室氣體減量基準年（範疇二排放量為 529,872.21 噸 CO₂e），因本公司之產業特性，溫室氣體排放量主要來源為範疇二，其約佔範疇一及範疇二總排放量之 95~98%，因此以溫室氣體單位排放量（範疇二）作為減量目標。
2. 減量目標：溫室氣體單位排放量（範疇二）以 2019 年為基準年，短期階段（1-3 年）目標較基準年度減量 1-3%，中期階段（3-10 年）較基準年度減量 4-10%，至 2030 年應較基準年度減量 10%，長期階段（10 年以上）較基準年度減量大於 10%。
3. 減量策略：

為因應氣候變遷議題，環球晶圓已制定溫室氣體政策，並透過訂定減量目標與各項推動措施，持續推動溫室氣體減量。同上揭之因素，因本公司之產業特性，溫室氣體排放量主要來源為範疇二，故溫室氣體排放減量策略以降低範疇二之碳排放量為主。為達成溫室氣體減量，本公司擬定策略如下：

- (1) 採用再生能源：以自建太陽能發電系統、導入汽電共生系統、與購買外部再生能源（例如：簽署長期購電合約 PPA、購買 RECs 或者其他相同於 I-REC 的再生能源憑證制度）同時並行持續提升再生能源之使用比例。
 - (2) 提升能源使用效率：透過設備改良進而降低設備耗用之能源。
 - (3) 購買碳補償商品：透過購買碳排放交易額度來抵銷其碳排放量。
 - (4) 碳清除：支持推展植樹計畫並參與其他自然解決方案及自然保護計畫。
 - (5) 上游價值鏈減碳：依照原物料造成的排放量將供應商分成三種等級，用以落實供應商的產品碳足跡第三方盤查，並且持續追蹤供應商提出的減碳路徑計畫，邀請大宗碳排放量供應商共同響應科學基礎減量目標倡議（SBTi），以達成範疇三的減量。
4. 具體行動計畫：環球晶圓為有效管理氣候變遷相關風險與機會對環球晶圓之衝擊，以實際行動支持淨零轉型，於 2022 年加入 RE100 倡議組織，透過提升能源使用效率，低碳技術轉型（優化設施及製程之節能行動計畫）並搭配發訂購電協議（Power Purchase Agreement, PPA）、購買再生能源憑證（Renewable Energy Certificates, RECs）、與上游價值鏈議合減碳等策略，逐步達成氣候藍圖規劃之階段性目標，最終實踐 2050 年前全集團 100% 使用再生能源之長期目標，減少發電過程所產生的碳排放量，進而實現減碳目標。
5. 減量目標達成情形：歷年達成情形等詳細數據資訊請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.1 氣候策略與行動」。

(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一) 本公司訂有經董事會通過、詳載誠信經營政策具體內容之「誠信經營守則」及「道德行為指南」，並訂有經董事長通過之「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」以求誠信經營政策之具體實踐。本公司制式契約對外文件悉已要求交易相對人遵守誠信經營政策；董事會及高階管理階層均簽署書面聲明，積極落實誠信經營政策之承諾，公司於內部管理及商業活動中亦確實執行，包含於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。</p> <p>(二) 本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中針對「誠信經營守則」第七條第二項列舉不誠信行為，訂定風險評估機制，包含：藉由年度部門應遵循之相關法令檢視表、質性訪談、資訊單位電子郵件追蹤…等控管方法蒐集資料，定期分析評估、辨識具較高風險者，並於必要時執行個案調查，並輔以內部稽核單位的查核機制，據以訂定防範行賄及收賄、提供非法政治獻金或不當利益、侵害智慧財產權、不公平競爭…等不誠信行為方案，確保公司經營符合誠信經營守則。本公司各單位人員於營業活動範圍內，對前揭不誠信行為控管方法均有配合法令遵循單位調查之義務。</p> <p>(三) 本公司依「誠信經營守則」所訂防範不誠信行為方案包含「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」；其等明確規範不得收受任何不正當利益，或作出違反誠信、不法等行為，並鼓勵呈報任何非法或違反道德行為之行為，另規定應定期向董事及員工宣導誠信行為之重要性。前揭方案依不誠信行為風險之評估機制所訂方式，定期檢討防範方案之</p>	<p>無重大差異</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一) 本公司「誠信經營守則」已明文規範於商業往來之前，應考量商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。另外，依本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，與他人建立商業關係前須經誠信經營評估；評估方式由行銷單位以「客戶／經銷商／代理商誠信經營評估表」、採購單位以「供應商（及其經銷商／代理商）誠信經營評估表」，書面量化執行；與商業往來交易對象簽訂之契約內容原則上應明訂誠信經營條款，確保相對人遵守本公司誠信經營政策。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二) 本公司已於法務室建立所屬法令遵循課，負責統籌推動誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督執行，並由法令遵循主管每年一次向董事會報告其情形，最近一次提報董事會日期為113年11月5日；另稽核人員亦於日常稽核中監督執行，若有發現異常事項，亦得隨時向董事會報告。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		當年度相關執行情形： (1) 誠信經營相關政策之制定與檢討 本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，明確規範不得收受任何不正當利益，或作出違反誠信、不法等行為；上述內部規章並由法令遵循課參考外部規範之變動及內部監督執行情形，不定期檢討並調整、修正。113年配合電子產業採行之責任商業聯盟行
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>為準則 (RBA Code of Conduct 8.0)，修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，新訂贈送或收受供應商或客戶之禮物「成本」及「頻率」規範。</p> <p>(2)對內與對外政策宣導</p> <p>本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等相關重要內規已公告於公司網站及內部網站供外界與公司同仁隨時查詢；另本公司要求供應商簽署遵循法令、道德、環境及品質規範之「供應商行為準則暨供應商承諾書」，且與商業往來交易對象簽訂之制式契約內容亦已包含遵守誠信經營行為之相關條款。</p> <p>(3)檢舉管道、處置與檢舉人保護</p> <p>本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，建立違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於公司廠房與內、外部網站設置並公告員工意見箱、電子信箱及申訴專線，以鼓勵公司內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為。本公司允許匿名檢舉，對於檢舉人身分及檢舉內容會確實保密，由人資單位負責查證與處理；如有違反誠信經營規定者，將視情節輕重予以適當處置，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。</p> <p>(4)教育訓練</p> <p>本公司定期擬訂並實施教育訓練，113年度授課對象及時數列舉如下：</p> <p>1. 對新任董事及新進員工實施1小時「內部人教育訓練」；內容包含內線交易法令解析（構成要件、重大消息公開方式及時點、司法見解）及內部人股權異動法令解析（事前/事後申報義務、董監持股成數維持），參與人次計116人。</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>2. 對新任董事及新進員工實施1.5小時「誠信經營教育訓練」；內容包含營業秘密保護、競爭法、反貪腐、防範利益衝突及出口管制...等，與科技產業密切相關之重大法令遵循議題，參與人次計116人。</p> <p>(三)本公司於「道德行為準則」明訂本公司人員應以客觀及有效率之方式處理業務，避免利用其在公司擔任之職務，使其自身、他人或其他企業獲致不當利益之防止利益衝突政策，且於「誠信經營程序及行為指南」詳細規範利害關係人就董事會各項議案有利益衝突時所應行利益迴避方式。又，本公司提供之利益衝突陳述管道依主體不同，區分如下：董事或獨立董事應向總經理室或公司治理主管為之；經理人則應向法令遵循單位為之；其餘同仁應陳報直屬主管及法遵單位，並由直屬主管適當指導之。113年新訂「員工利益迴避宣導暨確認函」，發放新進同仁到職時簽回，據以向同仁宣導利益衝突迴避的各項要點及管理措施，確認員工無利益衝突情事，並使員工明確了解發生利益衝突時其所負主動通報之義務。</p> <p>(四)本公司已建立會計制度及內部控制制度，並落實執行，且由內部稽核人員依不誠信行為風險之評估結果，擬訂包括稽核對象、範圍、項目、頻率等內容之稽核計畫，據以查核防範方案遵循情形；查核結果應通報高階管理層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。另本公司為確保保制度之設計及執行持續有效，每年進行檢視及修訂作業，以建立良好公司治理與風險管控機制，作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。</p> <p>(五)本公司定期擬訂並實施教育訓練，課程包括公司治理、誠信經營、商業行為有關法令等相關領域；針對「誠信經營」及</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>「防範內線交易」課程，就現任董事、經理人及依需求或經認有修課必要之受僱人至少每二年辦理一次，新任董事及經理人於上任後三個月內辦理，新進受僱人員則由人資單位於職前訓練時併同辦理。此外，依本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，亦安排董事長或公司治理主管於董事會及主管會議向董事、經理人、主管等傳達誠信之重要性。本公司113年度開設之相關訓練課程有「內部人教育訓練」及「誠信經營教育訓練」，具體課程內容參照上述(二)(4)說明，修課人數累計232人次。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理事專責人員？</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一)本公司於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」訂有具體制度，包含建置員工意見箱、電子信箱及申訴專線等內、外部檢舉管道及處理原則，俾誠信經營政策得據以落實。檢舉案由本公司發言人、人事主管或法務人員受理，立案後依案情交由處理單位依本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」規定調查、處理；經查證屬實者，得視重要性提供檢舉人適當獎勵。</p> <p>(二)本公司於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」依被檢舉人及涉案態樣不同，分別訂有相對應之調查、處理程序；又檢舉案之處理均以保密、全力保護檢舉人、提供相對人申訴機會…等方式為之，以確保檢舉人及相對人之合法權益。檢舉情事經查證屬實者，後續將立即要求被檢舉人停止、為適當之處置、責成相關單位檢討並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生；法務單位將另就檢舉情事、處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告之。</p> <p>(三)本公司依「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」以保密方式處理檢舉案件，允許匿名檢舉，並全力保護</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？			檢舉人，其身分將絕對保密，亦不因檢舉情事而遭不當處置；處理檢舉案之人員另應向檢舉人書面表示其身分與檢舉內容將被保密。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定「誠信經營守則」，清楚規範公司人員應遵守之事項，另檢舉與懲處亦已明定於各相關辦法中，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。	V		(一)本公司設有網站揭露相關企業文化、經營方針及「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」文件與履行誠信經營情形…等相關資訊。 無重大差異

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1. 本公司網站：<http://www.sas-globalwafers.com> 「投資人專區」及「企業永續」
2. 董事進修情形：請參見公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)
 首頁>彙總報表>公司治理>董事/獨立董事/監察人>董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表 (市場別：上櫃；公司代號：6488)。

(十) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：請參見公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)
 首頁>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告 (市場別：上櫃；公司代號：6488)。網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

甲、 113 年股東常會(113.06.18)重要決議及執行情形

重要決議	執行情形
1.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	經股東會決議後，依修訂後之條文實施。
2.全面改選董事案	經股東會決議後，於 113 年 7 月 1 日經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局准予登記。
3.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	依股東會決議解除新任董事競業禁止之限制。
4.通過承認 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案	經股東會決議照案承認。

乙、 董事會重要決議

日期	重要決議
第五屆 第十八次 113.01.17	1.為本公司之德國子公司 GlobalWafers GmbH 擬發行海外附認股權公司債，本公司並擬就所發行之海外附認股權公司債提供保證
第五屆 第十九次 113.02.27	1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 3.配合會計師事務所內部業務調整，變更本公司簽證會計師案 4.本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案 5.修訂本公司內部控制制度案 6.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 7.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案 8.本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證 9.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案 10.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案 11.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 12.修訂本公司「董事會議事規範」案

日期	重要決議
	13.修訂本公司「審計委員會組織規程」案 14.修訂本公司「預先核准非確信服務之政策之一般原則方法」 15.全面改選董事案 16.提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案 17.解除新任董事競業禁止之限制案 18.召開 113 年股東常會議程暨受理股東提案及提名之相關事宜案
第五屆 第二十次 113.04.10	1.本公司擬設立台灣子公司環球晶資本股份有限公司案 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 3.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函(LOS)案
第五屆 第二十一次 113.05.07	1.本公司 113 年度第一季合併財務報告案。 2.本公司 112 年度盈餘分配表暨 112 年下半年度盈餘分派案。 3.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案。 4.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案。 5.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案。 6.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案。 7.本公司為子公司兆遠科技股份有限公司出具背書保證案，因兆遠科技股份有限公司 112 年第 4 季財報淨值已低於實收資本額二分之一，依本公司背書保證辦法擬具後續相關管控措施。 8.本公司為子公司 GlobalWafers GmbH 出具背書保證案，因 GlobalWafers GmbH 自 110 年第 1 季起財報淨值已低於實收資本額二分之一，依本公司背書保證辦法擬具後續相關管控措施。 9.本公司 112 年度「永續報告書」暨「企業永續發展委員會」之年度推行與執行情形。 10.本公司擬捐贈「江賢二藝術文化基金會」新台幣伍佰萬元案。 11.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案。 12.解除本公司經理人競業禁止之限制案。 13.人事晉升案。 14.本公司 112 年度董事酬勞分配案。 15.本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案。
第五屆 第二十二次 113.06.13	1.本公司資金貸與子公司案。 2.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案。
第六屆 第一次 113.06.18	1.推選董事長案 2.委任第五屆薪資報酬委員會委員案 3.委任第三屆提名委員會委員案
第六屆 第二次 113.08.06	1.本公司 113 年度第二季合併財務報告案。 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案。 3.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函(LOS)案。 4.為子公司旭愛能源股份有限公司與高雄市立鳳翔國民中學簽訂租賃契約，由本公司擔任連帶保證人案。 5.修訂本公司「應收帳款備抵呆帳提列辦法」，訂定重大性金額之評估標準案。
第六屆 第三次	1.本公司 113 年度第三季合併財務報告案。 2.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。

日期	重要決議
113.11.05	3.本公司 114 年度內部稽核計畫案。 4.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案。 5.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函（LOS）案。 6.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案。 7.本公司資金貸與子公司案。 8.為子公司申請美國《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）直接補助（Direct Funding），由本公司擔任保證人案。 9.本公司日本子公司 MEMC Japan Ltd. 2017 至 2023 年盈餘不匯回分配案。 10.訂定本公司「企業永續發展委員會組織規程」暨委任永續長案。 11.修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。 12.修訂本公司「預先核准非確信服務之政策之一般原則方法」。 13.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案。 14.人事晉升案。 15.本公司經理人調薪案。
第六屆 第四次 113.12.10	1.擬訂本公司 114 年度營運計劃案。 2.本公司 113 年上半年度盈餘分派案。 3.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案。 4.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案。 5.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函（LOS）案。 6.取消為子公司向供應商購置機器設備，由本公司提供保證案。 7.為子公司申請美國《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）直接補助（Direct Funding），調整本公司擔任保證人之保證條件案。
第六屆 第五次 114.02.25	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司義大利子公司 MEMC Electronic Materials S.p.A. 2016 年 12 月至 2018 年盈餘不匯回分配案。 3.本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 4.本公司 113 年度盈餘分配表暨 113 年下半年度盈餘分派案。 5.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨續委任案。 6.本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 7.修訂本公司「公司章程」案。 8.本公司「基層員工」範圍訂定案。 9.召開 114 年股東常會議程暨受理股東提案之相關事宜案。 10.本公司擬發行國內無擔保普通公司債案。 11.本公司擬與金融機構簽訂 Cash Pool Agreement 並提供保證案。 12.本公司經理人調薪案。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	黃泳華	113 年度	7,211	稅務相關服務 3,094	10,305	
	吳俊源					

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

公司最近二年度及其期後期間更換會計師情形：本公司最近二年度更換簽證會計師係安侯建業聯合會計師事務所內部組織調整及業務調度，並無更換簽證會計師事務所。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形：

請參見公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)

股權移轉：首頁>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表(公司代號：6488)。

網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

股權質押變動情形：首頁>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告(公司代號：6488)。

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三)股權質押相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

單位：股；%；114年3月27日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
中美矽晶製品股份有限公司	223,007,864	46.64%	—	—	—	—	無	無	
代表人：徐秀蘭	847,879	0.18%	—	—	—	—	無	無	
富邦人壽保險股份有限公司	10,763,000	2.25%	—	—	—	—	無	無	
國泰人壽保險股份有限公司	10,675,000	2.23%	—	—	—	—	無	無	
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	9,365,000	1.96%	—	—	—	—	無	無	
南山人壽保險股份有限公司	5,949,000	1.24%	—	—	—	—	無	無	
新制勞工退休基金	5,104,000	1.07%	—	—	—	—	無	無	
臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30 ETF證券投資信託基金專戶	4,714,000	0.99%	—	—	—	—	無	無	
凱基人壽保險股份有限公司	3,916,000	0.82%	—	—	—	—	無	無	
全球人壽保險股份有限公司	3,790,800	0.79%	—	—	—	—	無	無	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管WGI新興市場基金公司投資專戶	3,671,000	0.77%	—	—	—	—	無	無	

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

113年12月31日

單位：仟股；%

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
GlobalSemiconductor Inc.	23,000	100.00%	-	-	23,000	100.00%
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	128	100.00%	-	-	128	100.00%
GlobalWafers GmbH	48,025	100.00%	-	-	48,025	100.00%
GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.	41,674	100.00%	-	-	41,674	100.00%
GlobalWafers B.V.	0.1	100.00%	-	-	0.1	100.00%
旭愛能源股份有限公司	104,500	100.00%	-	-	104,500	100.00%
旭信電力股份有限公司	14,134	100.00%	-	-	14,134	100.00%
寰球鑫投資股份有限公司	25,000	100.00%	-	-	25,000	100.00%
環球晶資本股份有限公司	32,529	100.00%	-	-	32,529	100.00%
弘望投資股份有限公司	30,976	30.98%	-	-	30,976	30.98%
兆遠科技股份有限公司	43,836	100.00%	-	-	43,836	100.00%
Crystalwise Technology (HK) Limited	-	-	47,650	100.00%	47,650	100.00%
元鴻(山東)光電材料有限公司	-	-	(註2)	100.00%	(註2)	100.00%
昆山中辰矽晶有限公司	-	-	(註2)	100.00%	(註2)	100.00%
MEMC Electronic Materials Sdn. Bhd.	-	-	89,586	100.00%	89,586	100.00%
昆山辰巨電子科技有限公司	-	-	(註2)	100.00%	(註2)	100.00%
上海召業申凱電子材料有限公司	-	-	(註2)	100.00%	(註2)	100.00%
忻州元鴻信息材料有限公司	-	-	(註2)	90.00%	(註2)	90.00%
MEMC Japan Ltd.	-	-	750	100.00%	750	100.00%
MEMC Electronic Materials S.p.A.	-	-	65,000	100.00%	65,000	100.00%
MEMC Electronic Materials France SarL	-	-	0.5	100.00%	0.5	100.00%
GlobiTech Incorporated.	-	-	1	100.00%	1	100.00%
MEMC LLC	-	-	-	100.00%	-	100.00%
GlobalWafers America, LLC	-	-	1	100.00%	1	100.00%
MEMC Korea Company	-	-	25,200	100.00%	25,200	100.00%
MEMC Ipoh Sdn. Bhd.	-	-	612,300	100.00%	612,300	100.00%
Topsil GlobalWafers A/S	-	-	1,000	100.00%	1,000	100.00%

註1：係公司採用權益法之投資。

註2：為有限公司，故無股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 已發行股份種類

114年03月31日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名普通股	478,113,725	521,886,275	1,000,000,000	該股票係屬上櫃股票

2. 股本形成經過

114年03月31日；單位：新台幣元；股

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金外財產抵充者	現以之其他
100/10	10	300,000,000	3,000,000,000	180,000,000	1,800,000,000	設立資本 1,800,000,000元	無	註1
101/05	10	400,000,000	4,000,000,000	317,500,000	3,175,000,000	現金增資 1,375,000,000元	無	註2
104/01	10	400,000,000	4,000,000,000	349,250,000	3,492,500,000	現金增資 317,500,000元	無	註3
104/09	10	400,000,000	4,000,000,000	369,250,000	3,692,500,000	現金增資 200,000,000元	無	註4
106/05	10	600,000,000	6,000,000,000	437,250,000	4,372,500,000	現金增資 680,000,000元	無	註5
111/11	10	600,000,000	6,000,000,000	435,237,000	4,352,370,000	註銷庫藏股減資 20,130,000元	無	註6
112/11	10	1,000,000,000	10,000,000,000	436,113,725	4,361,137,250	與兆遠科技進行 股份轉換發行新股 8,767,250元	無	註7
113/04	10	1,000,000,000	10,000,000,000	478,113,725	4,781,137,250	現金增資 420,000,000元	無	註8

註1：新竹科學園區管理局 100年10月18日園商字第1000030345號核准函。

註2：新竹科學園區管理局 101年05月16日園商字第1010014266號核准函。

註3：新竹科學園區管理局 104年02月25日竹商字第1040005439號核准函。

註4：新竹科學園區管理局 104年10月15日竹商字第1040029649號核准函。

註5：新竹科學園區管理局 106年05月17日竹商字第1060012613號核准函。

註6：新竹科學園區管理局 111年11月09日竹商字第1110035918號核准函。

註7：新竹科學園區管理局 112年11月17日竹商字第1120037966號核准函。

註8：新竹科學園區管理局 113年04月19日竹商字第1130011578號核准函。

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

114年3月27日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
中美矽晶製品股份有限公司		223,007,864	46.64%
富邦人壽保險股份有限公司		10,763,000	2.25%
國泰人壽保險股份有限公司		10,675,000	2.23%
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶		9,365,000	1.96%
南山人壽保險股份有限公司		5,949,000	1.24%
新制勞工退休基金		5,104,000	1.07%
臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金專戶		4,714,000	0.99%
凱基人壽保險股份有限公司		3,916,000	0.82%
全球人壽保險股份有限公司		3,790,800	0.79%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管WGI新興市場基金公司投資專戶		3,671,000	0.77%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

依據本公司之章程規定，本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分配之：

- (1) 彌補虧損。
- (2) 提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
- (3) 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- (4) 當年度盈餘扣除上列一至三項後，如尚有盈餘併同以前年度未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配案，以現金方式為之時，依公司法第240條第5項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息或紅利之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司為維持公司永續經營發展及每股盈餘之穩定成長，股東股利以當年度稅後盈餘扣除當年度依法應提列特別盈餘公積後之百分之五十以上為原則，分配比率為現金股利不低於百分之五十。

本公司依公司法第241條規定，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金，以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數決議之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發放之

對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。董事酬勞以現金方式分派，員工酬勞以股票或現金方式分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2. 本次股東會報告股利分配之情形

依本公司章程規定，授權董事會於每半年度終了後，得決議以現金分派盈餘及資本公積。本公司董事會決議核准之民國 113 年各半年度現金股利，其金額與發放日期如下：

民國 113 年	核准日期 (民國年/月/日)	發放日期 (民國年/月/日)	每股現金股利 (新台幣元)	配發現金總金額 (新台幣元)
上半年度	113/12/10	114/2/14	5	2,390,568,625
下半年度	114/2/25	114/8/15	6	2,868,682,350
合計			11	5,259,250,975

3. 預期股利政策將有重大變動說明：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

請詳上述(三) 1. 股利政策之說明。

2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1) 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：依公司章程規定估列。

(2) 本期以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：員工酬勞若以股票分派之股數計算基礎係依據最近一期會計師查核之財務報告淨值為計算基礎，本期並無以股票分派員工酬勞情形。

(3) 本期實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：股東會決議與估列數如有差異，視為估計變動，列為當期損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於114年2月25日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞如下：

員工酬勞：新台幣366,824,575元，全數以現金發放。

董事酬勞：新台幣36,690,000元，全數以現金發放。

員工酬勞及董事酬勞實際配發情形與113年度財務報表認列數並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞經 113 年 2 月 27 日董事會決議配發如下

單位：元

項目	董事會決議配發	實際分派情形	差異數	差異說明
員工現金紅利	752,539,343	752,539,343	無	不適用
董監酬勞	75,250,000	75,250,000	無	不適用

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

114年3月31日

公司債種類	110年度第1期 無擔保普通公司債	110年度第2期 無擔保普通公司債	113年度第1期 無擔保普通公司債
發行(辦理)日期	110.05.11	110.08.19	113.03.19
票面金額	新台幣 1,000,000 元	新台幣 1,000,000 元	新台幣 1,000,000 元
發行及交易地點	中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格	依面額 100%發行	依面額 100%發行	依面額 100%發行
發行總額	新台幣 6,500,000,000 元	甲券:新台幣 7,100,000,000 元 乙券:新台幣 5,400,000,000 元	甲券:新台幣 2,500,000,000 元 乙券:新台幣 2,500,000,000 元
票面利率	固定年利率 0.62%	甲券:固定年利率 0.50% 乙券:固定年利率 0.60%	甲券:固定年利率 1.70% 乙券:固定年利率 1.75%
期限	5 年期, 到期日:115.05.11	甲券: 3 年期, 到期日:113.08.19 乙券: 5 年期, 到期日:115.08.19	甲券: 5 年期, 到期日:118.03.19 乙券: 7 年期, 到期日:120.03.19
保證機構	無	無	無
受託人	台北富邦商業銀行 股份有限公司	台北富邦商業銀行 股份有限公司	台北富邦商業銀行 股份有限公司
承銷機構	元大證券、凱基證券	元大證券、凱基證券 富邦證券	富邦證券、凱基證券
簽證律師	一誠聯合法律事務所 郭惠吉律師	一誠聯合法律事務所 郭惠吉律師	一誠聯合法律事務所 郭惠吉律師
簽證會計師	安侯建業聯合會計師事務所 陳振乾會計師	安侯建業聯合會計師事務所 鄭安志會計師	安侯建業聯合會計師事務所 鄭安志會計師
償還方法	到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本
未償還本金	新台幣 6,500,000,000 元	乙券:新台幣 5,400,000,000 元	甲券:新台幣 2,500,000,000 元 乙券:新台幣 2,500,000,000 元
贖回或提前清償 之條款	無	無	無
限制條款	無	無	無
信用評等機構名稱、 評等日期、公司債評 等結果	不適用	不適用	不適用
附其他 權利	已轉換普通 股、海外存 託憑證或其 他有價證券 之金額	不適用	不適用
	發行及轉換 辦法	無	無
發行及轉換辦法、發 行條件對股權可能稀 釋情形及對現有股東 權益影響	無	無	無
交換標的委託保管機 構名稱	無	無	無

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：

114年3月31日

發行日期	106年4月26日	113年4月2日
項目		
發行及交易地點	盧森堡證券交易所	盧森堡證券交易所
發行總金額	USD 469,200,000 元	USD 688,800,000 元
單位發行價格	每單位海外存託憑證交易價格為 6.9 美元	每單位海外存託憑證交易價格為 16.40 美元
發行單位總數	68,000,000 單位	42,000,000 單位
表彰有價證券之來源	環球晶圓股份有限公司普通股	環球晶圓股份有限公司普通股
表彰有價證券之數額	68,000,000 股	42,000,000 股
存託憑證持有之權利與義務	<p>海外存託憑證持有人之權利義務，應依中華民國相關法令及存託契約有關規定辦理。存託契約主要約定事項如下：</p> <p>(一)表決權之行使 除法令另有規定外，海外存託憑證持有人得依存託契約及中華民國法令規定，行使其海外存託憑證所表彰之環球晶圓普通股之表決權。</p> <p>(二)股利分配、新股優先認購權及其他權益 除存託契約另有規定外，海外存託憑證持有人原則上享有與環球晶圓普通股股東同等之股利分派及其他配股權利。如環球晶圓未來發放股票股利事宜時，存託機構將依存託契約及相關法律之規定，按海外存託憑證持有人原持有單位數比例增發海外存託憑證予海外存託憑證持有人，或提高每單位海外存託憑證所表彰之環球晶圓普通股，或代海外存託憑證持有人出售該股票股利，並將出售所得之金額(扣除稅賦及相關費用後)按比例分配予海外存託憑證持有人。 環球晶圓辦理現金增資或其他認股權時，海外存託憑證持有人在符合中華民國及其他相關法令之情形下原則上享有與環球晶圓普通股股東同等之新股優先認股權利，存託機構應於存託契約及相關法律許可之範圍內，按存託契約之規定，提供海外存託憑證持有人該等權利，或代海外存託憑證持有人出售此權利，並將出售所得之價金(扣除稅賦及相關費用後)按比例分配予海外存託憑證持有人。</p>	
受託人	不適用	
存託機構	CitiBank, N.A.	
保管機構	第一商業銀行	
未兌回餘額	102,040 單位	
發行及存續期間相關費用之分攤方式	<p>(一)海外存託憑證發行相關費用 除法令另有規定或發行公司與國外主辦承銷商及存託機構另有約定外，所有海外存託憑證之發行成本及費用，包括法律費用、上市掛牌費用、財務顧問費用及其他相關費用及支出，均由發行公司負擔。</p> <p>(二)海外存託憑證存續期間之費用 海外存託憑證存續期間之各年度上市費用、資訊揭露及其他相關費用，除法令另有規定外或發行公司與國外主辦承銷商及存託機構另有約定外，皆由發行公司負擔。</p>	
存託契約及保管契約之重要約定事項	詳如存託契約及保管契約	

每單位市價	113 年	最高	USD 19.40
		最低	USD 10.90
		平均	USD 15.743
	當年度截至 114 年 3 月 31 日	最高	USD 12.50
		最低	USD 9.60
		平均	USD 11.036

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一) 113 年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證

1. 計畫內容

(1) 主管機關核准日期及文號：金融監督管理委員會 113 年 3 月 25 日金管證發字第 1130335294 號。

(2) 本次計畫所需資金總額：美金 761,850 仟元。

(3) 本次計畫資金來源：現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，本次計畫已於 113 年 4 月 2 日完成募集美金 688,800 仟元並輸入公開資訊觀測站。本次計畫募集資金不足之差額本公司將以自有資金或其他方式支應。

(4) 資金用途：充實原幣購料所需之資金。

(5) 計畫項目及預計執行進度：

單位：千元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額		預定資金運用計畫					
				113 年度			114 年度		
				第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季
原幣購料	114 年度	美金	761,850	122,000	131,000	139,000	154,000	150,000	65,850
	第三季	新台幣	23,845,905	3,818,600	4,100,300	4,350,700	4,820,200	4,695,000	2,061,105

註：以新台幣兌換美元之匯率 NTD 31.3：USD 1 估算。

(6) 預計產生效益：

(a) 挹注營運資金。

(b) 節省利息支出，增加獲利能力：本公司預計於 113 年第二季資金募集完成後，用以充實原幣購料款，以本公司本次用於原幣購料美金 761,850 千元計算(約折合新台幣 23,845,905 千元)及近期往來銀行美金借款利率估算，預計每年可節省利息支出為美金 46,244 千元，約折合新台幣 1,447,437 千元(暫定匯率美金：新台幣=1：31.3)，將可適度減輕財務負擔並提升償債能力，對本公司未來營運及獲利能力將有正面助益。

2. 執行情形

請參見公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)

首頁>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行>募資計畫執行專區 (公司代號：6488；增資計劃：1130325 核准之海外存託憑證)>運用情形季報表。

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 所營業務之主要內容

CC01080 電子零組件製造業

C801990 其他化學材料製造業

F119010 電子材料批發業（限區外經營）

F219010 電子材料零售業（限區外經營）

CB01010 機械設備製造業

F401010 國際貿易業

研發、設計、開發、製造及銷售下列產品：

1. 半導體矽晶材料及其元件

2. 矽化合物

3. 碳化矽化合物

4. 半導體設備

5. 碳化矽晶體生長設備

6. 兼營與前項業務相關之進出口貿易業務

2. 營業比重

單位：新台幣仟元

年度 產品項目	112 年度		113 年度	
	營業收入淨額	比重(%)	營業收入淨額	比重(%)
半導體晶片產品	68,782,595	97.4%	60,762,655	97.0%
半導體晶錠產品	1,270,226	1.8%	1,372,868	2.2%
電費收入	115,790	0.2%	154,604	0.3%
其他	482,982	0.6%	335,877	0.5%
合計	70,651,593	100.0%	62,626,004	100.0%

3. 目前之商品項目

A、超低電阻重摻銻晶圓

B、12吋特殊磊晶晶圓應用於影像感測元件及功率元件

C、12吋(110)及(111)特殊晶圓

D、SOI 晶圓

E、拋光晶圓及磊晶晶圓

F、退火晶圓

G、超薄晶圓

H、高亮度浸蝕晶圓

I、擴散晶圓及深擴散拋光晶圓

J、Ga_N_HEMT 磊晶用高強度矽基板

- K、FZ 矽晶圓
- L、中子照射超純矽晶圓
- M、Perfect Silicon
- N、客製化”ECAS”晶圓
- O、氮化鎵磊晶片
- P、4吋~8吋導電型碳化矽晶圓
- Q、4吋~6吋半絕緣碳化矽晶體與晶片
- R、太鼓晶片
- S、其他化合物晶體

4. 計畫開發之新商品

- A、次世代高功率車用電子元件用碳化矽晶圓
- B、GaN_HEMT 用磊晶晶圓
- C、矽光子 SOI 晶圓
- D、LNO, LTO /矽晶圓接合晶圓
- E、高電阻 ECAS 晶圓襯底接合晶圓
- F、12吋鑽石線切割製程開發
- G、次世代 3D 記憶體用矽晶圓
- H、8吋碳化矽磊晶開發
- I、新世代碳化矽晶體生長爐
- J、12吋碳化矽晶片

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

A.全球半導體市場需求

2024 年半導體市場在經歷前期庫存調整與地緣政治風險後，復甦動能逐漸浮現。預計 2025 年上半年仍將面臨庫存消化與關稅不確定性的挑戰，但隨著庫存水位下降及貿易環境趨穩，下半年市場需求回升趨勢將更加明顯。受惠於平價 AI 模型與先進封裝技術的發展，晶圓產能利用率持續提升，下游產能擴張及先進封裝架構進一步推動市場成長，帶動更高的晶圓耗用量。此外，在持續變化的關稅政策與日益上升的運輸成本影響下，市場對於在地供應鏈與技術創新的先進晶圓需求顯著增加。為滿足市場需求，全球半導體產能亦正持續擴產，國際半導體產業協會 SEMI 預估，至 2025 年全球晶圓月產能將達 3,360 萬片 (wpm)，年均成長率約 6.6%，為半導體產業的長期發展奠定一定基礎。展望未來，世界半導體貿易統計組織 WSTS 預測，2025 年半導體市場全面成長 11.2%，使全球半導體市場總值達到約 6,972 億美元，成長原因主要係由邏輯晶片 (Logic) 與記憶體 (Memory) 兩大領域推動，合計市值預計將超過 4,000 億美元。其中，邏輯晶片市場將實現近 17% 的年成長率，而記憶體市場則預計成長 13%。其他半導體類別預計將以較溫和的個位數成長率成長，顯示產業仍維持穩健擴展的趨勢。針對半導體產業區域，WSTS 預期 2025 年半導體產業全區皆會成長，美洲市場將成長 15.4%，歐洲市場成長 3.3%、日本成長 9.4%、亞太地區成長 10.4%。整體而言，

半導體市場於 2025 年仍預期保持溫和成長態勢。

Fall 2024	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Americas	134,377	186,635	215,309	-4.8	38.9	15.4
Europe	55,763	52,031	53,736	3.5	-6.7	3.3
Japan	46,751	47,410	51,866	-2.9	1.4	9.4
Asia Pacific	289,994	340,792	376,273	-12.4	17.5	10.4
Total World - \$M	526,885	626,869	697,184	-8.2	19.0	11.2
Discrete Semiconductors	35,530	31,546	33,377	4.5	-11.2	5.8
Optoelectronics	43,184	42,092	43,705	-1.6	-2.5	3.8
Sensors	19,730	18,732	20,034	-9.4	-5.1	7.0
Integrated Circuits	428,442	534,499	600,069	-9.7	24.8	12.3
Analog	81,225	79,433	83,157	-8.7	-2.2	4.7
Micro	76,340	79,291	83,723	-3.5	3.9	5.6
Logic	178,589	208,723	243,782	1.1	16.9	16.8
Memory	92,288	167,053	189,407	-28.9	81.0	13.4
Total Products - \$M	526,885	626,869	697,184	-8.2	19.0	11.2

資料來源：世界半導體貿易統計組織 WSTS (2024/12/3)

隨著人工智慧 (AI) 持續推動高階邏輯製程晶片需求，以及高價高頻寬記憶體 (HBM) 滲透率提升的推動下，半導體供應鏈涵蓋設計、製造、測試及先進封裝，在上下游橫縱合作之下，預期將迎來新一輪成長浪潮，整體半導體市場預期於 2025 年將實現雙位數成長。國際數據資訊 IDC 研究顯示，預計 2025 AI 驅動的高速成長仍將持續，其中記憶體領域可望成長超過 24%，主要動能來自 AI Accelerator 需要搭配的 HBM3、HBM3e 等高階產品滲透率持續提升，以及新一代 HBM4 預計於 2025 下半年問世所帶動。非記憶體領域則可望成長 13%，主要受惠於採用先進製程晶片，如 AI 伺服器、高階手機晶片等需求暢旺，成熟製程晶片市場也將在消費電子市場回溫激勵下預期有正面表現。

在 AI 需求的推動下，先進製程需求持續強勁，晶圓代工廠加速擴產。IDC 預計，2025 年晶圓製造產能將年增 7%，其中先進製程產能將以 12% 的年增幅擴張，並預計平均產能利用率將穩定維持在 90% 以上的水平；成熟與主流製程應用廣泛，涵蓋消費性電子、車用及工控等領域。展望 2025 年，IDC 預期在消費電子需求回溫的帶動下，加上車用與工控領域出現零星庫存回補動能，整體市場需求將持續復甦。200mm 晶圓廠的平均產能利用率可望從 2024 年的 70% 上升至 75%，而 300mm 成熟製程的平均產能利用率也將提升至 76% 以上，帶動 2025 年晶圓代工產能利用率平均提高 5 個百分點，顯示成熟製程仍將維持穩健需求。另依據 SEMI 表示，全球半導體產業計劃於 2025 年興建 18 座新晶圓廠，其中包括 3 座 200mm 廠及 15 座 300mm 廠，大部分新廠預計於 2026 至 2027 年投產，顯示出半導體市場對未來需求的積極預期，且隨著 AI 需求的進一步發酵，半導體產業的長期需求動能預期將維持穩定增長。

展望未來，半導體市場在經歷前期庫存調整與地緣政治變數後，預計將逐步回穩。在 AI 應用需求帶動下，先進製程產能持續擴張，成熟製程市場亦受惠於消費電子、車用與工控領域的回暖，帶動整體市場需求回升。然而，全球經濟環境、關稅政策與運輸

成本變動仍可能影響供應鏈發展，市場成長仍需審慎觀察。根據 WSTS 與 IDC 預測，2025 年全球半導體市場可望維持成長態勢，邏輯晶片與記憶體市場將是主要驅動力，然整體成長幅度仍受產業變數影響。隨著技術發展與產能調整，半導體產業仍處於動態變化中，未來發展仍需視市場需求與全球經濟走勢而定，惟在更多創新應用推出如 5G、電動化、智慧座艙、自動駕駛等創新應用推動，以及淨零碳排政策等激勵下，半導體市場仍具成長潛力，並將展現一定的韌性。

B. 半導體晶圓產業概況

半導體製造流程係包括 IC 設計、IC 晶圓製造、IC 封裝、IC 測試等階段，依上、中、下游來劃分半導體產業整體結構，IC 設計應屬半導體上游產業、IC 晶圓製造則屬中游產業；IC 封裝、IC 測試則屬下游產業。半導體晶圓製造業於整個半導體產業架構中係擔任晶圓材料供應者角色，隨著半導體產業的蓬勃發展，對半導體晶圓材料之需求亦急速增加。

矽晶圓為目前主要製作積體電路之基底材料，其原始材料「矽」，是地殼表面取之不盡、用之不竭的二氧化矽礦石，經由電弧爐提煉、鹽酸氯化及蒸餾處理後，製成高純度的多晶矽，其純度要求達 99.999999999%。矽晶圓製造廠將此多晶矽加熱融解，並於熔融液摻入一小粒的矽晶體晶種，將其緩慢地拉出成形，讓多晶矽被拉成不同直徑大小的單晶矽晶棒，因矽晶棒是由一顆小晶粒在熔融態的矽原料中逐漸生成，此過程稱為「長晶」。矽晶棒再經過切割、研磨、拋光、切片等加工製程，即可成為積體電路產業之重要原料—「矽晶圓」。每塊數英寸直徑大小的空白矽晶圓，經過複雜的化學和電子製程後，可佈設多層精細的電子電路，而依面積大小有 3 吋、4 吋、5 吋、6 吋、8 吋及 12 吋(直徑)等規格之分，這些矽晶圓經送至晶圓廠內製造晶片電路後，再經切割、測試、封裝等程序，即成為市面上一顆顆的 IC。

目前半導體產業所使用之矽晶圓材料，依其製程設計和產品差異主要分為拋光晶圓 (polished wafer)、退火晶圓(argon anneal wafer)及磊晶晶圓 (epitaxial wafer) 三種，其均由高純度電子級多晶矽經由長晶 (crystal pulling)、切片 (slicing)、磨邊 (beveling)、磨面 (lapping)、蝕刻 (etching)、拋光 (polishing)、清洗 (cleaning) 等步驟，而生成一符合電性、表面物性、雜質標準等規格的拋光晶圓，拋光晶圓如果再經由化學氣相沉積反應，成長一層不同電阻率的單晶薄膜，就成為磊晶晶圓，由於磊晶晶圓擁有更佳的面積特性，被廣泛應用在各種分離式元件及高性能積體電路。

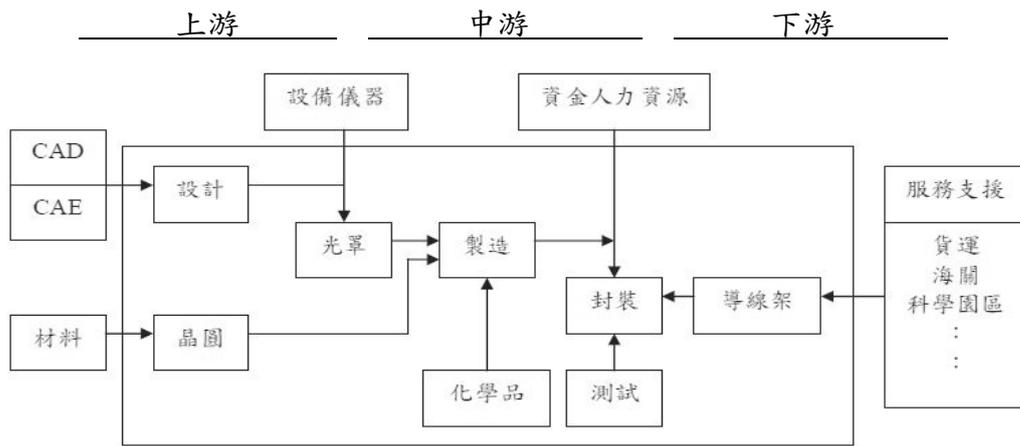
化合物半導體 (Compound Semiconductor) 指由兩種或以上的元素組成半導體材料，如砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN) 等。相比傳統矽 (Si) 半導體，化合物半導體具備高頻、高功率、高耐壓、低功耗、光電特性優越等優勢，在 5G 通訊、電動車 (EV)、功率電子、光電、航太軍事領域有著廣泛應用。下表為目前化合物半導體主要的材料及其應用領域：

材料	能隙 (eV)	主流尺寸	晶體生長方法	磊晶方式	主要特性	主要應用
砷化鎵 (GaAs)	1.43	市場尺寸已擴展至 6 吋，降低成本並提高產能	液封直拉法 (LEC:Liquid Encapsulant Czochralski)或垂直梯度凝固法 (VGF: vertical gradient freeze method)法為主流	同質磊晶	高電子遷移率、優秀光電特性	5G、光通信、射頻元件
磷化銦 (InP)	1.35	市場由 2 吋、3 吋、4 吋逐步擴展至 6 吋	垂直梯度凝固法 (VGF)法為主流	同質磊晶	高頻、高速、低雜訊	5G、光纖通訊、雷射
氮化鎵 (GaN)	3.4	由 6 吋發展至 8 吋	以矽晶圓/碳化矽為基板	異質磊晶 GaN on Si GaN on SiC	高耐壓、高頻、高功率密度	5G 基站、雷達、電源管理
碳化矽 (SiC)	3.26	由 4 吋->6 吋發展至 8 吋	PVT 為主流	同質磊晶	高擊穿場、高熱導率	電動車、工業電源、太陽能
氧化鎵 (Ga ₂ O ₃)	4.8	發展中	發展中	同質磊晶/異質磊晶	超高耐壓、新興材料	下一代功率元件

隨著半導體技術的發展，化合物半導體 (Compound Semiconductor) 與矽基半導體 (Si-based Semiconductor) 的整合成為市場趨勢，因為這能夠同時發揮矽 (Si) 的成熟製程與低成本優勢，以及化合物半導體的高頻率、高功率與光電特性。透過異質整合、先進封裝、外延技術等方式，讓 SiC、GaN、GaAs、InP 等材料發揮高效能優勢，同時降低成本。這些整合技術將大幅提升 5G/6G 通訊、電動車 (EV)、光電、AI 運算、光通訊等領域的應用，推動半導體技術邁向新世代。

2. 產業上、中、下游之關聯性

台灣半導體產業隨著整體半導體的垂直分工整合的趨勢演進，依製造流程可區分為上游之 IC 設計公司 (IC Design) 與半導體晶圓製造公司，由 IC 設計公司依客戶的需求設計出電路圖，半導體晶圓製造公司則以多晶矽及化合物半導體為原料製造出半導體晶圓；中游之 IC 晶圓製造廠 (IC Manufacturing and Foundry) 則依 IC 設計公司設計好之電路圖在半導體晶圓製造公司製造好的晶圓上，以光罩印上電路基本圖樣，再以氧化、擴散、CVD、蝕刻、離子植入等方法，將電路及電路上的元件，在晶圓上製作出來；而完成後之晶圓再送往下游之 IC 封裝、測試廠 (IC Assembly and Testing)，將加工完成的晶圓，經切割過後的晶粒，以塑膠、陶瓷或金屬包覆，保護晶粒以免受污染且易於裝配，並達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果，最後進行 IC 功能、電性與散熱等測試。近年來由於台灣 IC 產業蓬勃發展及分工體系走向專業化，每一個生產環節皆有許多個別廠商投入，垂直分工明確且各有專精，使台灣 IC 產業之上、中、下游結構更加完整。茲將本公司所屬產業之上、中、下游之關聯性圖示如下：



資料來源：工研院電子所 ITIS 計畫

3. 產品及產業各種發展趨勢

半導體產品與總體經濟息息相關，台灣經濟研究院（TIER，台經院）及國際貨幣基金組織（IMF）之最新報告涵蓋以下發展狀況：

A. 全球總體經濟趨勢

全球 GDP 預計將維持穩定成長，惟增速趨於溫和。受產業補貼、貿易關稅及利率政策變動影響，總體經濟仍存在不確定性。通膨回穩的趨勢預計將率先出現在已開發國家，而新興市場則可能面臨較長的復甦期。美國經濟展現韌性，整體成長穩健，勞動市場維持強勁，通膨亦呈現緩步下降趨勢，預期將逐步回歸目標水準。

展望 2025 年與 2026 年，國際貨幣基金組織 IMF 預期全球經濟成長率將維持在 3.3%，仍低於 2000 年至 2019 年的歷史平均 3.8%。美國經濟雖展現韌性，成長穩健，且通膨緩步下降，惟其他主要經濟體的成長預測下調，使 2025 年全球經濟成長預測與 2024 年 10 月時的預測基本持平。通膨方面，IMF 預期 2025 年全球總體通膨率將降至 4.2%，2026 年進一步降至 3.5%，其中已開發國家通膨回穩速度將快於新興市場與發展中經濟體，新興市場與發展中經濟體將面臨較長的調整期。

整體而言，全球經濟前景仍面臨不確定性，近期市場亦呈現分化風險。美國經濟可能因強勁表現而短期內獲得額外成長動能，惟其他國家則受政策不確定性影響，成長動能相對疲弱。此外，產業補貼、貿易關稅及利率政策的變動，亦可能影響央行貨幣政策的調整步伐，進而對財政可持續性與金融穩定帶來挑戰，然而，隨著通膨壓力逐步緩解，主要經濟體政策調整的空間擴大，市場可望在中長期內回歸穩定成長軌道，帶動投資信心回升。

	年成長率		
	估計值	預測值	
(實際 GDP，年成長率變化)	2024	2025	2026
世界產出	3.2	3.3	3.3
發達經濟體	1.7	1.9	1.8
美國	2.8	2.7	2.1
歐元區	0.8	1.0	1.4
日本	-0.2	1.1	0.8
新興市場和發展中經濟體	4.2	4.2	4.3
亞洲新興市場和發展中經濟體	5.2	5.1	5.1
中國	4.8	4.6	4.5
歐洲新興市場和發展中經濟體	3.2	2.2	2.4
中東和中亞	2.4	3.6	3.9

資料來源：國際貨幣基金組織 International Monetary Fund - World Economic Outlook Update (2025/01)

B. 美國總體經濟趨勢

根據美國商務部經濟分析局（BEA）發布的數據，2024 年美國第四季 GDP 年成長率為 2.5%，創 2023 年第二季以來新低。內需方面，同期美國民間消費與民間投資年成長率分別為 3.2%與 1.7%。外需方面，商品與勞務出口與進口年成長率分別為 2.9%與 5.8%。展望 2025 年全年美國 GDP 成長，英國經濟學人資訊中心(EIU)與 S&P Global 分別於 2025 年 2 月發布預測，預估成長率為 2.1%及 2.3%。EIU 指出，由於民間消費與出口需求於第一季提前釋放，加上政策不確定性影響，第二季與第三季經濟動能放緩，因此下調前次預測 0.2 個百分點。相較之下，S&P Global 上調美國 2025 年經濟成長預測 0.3 個百分點，反映年初消費者支出帶動的強勁成長動能。然而，美國經濟仍面臨多重挑戰，包括國債收益率高於預期、借貸成本上升，以及美元走強帶來的壓力，這些因素可能對未來經濟成長帶來不確定性。

有關美國就業市場表現方面，根據美國勞動統計局公布資料，美國於 2025 年 1 月的失業率為 4.0%，較上月下降 0.1 個百分點；此外 1 月非農新增就業人數為 14.3 萬人，較 2024 年 12 月修正後的 30.7 萬人大幅減少。消費與生產方面，受冬季暴風雪及加州野火影響，1 月汽車相關、休閒運動、電子產品及家具等零售銷售年增率明顯放緩，導致 2025 年 1 月美國零售銷售額年增率降至 4.2%，較前值下修 0.2 個百分點。極寒天氣帶動暖氣需求提升，公用事業產量大幅增加，加上電腦及電子產品、木製品、非金屬礦產品及非耐久財製造業年增率皆呈正成長，帶動 1 月工業生產持續擴張，年增率從 2024 年 12 月的 0.3%提升至 2.0%。

至於美國經濟近期的景氣展望方面，根據美國供應管理協會（Institute of Supply Management, ISM）發布的數據，2025 年 1 月美國製造業採購經理人指數（PMI）達 50.9 點，較前月上升 1.7 個百分點，終止連續 9 個月的緊縮，並自 2022 年 10 月以來首次進入擴張區間。1 月新訂單指數、生產指數、就業指數及供應商交貨指數均較 2024 年 12 月上升，顯示經濟需求回溫，產量擴大，且供應鏈維持寬

鬆。此外，2025 年 1 月 ISM 非製造業 PMI 為 52.8 點，較前月下降 1.2 點，惟仍維持連續 7 個月擴張。受惡劣天氣影響，業務表現承壓，使商業活動與新訂單增速放緩。

C. 歐洲總體經濟趨勢

據歐盟統計局（Eurostat）發佈之 2024 年第四季歐元區（EA20）經濟成長率為 0.9%。同期歐元區前四大經濟體的德國、法國、義大利與西班牙的經濟成長率分別為：-0.2%、0.7%、0.5%與 3.5%，2024 年德國整體經濟萎縮 0.2%，為 2023 年出現負成長（-0.3%）以來連續第 2 年衰退。此外，在 2025 年全年度的歐元區 GDP 方面，EIU、S&P Global 於 2025 年 2 月發布預測值分別為 1.1%及 0.9%，前者較前次預測值下修 0.1 個百分點，後者則維持不變。

在就業市場表現方面，歐元區於 2024 年 12 月失業率為 6.3%，較上月修正後數值相比上升 0.1 個百分點，整體失業率續維持穩定。此外，隨著俄烏天然氣過境協議終止的影響，加上德國上調二氧化碳排放稅，令能源成本上升，能源價格指數年增率走高，使得 2025 年 1 月歐元區 CPI 年增率為 2.5%，較上月數值增加 0.1 個百分點，而 1 月歐元區核心 CPI 年增率則為 2.7%，較上月數值維持不變。歐元區 12 月零售銷售年增率由上月修正後的 1.6%上升至 1.9%，受到汽車燃料、非食物類零售銷售年增率上升，使得整體零售消費年增率走高。受到天然氣價格攀升影響，使得金屬製品、化學與製藥業等能源密集相關產業年增率下滑，短期內生產恐難以恢復，令歐元區 12 月工業生產年減幅擴大，由上月修正後年增-1.8%下降至-2.0%。

在歐洲經濟展望方面，參考歐盟委員會公佈的綜合經濟觀察指標（Economic Sentiment Indicator, ESI），歐元區 2025 年 1 月的 ESI 為 95.3 點，較上月數值增加 1.5 點。1 月歐元區 ESI 數據顯示各細項指數表現分化。工業信心指數回升，受生產預期改善與成品庫存評估提升推動，但總訂單與出口訂單評估進一步惡化，對過去生產趨勢的看法則略顯樂觀。服務業信心指數小幅上升，管理者對過去需求的評估改善，但未來需求預期轉弱，部分抵消增幅，業務狀況評價則維持穩定。消費者信心指數持平，經濟前景預期小幅改善，但家庭財務狀況與大額消費意願無明顯變化。

D. 日本總體經濟趨勢

日本內閣府發布 2024 年第四季 GDP 年增率第一次速報值為 1.2%，高於前三季，其中民間消費、企業設備投資、公共投資年增率分別為 1.1%、1.1%及 1.9%，商品及勞務進出口年增率分別為 0.0%及-0.2%，2024 年全年 GDP 年增率 0.1%，較 2023 年數值減少 1.4 個百分點。日本財務省公布 2025 年 1 月進口金額為 10 兆 6,225 億日圓，較 2024 年同期成長 16.7%，主要係電算機及其周邊機械、通信機械等產品進口成長逾 3 成；出口額為 7 兆 8,637 億日圓，年增 7.2%，主要汽車、船舶及醫藥品等出口成長。在 2025 年全年度的日本 GDP 方面，EIU、S&P Global 於 2025 年最新發布預測值分別為 0.9%及 1.1%，兩者皆較上次預測數值增加 0.1 個百分點。

在就業市場方面，依據日本總務省公布 2024 年 12 月經季節調整後失業率為 2.4%，較 11 月數值減少 0.1 個百分點。物價方面，1 月 CPI 年增率為 4.0%，較 2024 年 12 月增加 0.4 個百分點；核心 CPI 年增率為 2.5%，較 2024 年 12 月增加 0.1 個百分點。在工業生產方面，在生產用機械、電子零組件及交通運輸（除汽車外）等生產指數年增率增加的帶動，整體工業生產指數年增率由 11 月的-2.7%縮小至 12 月的-1.1%。

在日本經濟展望方面，參考 S&P Global 引用 au Jibun Bank 發布的日本 1 月製造業 PMI 為 48.7，較 2024 年 12 月數值減少 0.9 點，主要是新訂單為 6 個月以來最大降幅，出口銷售因半導體及汽車需求疲軟而減少，加上製造業前景為近 2 年來的最低水準，致 PMI 出現連續 7 個月惡化情形；服務業 PMI 為 53.0，較 2024 年 12 月數值增加 2.1 點，主要係來自亞洲需求增加，出口成長率為 2024 年 8 月以來新高，加上採購價格因通膨率而上漲，帶動服務類價格漲幅為 2024 年 5 月以來新高，致服務業 PMI 為連續 3 個月維持在榮枯線之上。

E. 中國總體經濟趨勢

中國國家統計局發布，在全國居民消費價格（CPI）方面，2025 年 1 月 CPI 年增率 0.5%，較 2024 年 12 月數值增加 0.4 個百分點，主要係受到春節及氣溫下降等因素影響，包括機票、旅遊等服務價格、豬肉及鮮菜等食品價格較 2024 年同期漲幅較大，核心 CPI 年增率為 0.6%。1 月適逢春節假期，工業生產處於淡季，工業生產者出廠價格年增率為-2.3%，與 2024 年 12 月數值持平，公布 30 個主要業別出廠價格年增率中僅有 6 個產業出現成長，其中有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業漲幅居前二高，分別較 2024 年同期成長 18.9%及 9.3%，主要係近來黃金等貴金屬價格上揚，1 月金飾品價格上漲達 30.0%，帶動有色金屬開採及其加工業出廠價格上揚。在 2025 年全年度中國 GDP 方面，EIU 及 S&P Global 最新發布預測值分別為 4.6%及 4.2%，皆與上次預測值持平。

在商品住宅銷售價格方面，1 月一線城市新建商品住宅、二手住宅銷售價格年增率分別為-3.4%、-5.6%，降幅皆較 2024 年 12 月數值縮小 0.4 及 1.1 個百分點；二線城市新建商品住宅、二手住宅銷售價格年增率分別為-5.0%、-7.6%，降幅皆較 2024 年 12 月數值縮小 0.4 及 0.3 個百分點，顯示出中國大中城市住宅價格年增率衰退情形持續改善中。

在中國經濟展望方面，依據中國國家統計局公布 1 月製造業 PMI 為 49.1%，較 2024 年 12 月數值減少 1.0 個百分點，其中除從業人數指數與上月數值持平外，其餘指標皆較上月數值下滑，致製造業活動跌至榮枯線之下。非製造業活動指數為 50.2%，較 2024 年 12 月數值減少 2.0 個百分點，主要係建築業及服務業市場需求減弱，新訂單、業務活動預期及投入品價格等指標皆較上月數值減少所致。

F. 台灣總體經濟趨勢

首先在對外貿易方面，人工智慧等新興科技需求仍強，提前拉貨效應致出口年增率仍維持正成長，1 月出口年增率由上月的 9.2%下降至 4.4%。在主要出口產

品方面，人工智慧及高效能運算等商機熱度延續，提前拉貨明顯，致資通訊與視聽產品年增率較上月走高，電子零組件則在工作天數減少情況下維持正成長。傳產貨類因出口需求平疲，搭配春節工作天數減少，化學品、金屬及其製品、機械、塑膠及橡膠製品年增率均呈現由正轉負；進口方面，因傳產出口仍平疲，弱化相應原物料需求，加以傳產貨類受春節工作天數減少影響明顯，1月整體進口年增率由正轉負，由上月30.4%下降至-17.2%，進口終止連10個月正成長態勢。總計2025年1月出超金額為99.7億美元，成長317.9%。

物價方面，部分個人照顧服務、娛樂費用、機票和計程車資價格，受春節月份落點不同影響，價格相對上揚，導致教養娛樂類與雜項類價格年增率明顯提升。整體CPI年增率由上月2.11%擴大至2.66%，核心CPI年增率亦由上月1.65%擴大至2.26%；PPI方面，受製造業部分商品及水電燃氣等價格上漲帶動，PPI年增率小幅上升，惟農產品價格下跌，抵銷部分漲幅，致使2025年1月整體PPI續呈上揚態勢，升至3.87%。

在勞動市場薪資方面，2024年12月本國籍全時受僱員工總薪資為64,872元，較2023年同月成長7.01%，12月經常性薪資為49,695元，較2023年同月成長3.56%，在扣除物價上漲因素後，2024年實質經常性薪資為45,506元，年增0.75%，2024年實質總薪資為59,983元，年增2.55%。

在國內金融市場方面，市場資金環境穩定，2025年1月金融業隔夜拆款利率最高為0.827%，最低為0.810%，加權平均利率為0.820%，與上月持平，較2024年同月增加0.133個百分點。股市方面，美國消費性電子展帶動AI類股上漲，加以台積電資本支出超過市場預期，為台股提供支撐，然美債殖利率攀升與川普關稅傳聞引發通膨疑慮，令台股漲幅收斂，台灣加權指數1月封關前收在23,525.41點，上漲2.13%，平均日成交量為3,533.85億元。匯率方面，受美國經濟數據影響，新台幣呈震盪走勢。上半月因美國降息預期縮減推升美元走強，短線新台幣突破33元關卡，但隨後美國通膨數據低於金融市場預期，美元轉弱，新台幣隨之回升，1月封關前匯率收在32.682美元，升值0.30%。

4. 產業競爭情形

半導體晶圓產業因資本與技術高度密集，對於其他競爭者而言有相當難度之進入門檻，本公司為全球第三大晶圓供應商，營運已達經濟規模，產品製程技術亦取得國際大廠之信賴及品質認證。藉由整合全球各地子公司的技術及產能，環球晶圓能夠彈性調度，以滿足客戶對於優質產品及各種交期的需求，同時也能較靈活因應各國政策。雖總體經濟受通膨及消費者信心水準下降影響，消費型產品需求疲軟，致小尺寸產品拉貨力道放緩、墊高庫存水位，然隨著下游廠商導入許多措施，庫存已逐漸去化；大尺寸及特殊晶圓因AI及先進製程而持續熱絡；化合物半導體市場因電動車增速放緩及中國競爭者迅速增加而較有挑戰，預期淨零碳排及電網更新等趨勢有機會開展化合物半導體新的應用領域。

(三)技術及研發概況

本公司成立以來致力於矽晶圓材料長晶及精密加工製程之改善，亦透過與學術及研究機構之交流與合作，快速提升新技術與新產品之開發能量。歷經多年投入「單晶矽晶體成長技術及晶圓精密加工技術」與「矽磊晶沈積技術及 SOI 晶圓接合技術」之開發，不管在單晶生產力的提高、晶體阻值的降低、晶體缺陷密度的控制、晶體品質的提高、氫氣用量的減少、晶圓平坦度提升、原子級拋光晶圓表面處理技術、同質/異質磊晶技術、同質/異質晶圓接合技術、晶圓強度提升厚度下降、用電量之減少、耗水量降低、物料用量的降低、廢棄物排放減量…等皆已達到或超越國際指標，多項技術指標更成為國際上的標竿。透過集團的整合與資源共享，在製程技術發展、新產品技術研發、以及客戶認證評估上達成許多重要的指標。我們不只通過了世界頂尖客戶在尖端製程的評估，更榮獲許多重要客戶頒發最佳供應商，客戶的肯定顯示了環球晶圓在研發技術上的成功。在新產品開發方面則達到前所未有的里程碑，例如高功率元件 IC 上使用的 12 吋重摻超低阻半導體、應用於通訊 4G 及 5G 通訊上使用之 RFSOI、次世代寬能隙材料 GaN on silicon 及 SiC 晶圓等。除此之外，環球晶圓也積極進行專利佈局以保護公司的智慧財產權，截至 2024 年 12 月 31 日，集團有效專利申請量已達到 2,558 件(包含 1,621 件已經獲證及 937 件申請中)。

環球晶圓從 2014 年開始進行 2” N-Type SiC 長晶研發，於 2016 年完成 4” N-Type SiC 晶體開發，2018 年成功執行了 4” SI-SiC 長晶，2018 年及 2019 年亦發展 6” N-Type SiC 基板的加工技術，在 2021 年國際光電展環球晶圓展出 6” SI-SiC 晶體、晶錠及晶片之研發成果，也同步於 2021 年完成第一代(Gen1)自製的 SiC PVT 長晶爐開發；2022 年，成功從自製第一代(Gen1) SiC PVT 長晶爐生長出 6” N-Type SiC，除了長晶技術外，環球晶圓亦有成熟且精湛的 SiC 晶片加工技術，包含 4” /6” N-Type SiC、4” /6” SI-SiC 以及 6” Ultra-Thin (90um) N-Type SiC，環球晶圓在碳化矽領域擁有非常優異的生產製造技術，並且已獲得多家 Tier1 國際大廠客戶的訂單。環球晶圓更於 2023 年 4 月利用第二代(Gen2)自製長晶爐成功開發出高品質低缺陷 8” N-Type 碳化矽晶體及晶錠，並於 2023 年 10 月國際光電展環球晶圓展出 8” N-Type 碳化矽晶體、晶錠及晶片之研發成果。2024 年開發出均勻且整錠低缺陷密度之 8 吋碳化矽晶體，近期也積極布局 12 吋 N-Type 碳化矽晶體生長與其拋光片，以因應世界趨勢潮流。環球晶圓之第三類化合物半導體於國際中佔有舉足輕重的地位，這些研發成果將促使我們於半導體業界更進步並且成為領先群倫的世界級半導體晶圓供應商。

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目/年度	112 年度	113 年度
研發費用	2,364,071	2,317,220
營業收入淨額	70,651,593	62,626,004
研發費用占營收淨額之比例(%)	3.35	3.70

2. 最近年度開發成功之技術或產品

年度	技術或產品名稱
112	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 吋薄型晶圓 2. 8 吋高電阻退火晶圓 3. 人工智慧應用於矽晶棒長晶生長控制 4. 低損傷碳化矽晶圓切片技術開發 5. 長晶爐節能磁場裝置開發 6. 預測模型技術應用於碳化矽晶圓加工 7. 12 吋超低電阻重摻砷晶體生長技術 8. 氯化鎳低磊晶應力製程開發 9. 8 吋 N-Type 碳化矽晶體生長爐
113	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 3 代 PVT 碳化矽長晶爐 2. 低損耗碳化矽晶圓切割技術開發 3. 矽長晶斷線自動辨識系統開發 4. 矽長晶自動摻雜裝置開發 5. 高效節能冰水冷卻系統開發 6. 低材料損耗研磨製程開發 7. 第 3 代低能耗長晶熱場開發 8. 運用於 2 奈米製程用矽晶圓超高潔淨清洗技術開發

(四)長、短期業務發展計畫

1. 長期計畫

- A. 運用集團尖端之領先技術開發符合次世代產品運用之 GaN/Si/SiC 晶片，朝向大尺寸重摻長晶及功率半導體磊晶技術發展，成為全球規模最大且產品完整性最高的半導體晶圓供應商。
- B. 因應客戶未來需求，持續開發下一代長晶及拋光技術，持續保持在先進製程領先的地位。
- C. 建立集團內跨部門合作，整合 LNO，SOI，SiC，Si，Solar-Si 等資源切入 2D/2.5D/3D 封裝及矽光子與異質整合所需要之特用晶體與晶圓。
- D. 落實綠色製造、實踐企業社會責任、完備公司治理，建構永續經營基礎。
- E. 藉由採用再生能源、提升能源使用效率、碳清除與購買碳補償商品，達到 2050 年前 100%使用潔淨能源，並配合遍布全球的生產營運據點，建構具有韌性及彈性的在地供應鏈，建立多元供應商，敏捷因應疫情及地緣政治緊張情勢，並降低環境衝擊，提供客戶碳哩程較短的低碳晶圓。
- F. 透過擴產以增加營運規模，同時緊密掌握產業動向、積極爭取政府補助，提升在半導體晶圓產業的競爭力。
- G. 與重要合作夥伴積極簽訂長期合作計畫以鞏固合作基礎。

2. 短期計畫

- A. 加強與下游客戶的研發連結，以核心技術能力開發高效率之利基產品，並積極降低製造成本，以增加獲利空間。
- B. 加速提昇 12 吋矽晶圓、化合物半導體及特殊晶圓(FZ, SOI)生產效能，提高全球市佔率。
- C. 結合集團內技術、資源與各種可能性，優化各廠區瓶頸站點並極大化產品產能，深化跨國技術整合平臺，全面提升技術能力、產品品質及客戶滿意度，以滿足市場需求。
- D. 穩定關鍵原料與零件供應來源，確保良好生產品質與準時達交，使生產線順暢運行。
- E. 運用現有客戶網絡，擴大新產品的客戶基礎，提高產線的產能利用率，提升產品的獲利能力。
- F. 廣泛產官學合作，佈局利基型應用先進製程，快速提升新技術之開發能量。
- G. 密切掌握市場趨勢及產業脈動並適時調整經營策略，持續研發高附加價值產品並進行專利保護措施，以強化自身的企業競爭力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

地區別		112 年度		113 年度	
		銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內銷		13,879,750	19.7%	12,862,361	20.5%
外銷	亞洲	33,019,460	46.7%	26,845,305	42.9%
	美洲	8,915,007	12.6%	8,364,285	13.4%
	歐洲	14,406,732	20.4%	14,324,330	22.9%
	其他	430,644	0.6%	229,723	0.3%
合計		70,651,593	100.00%	62,626,004	100.00%

2. 市場佔有率

依據同業公布財報數字推估，本公司之出貨佔世界半導體晶圓製造商之 15~20%，排名第三；半導體晶圓產業有集中化及整合之趨勢，前五大廠商合計市佔率超過 90%，而前五大排名分別為日本信越(Shin-Etsu)、日本 Sumco、環球晶圓 GWC、德國 Siltronic AG、及韓國 SK Siltron，本公司於世界排名第三，營運穩定成長，期能在完整產品布局規畫下持續開拓市場並逐步提升市佔率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

根據國際半導體產業協會 (SEMI) 最新發布的全球晶圓廠預測報告 (World Fab Forecast, WFF)，受惠於高效能運算 (HPC) 應用中的前端邏輯技術發展，以及邊緣設

備中生成式 AI 的滲透率提升，全球半導體產能正穩步成長，預計至 2025 年，全球晶圓月產能將達 3,360 萬片（wpm,wafers per month），年均成長率約 6.6%。為應對大語言模型（LLM）持續增長的運算需求，晶片大廠積極擴增 7 奈米及以下先進製程產能，該領域年成長率將達 16%，至 2025 年每月產能將增加 30 萬片，達 220 萬片。

晶圓代工產業仍是半導體設備採購的主要推動力，預計 2025 年產能將年增 10.9%，從 2024 年月產 1,130 萬片提升至 2025 年月產 1,260 萬片，再創歷史新高。記憶體產業則相對穩健，2024 年與 2025 年分別成長 3.5%與 2.9%，但受生成式 AI 強勁需求驅動，記憶體市場仍發生重大變化。其中，高頻寬記憶體（HBM）成長迅速，帶動 DRAM 與 NAND 快閃記憶體的產能提升。SEMI 預計至 2025 年，DRAM 月產能將達 450 萬片，同比增長 7%，而 3D NAND 產能則達 370 萬片，增幅約 5%。

SEMI 指出，半導體產業正處於關鍵發展時期，擴產投資將推動先進與主流技術的發展，以滿足全球產業不斷演進的需求。生成式 AI 與高效能運算正加速先進邏輯與記憶體技術的進步，而主流製程則持續支撐車用電子、物聯網（IoT）及功率元件等應用領域。

此外，本公司擁有廣泛的客戶基礎，終端產品涵蓋車用、電源管理、記憶體等多元應用，能夠有效分散市場波動風險。隨著終端市場需求持續成長，以及不斷推陳出新的產品推升對高品質半導體晶圓的需求，本公司營運將持續保持穩健發展，並持續為產業提供優質解決方案。

4. 競爭利基

A. 產業經驗豐富之經營及技術研發團隊

本公司自成立以來，持續投入先進半導體晶圓領域相關之技術開發與研究，主要研發人員及經營階層於半導體產業皆有多年以上之工作經驗，累積相關豐富之經驗，洞悉半導體產業趨勢，並對市場需求充分掌握，使得本公司能夠配合客戶需求適時開發關鍵技術，有助於客戶訂單之爭取。

B. 擁有先進製程技術

本公司致力於矽晶圓材料長晶及精密加工製程之改善，亦透過與學術及研究機構之交流與合作，快速提升新技術與新產品之開發能量。歷經多年投入「單晶矽晶體成長技術及晶圓精密加工技術」與「矽磊晶沈積技術及 SOI 晶圓接合技術」之開發，不管在單晶生產力的提高、晶體阻值的降低、晶體缺陷密度的控制、晶體品質的提高、氫氣用量的減少、晶圓平坦度提升、原子級拋光晶圓表面處理技術、同質/異質磊晶技術、同質/異質晶圓接合技術、晶圓強度提升厚度下降、電用量之減少、耗水量降低、物料用量的降低、廢棄物排放減量…等皆已達到或超越國際指標，多項技術指標更成為國際上的標竿。

本公司多年來投入化合物半導體產品開發，具備碳化矽長晶爐自製與熱場設計能力，透過長晶設備與長晶製程的整合達成在晶體品質與競爭者相比具差異化。而碳化矽晶圓加工技術在矽晶圓的技術基礎上開發出比傳統碳化矽晶圓製造商更具競爭力的製程。同時透過技術整合並搭配集團碳化矽磊晶的垂直整合，通過 Tier 1

的客戶認證量產出貨。在全製程技術整合與客戶深度合作下提供客製化產品使碳化矽晶圓品質成為業界的標竿。而氮化鎵磊晶片在差異化的策略上，在技術長期累積與客戶策略合作下，提供客製化氮化鎵磊晶片成為客戶主要供應商。

除此之外，環球晶圓也積極進行專利佈局以保護公司的智慧財產權，截至 2024 年 12 月 31 日，集團有效專利申請量已達到 2,558 件（包含 1,621 件已經獲證及 937 件申請中），研發成果亮麗並獲得國際客戶的肯定。

C. 具規模產能、產能調度彈性及規模經濟競爭能力

本公司自成立以來，專注於半導體晶圓領域相關之技術與生產研發，生產基地橫跨美洲、歐洲及亞洲，總計擁有 18 處營運生產基地坐落於全球 9 個國家，其產能已達經濟規模。而工程師與生產線人員在製程與操作技術成熟，加上本公司有效管理製程且分散式之多樣化經營策略，使得生產效率大幅提升，單位成本亦相對降低。

D. 與客戶建立長期緊密夥伴關係

本公司提供核心技術產品全程製造之完整服務予客戶，在精密加工技術、產品品質及交期服務均能滿足客戶的需求，故本公司目前已獲得多家國內外半導體大廠之認證肯定，而半導體大廠基於技術保密、品質及共事默契考量，傾向與供應商維繫長久合作，顯示本公司與客戶已建立長期緊密夥伴關係。此外，本公司除繼續與現有客戶維持良好關係，未來將利用先進製程技術之基礎，致力於開發新客戶，有助於本公司未來的營運發展。

E. 產品多元化

本公司為專業之半導體晶圓製造商，具拉晶、切片、研磨、拋光、清洗與磊晶全製程之 3 吋~12 吋矽晶圓產品線，產品光譜廣泛，橫跨磊晶片、拋光片、退火片、擴散片、SOI、FZ 晶圓...等，另外更跨足 SiC、GaN 等化合物半導體。且本公司依不同的客戶需求，提供客戶一套完整的解決方案與客製化的服務，由於產品品質穩定、效能佳、產品線完整及快速的研發設計彈性，使本公司在市場上持續保有領先競爭優勢。

F. 穩健之財務結構

大者恆大為半導體業未來發展趨勢之一，本公司擁有充足之現金流及健全資產負債結構，能夠確保本公司持續穩健投資及發展，亦為半導體產業不景氣時，維持營運穩定度之關鍵，因此穩健財務結構為本公司與客戶長期合作與共同成長之重要基礎，亦為本公司競爭利基之一。

G. 高度區域化的全球營運據點

本公司 18 處營運生產基地坐落於全球 9 個國家，待美國新廠完成後，在美洲、亞洲及歐洲將擁有長晶到磊晶的一貫製程，對客戶而言是當地的本土供應商，能就

近滿足需求，在地供應可減輕地緣政治及總體經濟的變動影響。

H. 綠色永續

本公司遍布全球的營運據點可以有效降低長途運輸的環境成本，同時降低被各國徵收碳關稅的可能性。另外，本公司於 2021 年即自主宣布全集團將於 2050 年實踐 100% 使用再生能源的目標。並於 2022 年正式加入 RE100 倡議組織，在能源藍圖方面，藉由自建太陽能發電案場，簽訂購電協議（Power Purchase Agreement; PPA）與購買再生能源憑證（Renewable Energy Certificates; RECs），母公司中美矽晶作為綠色能源全方位供應商（Green Energy Total Solution Provider），利用其豐富經驗與垂直整合供應鏈優勢、協助集團興建太陽能電廠以增加綠色能源發電量。新蓋的廠區在興建時期便導入各項節能設備及方案以降低能耗、並積極使用再生能源，建構綠色永續的獨特優勢。

5. 發展遠景之有利與不利因素

A. 有利因素

(a) 資本及技術密集度高，進入門檻較高

半導體產業是資本與技術密集的工業，由於半導體產業所需之生產機台昂貴、IDM 委外代工訂單趨增及產品技術變化快速，需要投入之資本支出越發龐大。另半導體之技術密集度高，其製程技術與產品產出良率決定生產成本高低，而研發人才與製程技術具有密切關係，但研發專業人才培養及延攬不易，加上產品需經過客戶認證後方能取得訂單，造成新競爭者有較高之進入門檻。本公司擁有優秀技術研發團隊，在產業深耕多年，實務經驗豐富，充份掌握半導體晶圓趨勢與需求，且本集團已達經濟規模，產品製程技術亦取得國際大廠之信賴及品質認證，顯示本集團具有市場競爭力。

(b) 半導體市場新技術串連各式應用，優質半導體晶圓需求增高

由智慧家電、穿戴式裝置與智慧城市所形成的物聯網技術持續發展，成為驅動半導體營收的一大動力，而 5G 也將啟動新型態行動網路世界、改變無線通訊的面貌。5G、AI、IoT 等新技術發展將串連原本各自為政的消費性電子、行動裝置、網路通訊設備及電腦應用等個別市場，創新科技所奠基於先進製程，而先進製程需要品質更佳、規格更高的半導體晶圓做為關鍵的基板材料，尤其以 8 吋、12 吋矽晶圓及化合物半導體需求更為顯著，因此全球矽晶圓材料之需求將維持不輟。

(c) 產品發展符合市場需求

由於目前前五大半導體晶圓製造商以記憶體等標準應用為主，競爭激烈且擠壓獲利空間，而本集團不僅可提供客戶 3~12 吋全系列矽晶圓產品及全製程（拉晶、切片、研磨、拋光、清洗、退火、磊晶等），以及特殊晶圓、化合物半

導體之服務，並聚焦於利基型市場。本公司獲利結構穩健，且積極佈局先進製程應用，與半導體產業未來發展趨勢相符，產品線完整，故未來仍具有成長空間。

(d) 遍布全球的生產營運據點，建構具有韌性及彈性的在地供應鏈

本公司 18 處營運生產基地坐落於全球 9 個國家，在美洲、亞洲及歐洲擁有長晶到磊晶的一貫製程，能就近滿足客戶需求，在地供應可減輕地緣政治及總體經濟的變動影響，並降低環境衝擊，提供客戶碳哩程較短的綠色晶圓。

B. 不利因素及因應對策

(a) 半導體產業之景氣波動

本公司為半導體晶圓之專業生產廠商，屬半導體產業鏈之上游，主要客戶除半導體製造廠、晶圓代工廠外，亦包含整合元件製造商及車用電子廠商等，由於晶圓係製造半導體元件不可或缺的關鍵基礎材料，因此公司營運狀況與半導體產業景氣息息相關。

因應對策：

本公司為全球第三大半導體晶圓廠，產品線涵蓋 3 吋至 12 吋，具有相當的經濟規模與市場地位，終端產品應用領域廣泛，且本公司及子公司技術人才均已在半導體產業浸淫多年，技術實力堅強，可藉由核心技術的運用，搭配本身技術整合及開發能力，提供完整且符合市場與客戶需求之多元化產品，並與現有客戶建立長期穩定之夥伴關係，使產能獲得充分而穩定之利用，降低景氣循環的風險。再者，本公司生產基地橫跨歐洲、美洲及亞洲等地，除可藉由採購、銷售集中化，降低營運成本外，並可充分利用各生產基地的優勢，靈活調度生產排程，因應來自市場波動的不利因素。

我們亦與許多客戶簽定長期合作合約，以確保公司訂單不因景氣波動而受到影響。環球晶圓與客戶是長期合作夥伴，為了鞏固產能以因應未來的創新科技需求，客戶藉由簽定長約藉以鞏固料源，同時也助於環球晶圓穩定生產。

(b) 國際情勢變化

近年來國際情勢變化劇烈，地區性貿易衝突、俄烏戰爭、以巴戰爭與南海的潛在衝突對總體經濟帶來不小震盪。

因應對策：

本公司在全球各地皆設有生產據點，將彈性調度生產以因應相關法規，將降低貿易關稅對營運成本之影響；遍佈全球各區域的客戶也能有效分散地域性事件對營收帶來的衝擊，降低單一地區的經濟風險。

(c) 關鍵原料短缺風險

隨著半導體產業蓬勃發展，對晶圓的需求急速增加，運輸系統亦受國際衝突情勢影響，供應商若無法適時配合或出貨受阻，將造成原料短缺導致無法生產之情形。

因應對策：

本公司之主要原料-多晶矽，係向世界知名大廠採購，並且簽訂供貨合約，以確保供料品質穩定及供應量充足。另外，避免過度仰賴單一供應商的斷鏈風險，本公司為關鍵原物料建立複數供應商，供應鏈管理部門時時注意最新情勢、機動安排運輸路線。本公司並邀請供應商加入永續行列、生產低碳綠色產品，以避免缺料、生產中斷也更可符合客戶及各國對於低碳排的標準。

(d) 匯率風險

本公司目前在歐洲、美洲及亞洲均有生產據點，人工、水電等製造費用均係以當地幣別支付，而在銷售端則除了部份當地客戶係以當地幣別計價外，其餘客戶多為美金計價，因此美金對上述貨幣匯率大幅波動時，亦將影響本公司營運成本。

因應對策：

由於外部經濟及匯率變化情勢複雜，本公司以採負債及資產部位互抵之自然避險為原則，盡量降低曝露於匯率波動風險下之淨部位，並由財務單位密切觀察匯率之走勢，必要時搭配以避險為目的之外匯操作工具，降低匯率波動對營運成本之影響。

(e) 競爭者加入

近年陸續有半導體晶圓廠加入競爭，加上中國積極扶植其國內半導體產業，市場競爭越形激烈。

因應對策：

半導體產業是資本與技術高度密集的工業，由於所需之生產機台昂貴且產品技術變化快速，資本支出越發龐大，研發專業人才培養及延攬更是不易，加以產品需經過客戶認證後方能取得訂單，故進入門檻極高。本公司擁有優秀技術研發團隊，在產業深耕多年，充份掌握半導體晶圓趨勢與需求，產能也已在全球供應商中名列前茅，產品製程技術亦取得國際大廠之信賴及品質認證，相較新加入之競爭者具有相當的競爭優勢，本公司將持續強化其競爭利基，以保持領先地位。

(f) 氣候變遷

極端氣候出現的頻率日益增加，帶來能源短缺隱憂，恐影響生產。

因應對策：

本公司深刻了解氣候變遷對於營運環境的衝擊和限制，在制定營運決策時便評估風險範疇，並納入考量，迅速實施緊急應變計畫以對抗氣候衝擊、避免生產中斷，更持續穩定供應全球客戶。本公司致力於優化現有設備，同時也導入各項節能措施，以對環境更友善的方式生產。另外，本公司擁有數座太陽能電廠，各國子公司亦配合當地能源政策採用綠色能源，致力提升綠色電力的占比。

(g) ESG 及碳關稅

因應氣候變遷、各國紛紛制定不同的碳關稅、以遏止企業在生產過程中的碳排放，許多客戶也要求供應商承諾加入永續供應鏈，企業除了生產成本因而增加，產品的製造過程也必須符合低碳排的要求。

因應對策：

本公司擁有 9 國 18 個生產營運據點，高度區域化的特點讓環球晶圓被三大洲的客戶都視為本土供應商，就近供應可以大幅減少產品的碳哩程，同時降低被各國徵收碳關稅的可能性。另外，本公司於 2021 年即自主宣布全集團將於 2050 年實踐 100% 使用再生能源的目標，並於 2022 年正式加入 RE100 倡議組織，在能源藍圖方面，藉由自建太陽能發電案場，簽訂購電協議(Power Purchase Agreement; PPA)與購買再生能源憑證(Renewable Energy Certificates; RECs)，母公司中美矽晶作為綠色能源全方位供應商(Green Energy Total Solution Provider)，利用其豐富經驗與垂直整合供應鏈優勢、協助集團興建太陽能電廠以增加綠色能源發電量。新蓋的廠區在興建時期便導入各項節能設備及方案以降低能耗、並積極使用再生能源，本公司火以永續和高度區域化的獨特優勢成為客戶的長期夥伴。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品重要用途

產品名稱	重要用途說明
半導體晶圓	為半導體元件之最主要材料，經過不同製程如拋光、擴散、曝光、蝕刻等，以及後段如：組裝、測試等方式成為分離式元件、積體電路及光電元件所需之材料。運用於二極體、整流器、電晶體、TVS、閘流體、MOSFET 等半導體分離式元件、MEMS、Power Device (功率半導體)及消費性 IC、LOGIC IC 等積體電路及光電元件。

2.產製過程：

晶圓製程

矽原料/化合物半導體原料→長晶→切斷→圓磨→切片→粗晶片清洗→熱處理
→圓邊→研磨→平晶片清洗→檢驗→成品包裝

拋光製程

晶片研磨→浸蝕→拋光前檢驗→晶片拋光→預清洗→檢驗→最終清洗→晶片
表面掃瞄→檢驗→晶片包裝

(三)主要原料之供應狀況

產品項目	主要原料	主要供應商	供應狀況
半導體晶圓	矽原料	d 公司	良好

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	d 公司	2,698,486	16.3%	無	d 公司	2,495,771	14.4%	無
2	g 公司	1,496,021	9.1%	母公司	g 公司	1,760,498	10.1%	母公司
	其他	12,318,950	74.6%		其他	13,120,926	75.5%	
	進貨淨額	16,513,457	100.0%		進貨淨額	17,377,195	100.0%	

增減變動說明：

本公司及子公司主要從事半導體材料之製造及銷售等業務，其主要原料為矽，兩期供應商排名並無重大變化。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	C 公司	11,205,438	15.9%	無	C 公司	8,160,987	13.0%	無
2	K 公司	6,590,135	9.3%	無	K 公司	6,713,028	10.7%	無
	其他	52,856,020	74.8%		其他	47,751,989	76.3%	
	銷貨淨額	70,651,593	100.0%		銷貨淨額	62,626,004	100.0%	

增減變動說明：

本公司及子公司主要從事半導體材料之製造及銷售等業務，其產品主要為半導體晶棒及客製化之半導體晶圓，其主要客戶多為半導體元件大廠，最近兩年度之主要銷售客戶排名並無重大變化。

三、從業員工資訊

年度		112 年度	113 年度	114 年 3 月 31 日
員工人數	直接	4,388	4,222	4,206
	間接	2,917	2,976	2,995
	合計	7,305	7,198	7,201
平均年齡		41.72	42.81	42.17
平均服務年資(年)		13.39	14.32	14.14
學歷分布比率 (%)	博士	1.04%	1.072%	1.06%
	碩士	7.68%	8.392%	8.60%
	大專	22.60%	27.842%	30.90%
	高中(含以下)	68.68%	62.694%	59.45%

四、環保支出資訊

1. 最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

處分日期	裁處書字號	裁罰金額	裁罰廠址	違反情事	改善措施
113 年 5 月 22 日	20-113-050003	NT\$100,000	環球晶圓 中德分公 司	違反空氣汙染 防制法第 24 條 第 2 項規定，緊 急應變管線有 讀值	矯正措施： 經實際確認後，A003 緊急應變管線已不再 使用，即將該風門盲 塞，並卸除風管。 預防措施： 廠務空污專責人員確 認所有排放管道如有 緊急應變管線經確 認後已不再使用將立 即拆除。

2. 本公司除落實既有設備的日常維護與優化管理外，亦持續投入資源提升廢水與廢氣處理等環保防治設備之處理效能，以降低對環境的影響，同時也不斷探索更佳的節能及廢棄物再利用及處理方式，期望在兼顧生產效率與環境保護的前提下，實現更具永續性的經營目標，為綠色未來貢獻一己之力。本公司環保支出及效益相關資訊請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.7 環保支出」。

五、勞資關係

- (一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施

- (1) 提供優質的薪資待遇及公平公正的獎勵辦法、晉升辦法以肯定所有同仁對公司的貢獻與付出。本公司員工除享有勞保、健保、團保、退休金給付等一般福利外，由公司提供之福利包括發給年節獎金、生日及節慶禮金、舉辦年終晚會、婚喪喜慶、國內外旅遊、急難救助、獎學金補助、生育補助、提供團膳、及提供完整之教育訓練講習等。自 110 年起，亦增加員工福利儲蓄信託，員工可自行評估加入與否，參與者則依照個人提撥金額給予 100% 的獎勵金。
- (2) 以每月營業額 0.07% 及出售下腳收入 40% 提撥至職工福利委員會，職工福利委員會由委員依相關法規運作。
- (3) 本公司充分體認所有員工健康攸關工作效率與士氣，期望藉由對員工的關懷，創造安心工作的環境。自 109 年起，建置員工關懷方案 (Employee Caring Program)，透過組成跨部門的小組，制訂整體規劃，以規劃工作、健康、生活、福利四個面向的子方案提供員工，提升整體員工福利。

2. 員工進修及訓練

本公司提供多元化訓練課程、各項專業在職教育訓練及自我成長課程，其中包括新進人員訓練、智財課程、在職訓練課程、勞工安全衛生教育訓練、專業課程以及各種與職務有關之外派訓練課程，以培養富有專業能力並兼具挑戰性之人才。

3. 退休制度與實施情形

- (1) 同仁退休分為：自願退休及強制退休兩種。

自願退休：工作 15 年以上年滿 55 歲者、工作 25 年以上者或工作 10 年以上年滿 60 歲者。

強制退休：民國 97 年 5 月 14 日起年滿 65 歲者或身心障礙不堪勝任工作者，公司得強制其退休。

- (2) 年資計算：自到職日起算：除服役外，留職停薪期間之年資應予扣除。

- (3) 退休金給付標準：

舊制：按服務年資每滿一年給與兩個基數。超過 15 年之服務年資，每滿一年給與一個基數，但最高以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。凡強制退休之勞工，如身心障礙係因執行職務所致者，則其退休金基數依前款規定加給百分之二十。

新制：民國九十四年七月以後選擇新制者，民國九十四年七月以前年資以舊制計算，民國九十四年七月後年資以新制計算。

- (4) 民國九十四年七月以後到職者依新制計算（雇主每月提撥薪資 6% 存至勞保局之個人戶頭）。

4. 工作環境與員工人身安全之保護措施

本公司依職業安全衛生法成立「安全衛生管理單位」，設置職業安全衛生業務管理人員，並制定「職業安全衛生管理準則」，有關廠區工作環境與員工人身安全健康防護主要內容概述如下：

(1)工作環境規定與措施

- 工作人員應隨時注意自我身心健康調適，養成良好衛生習慣。
- 工作場所應適時整理整頓，經常保持整齊清潔。
- 廠內工作嚴禁抽煙、吃檳榔與飲用酒精性飲料。
- 吸煙應在規定之吸煙室內且不得隨意丟棄煙蒂。
- 處置危害物時應正確使用相關防護具。
- 危害物應確實標示並不得任意毀損。
- 工作場所內適當處所應設置符合飲用水標準之飲水設備，定期清洗並進行水質檢測。
- 每年進行全廠區之消毒工作。
- 廁所應保持良好通風，並清洗消毒。
- 全體員工必保持廠區 6S 環境整潔衛生，養成良好習慣。
- 不隨地吐痰、便溺、不亂丟煙蒂，不隨地亂丟垃圾。

(2)員工人身安全之保護

- 從事各項工作均應遵循有關安全標準、作業程序書及工作程序安全檢核表施作及檢核。
- 臨時性或非經常性作業無該類安全標準可依循者，不可貿然著手，應活用既有安全作業標準再與工作負責人會商討論後決定應採行之安全步驟及方法。
- 從事高度二公尺以上之高架作業或作業中有物體飛落或飛散等及現檢點、督導人員均應確實戴用安全帽並繫妥帽帶。
- 在未設平台及護欄且高度離地二公尺以上之管、塔、架上或工作場所邊緣及開口部分作業時，應正確使用安全帶及輔助繩或安全繩索。
- 變電設備或廠區實施部分停電作業時，應將該停電作業範圍以鐵網或施工警示帶等予以加圍、隔離，分別懸掛「停電作業」或「有電危險」之標示，以茲警示。作業完成後應先確認從事作業之員工已離開且無感電之虞，始得拆除。
- 工作時應依各站規定穿戴個人防護器具，若發現有不安全狀況、設備和作業方式，應立即報告。
- 工作中禁止追逐、戲謔或其他不安全行為。
- 機具使用不得超過最高使用負荷。

5.勞資協調之情形

本公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，並依勞資會議實施辦法，定期舉辦勞資會議。勞資關係一向相當和諧，溝通管道暢通，同時透過勞資會議及職工福利委員會共同討論，協商勞資雙方互利互惠等事宜，除了進一步了解彼此的需求與期待外，本公司所有同仁更本著共存共榮之經營理念，共同努力創造公司未來。

6.各項員工權益維護措施

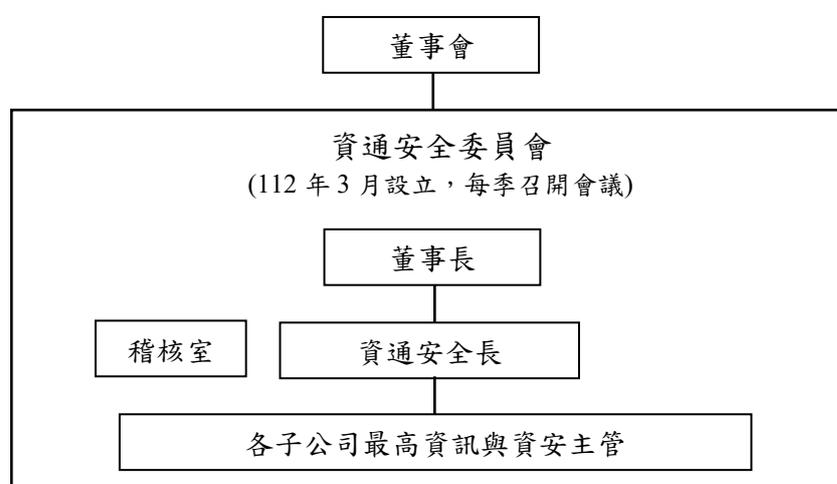
本公司訂有完善的管理制度，載明各項管理辦法，內容明訂同仁權利義務及福利項目，並不定期檢討修訂福利內容，以維護所有同仁權益。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：本公司勞資關係和諧，勞資爭議亦依照調解程序調解，最近年度及截至年報刊印日止，無因勞資糾紛所遭受之損失，亦無違反勞動法令而受罰鍰，並由法令遵循單位協助公司規章之制定與執行以符合勞動法令。

六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

資通安全組織架構



本公司於111年3月1日成立資通安全處，並於翌年召集集團各子公司資訊或資安最高主管設立資通安全委員會，透過每季召開資通安全委員會會議，海內外公司一同審核、交流資安風險與分析對應防護措施與策略，以統籌資通安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循。同時，為了積極推動資通安全政策，各子公司設立資通安全推動小組，由公司內部各單位代表出席，每季透過會議方式傳達公司資安方針與宣導事項。

本公司設有資安長(CISO)及資通安全組織，主導與規劃全公司資通安全作業執行以及資安風險管理機制之有效性、適用性與適切性，至少每年一次向董事會彙報資安管理成效及資安策略方向，並由具有電腦科學相關背景的徐秀蘭董事長督導整體資通安全管理組織相關資安管理作業及制度之執行成效，定期檢討修正。最近一次提報董事會日期為113年5月7日。

本公司資訊系統委由集團母公司（中美矽晶製品股份有限公司）代為管理，每年由稽核單位主導進行資訊系統暨資通安全檢視，並定期向董事會報告查核狀況。

為了能強化資訊安全與風險管理，本公司於113年9月導入資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS）ISO 27001:2022，系統化管

理與保護資訊資產，並持續透過規劃、建立、執行與監督的循環機制，持續精進改善，確保資產的機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）以及可用性（Availability），目前證書有效期間為 113 年 9 月 21 日至 116 年 9 月 21 日。

資通安全政策

本公司訂有資通安全政策，並經董事會通過。資安策略主軸以「資安治理」—依循資通安全政策管理辦法執行，適時引進新科技改善資安治理能力；「法令遵循」—定期檢視法令新規定，引進新科技產品增強資安管理；及「科技應用」—吸收產業新知與業界相關專業單位交流，以求改善資安治理能力等三方面進行，並緊密結合相互支持，透過不斷的改善優化來提升整體資安防禦能力。

在具體運作模式方面，採取 PDCA 循環模式，以確保目標之達成且持續改善、透過設立資訊安全監控系統弱點掃描預防外部駭客侵入與內部機密洩漏、資訊軟硬體設備控管（包含網際網路及個人資訊設備）以落實個人資料及內部保護機密資料安全。

資安風險管理與持續改善架構：



資安管理面向

資安具體管理方案分 3 大面向執行，以確保資安實務有效並降低風險：

1. 資訊系統安全管理

- 伺服器及個人電腦或筆記型電腦安裝端點防護軟體，並自動更新病毒或特徵碼。
- 郵件主機建置郵件安全閘道器，具備垃圾郵件過濾、惡意檔案偵測、釣魚郵件偵測等資安模組，提升藉由郵件發動攻擊的防護能力。
- 重要系統及資料庫，定期備份及異地存放，確保資料可用性。
- 定期執行資訊系統弱點掃描，修補系統漏洞。

- 公司電腦作業系統或伺服器，依照資安風險進行安全性更新。
- 內部網路設置防火牆並且設定防火牆規則，以保護重要資訊系統。
- 重要應用系統每年進行災難復原演練計畫。

2. 資訊系統存取控管

- 應用系統與檔案存取設定權限控管，以保障資訊機密性。
- 制定與實施帳號/密碼複雜度原則，並定期更新密碼，確保身份認證有效性。
- 針對離職、部門異動員工，資訊部門依據單據調整權限，確保資料授權即時且正確。
- 訂有非公司員工（協力廠商、外包商）申請帳號及系統使用管理辦法，通過申請後，開啟權限方可連線進入系統，並記錄處理情形。
- 針對外接資訊儲存媒體禁止接入個人終端裝置。
- 禁止私人電腦設備連接存取公司網路與資源，並建立設備認證管理機制。

3. 網路安全管理

- 對外設置防火牆來保護網路對外連結，並根據防火牆異常紀錄進行分析加強防護。
- 運用人工智慧（AI, Artificial Intelligence）快速辨識惡意攻擊，將資安情資匯入資安防禦系統。
- 連接網際網路及公司內部網路界接採多迴路機制來避免因斷線造成影響。
- 設置有資訊服務監控平台監看網路流量與連線狀態，當網路有狀況時能及時處理排除問題。
- 資訊部門不定期寄發郵件安全提醒宣導訊息予全體同仁，提醒同仁應保持開啟收到郵件的警覺心，以防日趨嚴重的釣魚惡意詐騙信件。
- 內部員工電腦皆安裝防毒軟體，防毒中控平台一但發現有中毒事件，將寄發通知信給 IT 相關人員進行電腦的病毒排除。
- 限制員工在外透過遠端連線至公司內部網路須符合資安控管，只有必要人員執行必要功能並經過授權可遠端連線回公司，遠端連線並須使用多因子認證的 VPN 安全連線。

有鑑於目前資安新興趨勢，如 DDoS 攻擊、勒索軟體、社交工程軟體、網站側錄與漏洞問題等，本公司已加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）會員與科學園區資安資訊分享與分析中心（SP-ISAC）會員，藉由每年與知名資安廠商交流及專案合作，持續關注最新資安議題並規劃因應計畫，針對不同資安情境進行 DDoS、APT 攻防演練，強化處理人員的應變能力，以期能在第一時間即時偵測並阻擋。

113 年度資通安全措施推動執行成果：

- 專責人員：設有資安處且配置專責資安人員 2 人，於 113 年度完成 40 小時的專業資通安全相關訓練。
- 教育訓練：集團全體員工均須通過資安認知與社交郵件教育訓練並通過測驗。
- 社交工程：每年執行社交工程演練，未通過者須進行補課或再訓練課程，降低社交攻擊風險。113 年度社交工程演練測驗全體使用者皆通過考驗。
- 資安公告：資安公告與宣導，追蹤資安新知不定期發布與宣導資訊安全相關事宜。

- 資安維運：投入適當資源，持續改進或調整，使公司達到制定之資訊安全目標。
- ISO 驗證：導入 ISO27001 資訊安全管理系統，並於 113 年 9 月通過驗證。
- 資安稽核：第三方稽核，第三方廠商進行資訊安全稽核。
- 資安成效：Security Scorecard 之系統弱點掃描工具評分平均得分 98 分。
- 資安保險：本集團已投保部分資安保險，作為因應資安威脅的風險管理解決方案之一。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司部分廠區之資訊系統於 113 年 6 月遭受駭客攻擊，攻擊者透過暴力破解方式入侵，並對廠區帶來影響。但資安單位即刻啟動應變與防禦機制縮小影響範圍，並委請外部專家積極協助調查與復原工作，同時積極對外聯繫與告知客戶與供應商，於同月份順利恢復正常運作，將公司財務與業務影響縮減至最小。

雖上述事件未造成本公司重大損失，但本公司仍會持續改進、加強資安防禦與員工資通安全觀念。改善方向如下：

- 海內外所有子公司與資安/資訊主管召開定期資通安全委員會會議，由原頻率每半年改為每一季度召開，增加溝通與經驗交流，亦利於加強資安聯合防護機制。
- 將資安風險增列為績效衡量重要標準之一，除了獲利表現也將資安防禦能力與企業韌性列為重要指標。
- 為定期追蹤國內之資安治理相關落實情形，定期召開資通安全推動小組會議用以溝通企業內部各部門資訊安全相關注意事項。
- 持續精進員工資通安全觀念。
- 身份認證密碼長度要求 10 碼以上，且包含英數字與特殊符號。
- 推動海內外各子公司雙因子認證之導入。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
土地租賃契約	新竹科學園區管理局	110.01.01~ 129.12.31	面積 4,633 平方公尺	限目的事業用途使用
土地租賃契約	新竹科學園區管理局	107.01.29~ 126.12.31	面積 12,004.74 平方公尺	限目的事業用途使用
土地租賃契約	新竹科學園區管理局	109.02.01~ 128.12.31	面積 47,632.03 平方公尺	限目的事業用途使用
供貨合約	客戶 C	106~116	矽晶圓供貨合約	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113 年度	112 年度	差 異	
				金 額	變動比例%
流動資產		80,491,722	90,101,089	(9,609,367)	-11%
不動產、廠房及設備		119,074,144	72,250,814	46,823,330	65%
無形資產		2,448,363	2,346,556	101,807	4%
其他資產		7,416,410	9,176,202	(1,759,792)	-19%
資產總額		224,580,571	188,988,001	35,592,570	19%
流動負債		65,064,565	74,274,283	(9,209,718)	-12%
非流動負債		68,488,214	48,260,093	20,228,121	42%
負債總額		133,552,780	122,534,376	11,018,404	9%
股本		4,781,137	4,361,137	420,000	10%
資本公積		45,720,158	24,248,547	21,471,611	89%
保留盈餘		47,641,022	45,300,230	2,340,792	5%
股東權益總額		91,027,791	66,453,625	24,574,166	37%
<p>1. 最近二年度增減比例達 20%者分析說明：</p> <p>(1) 不動產、廠房及設備：本期持續進行擴廠計畫而增加。</p> <p>(2) 非流動負債：主係因營運所需，增加銀行借款及發行應付公司債。</p> <p>(3) 資本公積及股東權益總額：主係本期發行 GDR 及持續獲利而增加。</p> <p>2. 影響重大者之未來因應計劃：無。</p>					

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	62,626,004	70,651,593	(8,025,589)	-11%
營業毛利	19,803,501	26,440,566	(6,637,065)	-25%
營業損益	14,118,185	20,058,561	(5,940,376)	-30%
營業外收入及支出	(1,689,619)	6,437,896	(8,127,515)	-126%
稅前淨利	12,428,566	26,496,457	(14,067,891)	-53%
所得稅費用	2,589,786	6,726,816	(4,137,030)	-62%
本期淨利	9,838,780	19,769,641	(9,930,861)	-50%
其他綜合損益(稅後淨額)	493,595	(461,302)	954,897	-207%
本期綜合損益總額	10,332,375	19,308,339	(8,975,964)	-46%
最近二年度增減比例達 20%者分析說明：				
(1)營業毛利及營業損益：本期因營收下降及成本上升，獲利相對減少。				
(2)營業外收入及支出：本期持有海外有價證券因股價波動評價認列損失增加。				
(3)所得稅費用：因稅前獲利減少使所得稅費用相對減少。				
(4)其他綜合損益：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額變動。				

三、現金流量：

(一)最近年度(113 年度)現金流量變動之分析說明

(1)財務分析

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額 (1)	全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 (2)	全 年 現 金 流 出 (入) 量 (3)	現 金 剩 餘 (不 足) 數 額 (1)+(2)-(3)	現 金 不 足 額 之 補 救 措 施	
				投 資 計 劃	理 財 計 劃
26,164,591	15,041,426	2,276,680	38,929,337	NA	NA
本 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析： (1)營業活動：本年度持續獲利，營業活動淨現金為淨流入。 (2)投資活動：本年度購置固定資產，使投資活動為淨現金流出。 (3)籌資活動：本年度發行 GDR，使籌資活動為淨現金流入。					

(二)流動性不足之改善計畫：本公司無現金不足額之情形，尚無流動性不足之虞。

(三)未來一年度(114 年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額 (1)	預 計 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 (2)	預 計 全 年 現 金 流 出 (入) 量 (3)	預 計 現 金 剩 餘 (不 足) 數 額 (1)+(2)-(3)	預 計 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施	
				投 資 計 劃	理 財 計 劃
38,929,337	15,269,809	23,937,030	30,262,116	NA	NA
1.未來一年度現金流動性分析： (1)營業活動：預期持續獲利，使營業活動產生淨現金流入。 (2)投資活動：因應擴廠所需之資本支出，使投資活動產生淨現金流出。 (3)融資活動：因資本支出需求預計向外部借款使融資活動產生淨現金流入。 2.預計現金不足額之補救措施：無。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司 113 年度重大資本支出為取得不動產、廠房及設備，資金來源主要係以自有資金及銀行借款支應。本公司進行的產能擴充計劃將能有效提升產能和技術領先優勢，有助於公司在半導體市場中保持領先地位，並為股東創造持續的價值。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策：

本公司依循主管機關訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂有「取得或處分資產處理程序」作為本公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關之業務與財務狀況；另本公司為提升對轉投資公司之監督管理，於內部控制制度中訂定對子公司監控管理辦法，針對其資訊揭露、財務、業務、存貨及營運之管理制定相關規範，使本公司之轉投資事業得以發揮最大效用。

(二)最近年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新台幣仟元

轉投資事業名稱	113 年度認列之投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
GlobalSemiconductor Inc.	111,422	營業狀況正常	無
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	1,360,699	營業及獲利狀況穩定	無
GlobalWafers GmbH	(3,507,000)	營業狀況正常	無
GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.	3,516,697	營業狀況正常	無
GlobalWafers B.V.	258,340	營業狀況正常	無
旭愛能源股份有限公司	10,768	營業狀況正常	無
旭信電力股份有限公司	(589)	營業狀況正常	無
寰球鑫投資股份有限公司	(1,667)	營業狀況正常	無
環球晶資本(股)公司	246,213	營業狀況正常	無
弘望投資股份有限公司	65,929	營業狀況正常	無
兆遠科技股份有限公司	235,502	營業狀況正常	無
Crystalwise Technology (HK) Limited	949	營業狀況正常	無
元鴻(山東)光電材料有限公司	(130)	營業狀況正常	無
昆山中辰矽晶有限公司	104,064	營業及獲利狀況穩定	無
MEMC Electronic Materials Sdn. Bhd.	67,337	營業及獲利狀況穩定	無
昆山辰巨電子科技有限公司	10,901	營業狀況正常	無
上海召業申凱電子材料有限公司	(105,941)	營業狀況正常	無
忻州元鴻信息材料有限公司	(65,610)	營業狀況正常	無
MEMC Japan Ltd.	84,894	營業及獲利狀況穩定	無
MEMC Electronic Materials S.p.A.	205,988	營業及獲利狀況穩定	無
MEMC Electronic Materials France SarL	650	營業狀況正常	無
GlobiTech Incorporated	(454,739)	營業狀況正常	無
MEMC LLC	(557,938)	營業狀況正常	無
GlobalWafers America, LLC	(215,793)	營業狀況正常	無
MEMC Korea Company	768,041	營業及獲利狀況穩定	無
MEMC Ipoh Sdn. Bhd.	406	結束營業	無
Topsil GlobalWafers A/S	52,835	營業及獲利狀況穩定	無

(三)未來一年投資計畫：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：本公司及子公司財務體質健全，信用記錄良好，金融機構授信條件較為優惠，因此公司在借款成本上能享有較佳之條件，借款內容依實質資金需求區分為短期借款及中長期借款，公司借款項目評估基準以取得資金之成本以及還款條件為主要考量，又部分週轉之短期信用借款屬於外幣幣別，動用時皆會考量匯率狀況作為工具選擇判斷。
- 2.匯率：本公司及子公司進銷貨交易外幣部位以採負債及資產部位互抵之自然避險為原則，盡量降低曝露於匯率波動風險下之淨部位，並由財務單位密切觀察匯率之走勢，必要時搭配以避險為目的之外匯操作工具，降低匯率波動對營運成本之影響。
- 3.通貨膨脹：通貨膨脹壓力衝擊世界經濟並擠壓企業利潤，惟本公司透過建立複數供應商及積極議價以降低前端採購成本，並同步調整終端售價以保留獲利，本公司及子公司亦隨時注意物價波動情形，必要時採取對應措施。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司及子公司並無從事高風險、高槓桿之投資。
- 2.本公司及子公司從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易，係依本公司及子公司之資金貸與他人作業程序、背書保證辦法、從事衍生性商品交易處理程序及主管機關相關規定辦理，並依規定期稽核及公告，執行單位亦會依循相關管理辦法進行內部審核及監控，不致對營運造成風險。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

半導體晶圓為半導體元件之基本，隨著半導體產品應用領域越趨廣泛且品質規格要求與日俱進，本公司持續觀察市場脈動及技術發展方向，配合客戶現在及潛在需求，積極投入新技術、新產品之開發，未來主要開發項目如下：

A、12吋奈米製程矽基板技術開發

B、新世代感測元件與通訊元件基板技術開發

在研發費用方面，主要是依據新產品及新技術之開發時程逐步配合編列，本公司112年及113年研發費用佔營業收入總額之比重分別為3.35%及3.70%，114年本公司預計投入之研發費用約占當年度營收之3%至5%，並將視營運狀況及市場情勢變化適時規劃調整，以保持本公司在產業市場之競爭優勢。

類別	預計研究開發案說明
製程改善研究開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 低能耗長晶熱場設計開發 2. 低污染低能耗線切割製程開發 3. 先進長晶/晶圓製程良率提升
品質改善研究開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 晶體缺陷控制與量測技術開發 2. 超平坦矽晶圓加工技術開發 3. RFSOI 製程良率技術開發 4. 光激發螢光(PL)與 FTIR 技術應用於低碳矽晶體量測技術開發
設備改善研究開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自動化與數位化製造系統開發 2. 高生產力、高晶體品質、長晶爐設計開發 3. 低能耗製程設備設計開發 4. 微小 LPD 矽表面檢測方法開發 5. 次世代功率元件用 8 吋 FZ 長晶爐
新產品開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 導電型與半絕緣與較大尺寸碳化矽晶體與晶圓開發 2. 次世代 RF 元件用 SOI 基板開發 3. 8 吋氮化鎵磊晶新產品開發 4. 8 吋碳化矽磊晶晶圓開發 5. 8 吋碳化矽長晶關鍵設備及長晶技術開發計畫 6. 12 吋碳化矽長晶關鍵設備及長晶技術開發計畫

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司及子公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並適時主動提出因應措施，截至年報刊印日止，本公司及子公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意所處行業相關科技改變情形，掌握市場趨勢，並評估其對本集團營運所帶來之影響。惟近年尚無重大科技改變或產業變化而對本公司及子公司財務業務有重大影響之情事。

本公司已設立資通安全組織並建立網路與電腦相關資安防護措施，透過持續檢視和評估資訊安全管理辦法及程序，以確保其適當性和有效性。本公司持續加強資訊安全防護措施，以期保護公司免於惡意軟體及駭客攻擊，另建置有完善的備份備援機制，期能在遭受攻擊後，於很短的時間內恢復系統正常運作，使傷害降到最低。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司自設立以來專注於本業經營，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，以持續維持優良企業形象，增加客戶對公司之信任，本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，尚未有因企業形象改變而造成公司營運危機之情事。惟企業危機之發生可能對企業產生相當大之損害，故本公司及子公司將持續落實各項公司治理要求，以降低企業風險之發生及對公司之影響。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於112年11月1日依「企業併購法」第29條股份轉換方式，收購取得兆遠科技股份有限公司（以下簡稱「兆遠公司」）百分之百股權，使兆遠公司成為本公司100%持有之子公司，並於112年11月17日完成變更登記。

本公司與兆遠公司進行股份轉換後，透過雙方技術及研究經驗互相交流，加速新產品開發與導入，並結合雙方業務團隊進行交互行銷推廣以拓展業務層面，同時透過資源整合及資源有效配置運用來提升整體經營效率，避免重複的資源浪費，併購綜效已逐步顯現。

本公司依「企業併購法」及「取得或處分資產作業程序」之相關規範辦理併購事宜，並秉持審慎評估之態度，以確實保障公司利益及股東權益，並將投資風險降至最低。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

為滿足科技創新所帶來的半導體單位含量增加需求，並著眼於半導體長期發展動能，本公司執行大規模產能擴充計劃，主要用於擴增12吋晶圓和化合物半導體的產能，投資地區橫跨亞洲、歐洲和美國。擴產項目包含12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓（含SiC Epi）、GaN on Si等大尺寸次世代產品。擴充廠區包括義大利、丹麥、美國、日本、韓國及台灣，擴產計劃積極進行中，除了客戶以預付款預定產能外，本公司並掌握各國半導體自主化浪潮，同步申請實施資本支出計畫當地的政府補助。截至年報刊印日止，大部分現有廠區擴建（brownfield projects）已完工並開始貢獻營收，位於美國的新建廠區計畫（greenfield expansion）順利進行，已進入樣品製作與交付階段，新產能將逐步提升。

有鑑於半導體產業之景氣波動可能對新增產能帶來風險及影響，本公司此次的產能擴增是依據客戶確認的長約訂單進行，新產能將優先提供給長約客戶；產能總規模亦會視最新全球經濟最新發展而彈性調整；關於通膨帶來的原料漲價影響及世界政經情勢變化所衍生的運輸限制及成本增加，本公司持續與供應商及客戶積極議價與溝通，以降低景氣波動及充滿不確定性的總體經濟對公司之影響。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司為原物料建立複數供應商，以避免過度仰賴單一供應商的斷鏈風險。在銷貨方面，本公司的客戶地區別佔比分配均衡，在亞洲、歐洲及美洲皆有重要客戶，綿密的銷售渠道及生產據點亦遍布全球，以在地供應、在地銷售降低總體經濟、地緣政治及全球運輸系統所帶來的不確定性。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件

- 1.截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無
- 2.公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1. 智慧財產權之管理及風險因應措施：

智慧財產管理策略

為了呼應公司營運策略，成為全球規模最大、產品最完整的晶圓供應商，同時搭配研發策略於次世代產品技術的持續開發，本公司擬定智財管理策略，期望透過智財管理制度的運作提升智財管理能力，強化產品專利佈局、建構完善的機密管理機制，提升公司競爭力、保障公司及客戶權益。

智慧財產管理制度與認證

環球晶圓自成立以來沿襲母公司對智慧財產權的重視，於2013年開始進行『台灣智慧財產管理系統(TIPS)』的導入，以專利與營業秘密為主要標的，逐步強化智財管理系統各項辦法，包括：

- ✓ **專利管理**：對提案審查、專利申請與維護進行規範，透過獎勵制度鼓勵員工創新提案。專利審查時除考量法規規定外，亦會考量是否具有節能減碳之綠色影響力，以鼓勵綠色專利佈局。
- ✓ **機密管理**：對公司各項機密資料進行等級區別，加強標示識別、權限管控等作業。透過每年度的TIPS內部稽核，針對機密資料是否妥善管理進行確認。

- ✓ **研發管理**：建立自行開發與委外合作管理規範，包括研發前的風險分析、研發中的紀錄管理、研發後的成果審查等。同時建立與外部合作時的合約審核原則，確保公司權益。

此外公司也持續參與 TIPS 稽核驗證，期望藉此落實智財管理機制。陸續於 2013 年通過 TIPS 基礎驗證、2014 及 2015 年通過 TIPS 深入驗證，2016、2017、2019、2021 與 2023 年通過 AA 級驗證，最新證書有效期間至 2025 年 12 月 31 日止。

可能遭遇風險與因應政策

有鑒於機密外洩事件於新聞上時有所聞，為了避免公司辛苦產出技術遭人竊，同時必須保障客戶權益，公司持續強化機密管制方案，避免可能的風險發生。在人員管理部分，定期舉辦機密管制訓練宣導，提升員工對於營業秘密管理認知，強化員工對於釣魚郵件的認知，避免網路資安問題發生。在設備管制部分，透過電子郵件外寄管制、電子儲存裝置管制，減低內部資料外洩可能。最重要的是，定期舉辦 TIPS 內部稽核，對各單位機密管制落實程度進行調查，提升管理量能。

2024 年智財系統執行情況

智財政策	執行情況摘錄說明
提升智財管理能力	針對各部門新進同仁提供所需的智慧財產權訓練課程，涵蓋智慧財產權介紹、公司機密管理機制、專利檢索策略、專利地圖製作、TIPS 執行要點及 TIPS 內部稽核員訓練等多元化內容。
強化產品專利佈局	2024 年總公司專利累積量 524 件，其中已獲證專利 335 件、申請中專利 189 件，寬能隙產品與技術佔比較高約 70%，已累積達 378 件專利。
完善機密管理機制	今年度 TIPS 內部稽核稽核總數為 240 件，總缺失件數 6 件，總觀察建議事項件數 5 件。已妥善進行原因分析與矯正預防措施，避免相同問題再發。

智財權成果清單

截至 2024 年 12 月 31 日，環球晶圓集團(含海外)於全球有效專利量已突破 2,558 件，其中已獲證專利數量累積達 1,621 件。集團專利佈局方向涵蓋各種主要產品(不同材料尺寸)之晶體生長、晶圓加工、品質檢驗等關鍵技術。除申請專利外，亦根據不同技術發展包含相關特殊長晶、加工製程之營業秘密。

智慧財產之主要用途與貢獻

智慧財產權對集團來說，除了可以彰顯技術發展能量外，亦可創造策略聯盟機會，提升公司整體競爭力，爭取客戶信賴與認同。尤其在發展新技術或新產品時，在該領域進行專利佈局，避免可能的智財風險相當重要。智慧財產權不只是開發下

一世代產品的競爭利器，同時也是能夠抵禦所有競爭者造成影響、公司得以永續經營的重要利器。

針對前述智財管理規劃與執行情況，本公司至少每年一次提報至董事會說明，最近一次提報日期為 2024 年 11 月 5 日。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：本公司最近年度之關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書，請參見公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)

首頁>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區 (公司代號：6488)。

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：本公司於上櫃掛牌後，應續行之承諾事項辦理情形

上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形
<p>本公司於「取得或處分資產處理程序」訂有上櫃承諾事項－「本公司不得放棄對 Global Semiconductor Inc.(以下簡稱 GSI)及 Global Wafers Japan Co., Ltd.未來各年度之增資;GSI 不得放棄對昆山中辰矽晶有限公司未來各年度之增資;本公司及本公司之子公司不得放棄對 GlobiTech Incorporated 未來各年度之增資。未來若各該公司因策略聯盟考量或其他因素，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須先經櫃買中心同意，復提經公司董事會特別決議通過。且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃買中心備查。」</p>	<p>本公司於 104 年 11 月 9 日董事會及 105 年 6 月 22 日股東會通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」一增訂上櫃承諾事項。</p> <p>為集團組織整合，本公司之子公司 GWafers Inc.與 Global Wafers Japan Co., Ltd.已於 107 年 1 月 1 日正式合併。因應此組織調整，本公司於 107 年 3 月 20 日董事會及 107 年 6 月 25 日股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」之上櫃承諾事項，並輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露及函報櫃買中心。</p> <p>為集團組織整合，本公司之子公司 GlobiTech Incorporated 之股權由原本公司子公司 Global Wafers Inc.項下移轉至本公司子公司 Global Wafers B.V.項下，仍為本公司持股百分之百之子公司。鑑於以上，本公司於 108 年 3 月 19 日董事會及 108 年 6 月 25 日股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」之上櫃承諾事項，並輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露及函報櫃買中心。</p> <p>為響應政府境外資金回台政策及增進集團資金運用效能，本公司於 108 年 12 月 10 日董事會通過境外資金匯回案。於境外資金匯回案下，本公司之子公司 GWI 將於完成盈餘分配並出售其項下持有之新加坡子公司 GWafers Singapore Pte. Ltd. (簡稱 GWS) 股權予本公司二年期滿後進行清算。本公司於 GWI 清算後，仍持有 GWS 及其子公司 100% 股權，於集團整體股權控制及合併損益無影響。因應前述二年期間已滿，GWI 於 111 年 11 月 1 日已清算完成。鑑於以上組織架構調整，本公司於 111 年 12 月 6 日董事會及 112 年 6 月 20 日股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」之上櫃承諾事項，並輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露及函報櫃買中心。</p>

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

環球晶圓股份有限公司



負責人：徐秀蘭



